

股票代號：2467

志聖工業股份有限公司 114 年度
C SUN MFG. LTD.

年報



本年報查詢網址：
公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw>
證期局指定之資訊申報網址：同上
公司網址 <https://www.csun.com.tw>

年報刊印日：中華民國一一五年三月三十一日



志聖工業 公司資訊

本公司發言人 / 代理發言人

吳晏城 協理

Tel: (02)2601-0700

Email: jamie@csun.com.tw

林彥亨 特助

Tel: (02)2601-0700

Email: henrylin@csun.com.tw

公司網址

<https://www.csun.com.tw/>

csun志聖



總公司、工廠之地址及電話

總公司

新北市林口區文化二路一段二六六號七樓之一

Tel: (02)2601-0700

台北廠

新北市林口區工二工業區工八路二之一號

Tel: (02)2601-7706

台中廠

台中市南屯區精科二路 十一 號

Tel: (04)2359-1651

辦理股票過戶機構

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

台北市東興路八號地下一樓

<https://www.pscnet.com.tw/>

Tel: (02)2746-3797

最近年度財務報告會計師

李典易、吳偉豪

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

台北市信義區基隆路一段三三三號 二十七 樓

<https://www.pwc.tw/>

Tel: (02)2729-6666

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱
及查詢該海外有價證券方式：無



目錄



1	致股東報告書	1	3	募資情形	64
	一、民國 114 年度營業報告	2		一、公司資本及股份	66
	二、民國 115 年度營業計劃概要	3		（一）股本與來源	66
	三、未來公司發展策略	5		（二）資本及股份	68
	四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響	5		（三）總括申報制度相關資訊	68
				（四）主要股東名單	68
				（五）公司股利政策及執行狀況	68
				（六）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	70
				（七）員工酬勞及董事酬勞	70
				（八）公司買回本公司股份情形	71
				二、公司債 / 特別股 / 海外存託憑證辦理情形	72
				（一）公司債辦理情形	72
				（二）特別股 / 海外存託憑證辦理情形	72
				三、員工認股權憑證辦理情形	73
				（一）尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響	73
				（二）取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新台幣三仟萬元以上員工之姓名、取得及認購情形	73
				四、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	73
				（一）最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者	73
				（二）最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者	73
				五、資金運用計畫執行情形	73
				（一）計畫內容	73
				（二）執行情形	74
2	公司治理報告	8			
	一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	10			
	（一）董事及監察人資料	10			
	（二）董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露	13			
	（三）董事及獨立董事進修情形	17			
	（四）總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	18			
	（五）最近年度支付董事、獨立董事、總經理及副總經理之酬金	20			
	二、公司治理運作情形	27			
	（一）董事會運作情形	27			
	（二）審計委員會運作情形	30			
	（三）公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	34			
	（四）公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形	37			
	（五）推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	39			
	（六）上市上櫃公司氣候相關資訊	48			
	（七）公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	53			
	（八）公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式	56			
	（九）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊	56			
	（十）內部控制制度執行狀況	57			
	（十一）最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議	58			
	（十二）最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容	59			
	三、簽證會計師公費資訊	60			
	四、更換會計師資訊	60			
	五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	61			
	六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	61			
	七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	62			
	八、公司、公司董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	63			

4 營運概況

一、業務內容	78
1. 業務範圍	78
2. 產業概況	80
3. 技術及研發概況	91
4. 長、短期業務發展計畫	91
二、市場及產銷概況	93
1. 市場分析	93
2. 主要產品重要用途及產製過程	103
3. 主要原料之供應狀況	104
4. 最近二年度任一年度中曾佔進（銷）貨總額百分之十以上之客戶及供應商名稱	104
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	105
（一）從業員工結構	105
（二）員工行為或倫理守則	105
（三）工作環境與人身安全的保護措施	106
四、環保支出資訊	111
五、勞資關係	111
六、資通安全管理	114
七、智慧財產管理計畫	116
八、社會責任	119
九、重要契約	124

76

5 財務狀況及經營結果
之檢討分析與與風險管理

126

一、財務狀況比較分析	128
二、經營結果分析	128
三、現金流量	129
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	130
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	130
六、風險管理及評估	130
（一）風險管理之組織架構	130
（二）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施	130
（三）從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施	131
（四）未來研發計畫及預計投入之研發費用	131
（五）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施	131
（六）科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施	131
（七）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施	132
（八）進行併購之預期效益、可能風險及因應措施	132
（九）擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施	132
（十）進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施	133
（十一）董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施	133
（十二）經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施	133
（十三）訴訟或非訟事件處理情形	133
（十四）資安風險評估分析及其因應措施等重要風險評估之事項	133
（十五）其他重要風險及因應措施	133
七、其他重要事項	133

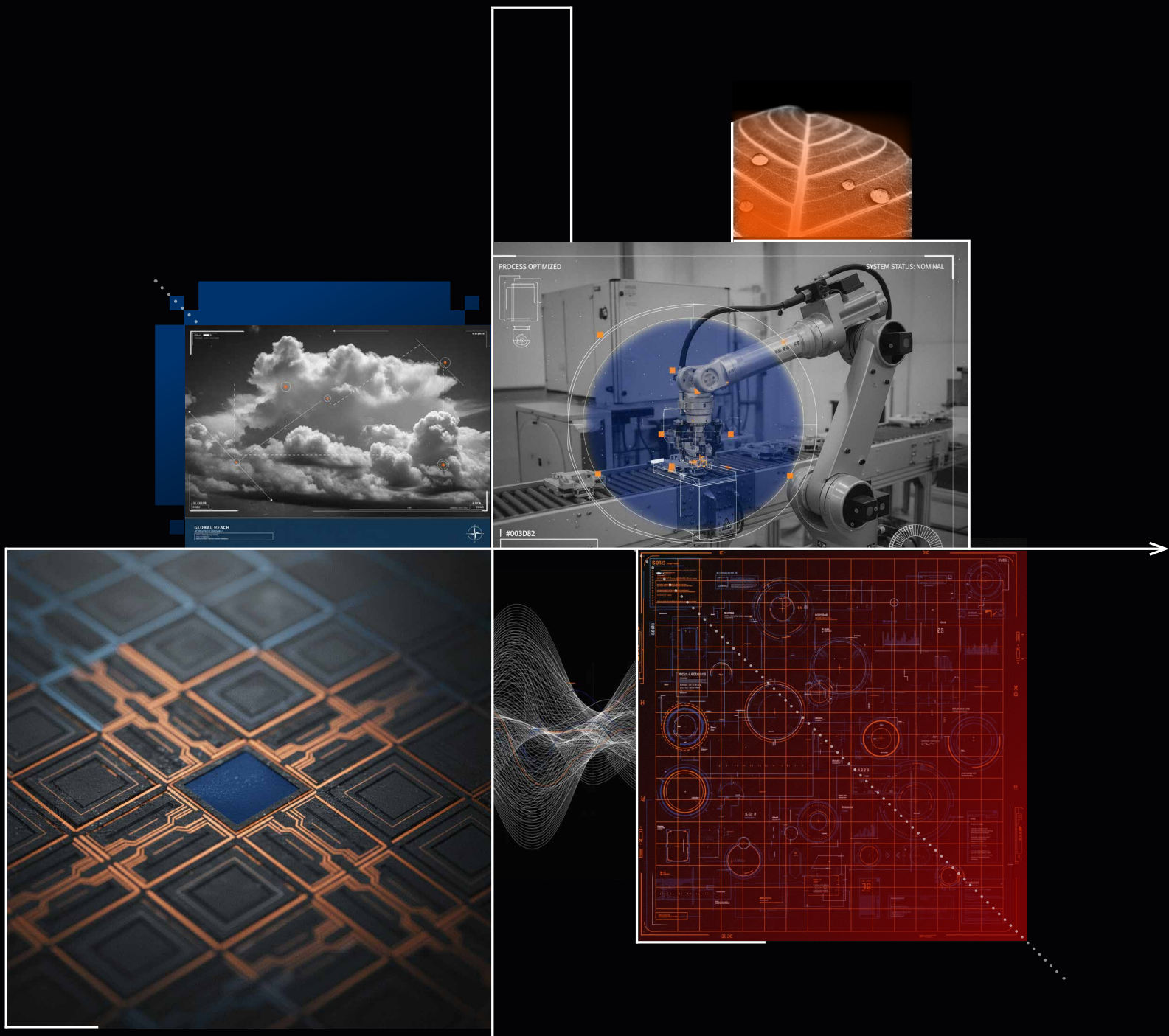
6 特別記載事項

127

一、關係企業相關資料	136
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	136
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形	136
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響事項	136
五、其他必要補充說明事項	136

1

致股東報告書



一、民國 114 年度營業報告

各位股東女士、先生 大家好：

首先感謝各位股東長期以來對志聖的支持，為各位股東報告 114 年度營業狀況：

(一) 營業成果：

項目	114 年	113 年	增 (減) 比例
營業額收入淨額	6,102,155	4,818,209	26.6%
營業毛利	2,643,741	1,983,100	33.3%
營業費用	1,760,497	1,347,104	30.7%
營業利益	883,244	635,996	38.9%
營業外收 (支)	243,443	343,568	-29.1%
稅後淨利	892,907	756,575	18.0%
歸屬於母公司淨利	830,564	719,160	15.5%

(二) 財務收支及獲利能力的概況：

1. 財務結構：
- 股東權益與資產比率

= 44.41%
- 負債與資產比率

= 55.59%
2. 償債能力：
- 流動比率

= 131.72%
- 速動比率

= 85.74%
3. 獲利能力：
- 資產報酬率

= 6.27%
- 股東權益報酬率 (ROE)

= 13.57%
- 純益率

= 13.61%
- 每股盈餘 (EPS)

= 5.50

114 年度研發狀況：

行業別	項目
半導體製程設備	Carrier bonder 升級專案、WTW Bonder 開發專案、Panel bonder 模組開發、滾輪壓膜升級專案、半導體科專計畫
印刷電路板製程設備	RCC 預貼機、高階滾輪壓膜機、ABF 撕膜機、外層撕膜機、多腔式真空壓膜系統
前瞻製程與其他電子應用設備	石英震盪器黃光製程設備

二、民國 115 年度營運計劃概要

(一) 當年度經營方針

1. 營業方面
- (1)掌握 2.5D, 3D IC 封裝、FoPLP、LTPS 及類載 HDI/MSAP、RCC 製程、ABF/BT 載板等先進前瞻製程資本支出商機。

(2)拓展至泰國、馬來西亞、新加坡、越南、印度、北美及日本市場。
2. 關注節能環保與循環經濟的訴求：加強烤箱及各機種的節能，並於營運上節能再利用及促進環保永續。
3. 研發方面：增加內部核心技術與交流，強化與外部策略夥伴的研發與市場合作關係，使產品組合更加完整。

115 年度計劃開發之產品技術：

行業別	項目
半導體製程設備	CoPoS/PLP 滾輪壓膜模組開發、熱處理設備開發，、CoWoP 熱處理設備開發，半導體 A+ 科專計畫，SOIC 設備開發 Wafer carrier bonder 升級專案、Wafer vacuum laminator 升級專案、Panel bonder 專案、Panel Vacuum/Roller Laminator 專案
印刷電路板製程設備	RCC 預貼機、高階滾輪壓膜機、ABF 撕膜機、防焊撕膜機、雙列陶瓷基板壓膜機
前瞻製程與其他電子應用設備	WTW Bonder 專案、Press Anneal 專案

4. 管理方面
- (1)組織

建立以產業別及核心技術為基礎之營運中心組織結構。

各營運中心以相關核心技術為基礎，發揮製程專業優勢，同時在集團管理平台上發展跨產業整合創新研發機制及發揮通路的規模優勢。
- (2)人才培育

引進優秀人才、國際級產學合作及外界顧問，高階主管擔任內部講師並配合題分析與結論系統 (PAC，Problem Analysis & Conclusions) 及基層作業須知系統 (YSK，You Should Know)、內部知識管理系統及數位化轉型管理，系統性的循序培育核心技術研發團隊及具管理能力及整合能力的複合型 PARPRO (專業夥伴)，進而有機延展志聖成為具核心競爭力學習型組織。
- (3)資產管理

強化現金流量及水位之風險控管；加強應收帳款及新舊呆滯品的去化。
- (4)生產管理

提昇品管系統由 QC 至 QA 至品質保證，引進問題分析與結論系統 (PAC，Problem Analysis & Conclusions) 及基層作業須知系統 (YSK，You Should Know)，全面提昇產品可靠度。快速反應市場之需求，兩岸有效分工，精實營運，注入永續發展概念及企業社會責任的實踐。

(二) 2026 年預期銷售數量及其依據：

行業別	數量
半導體製程設備	287
印刷電路板製程設備	410
前瞻製程與其他電子應用設備	466
合計	1,143

註：參酌目前已接訂單、生產排程、出貨日期及產業景氣等因素所編製。

(三) 重要產銷政策

為了更佳滿足半導體先進封裝製程與未來 AI 晶片的需求趨勢，同時考慮到廣州與昆山廠在其他產業製程設備的規劃，我們將進行以下產銷政策的定位：

1. 針對性生產分工與彈性應變：台灣林口與台中廠與台中二廠將擴充發展半導體先進封裝製程與未來 AI 晶片的生產設備和產能準備，以滿足高端半導體市場的需求。同時，廣州與崑山廠將著重於服務於 AI PCB 及半導體載板等其他電子產業的製程技術與設備開發，確保各基地根據市場需求與經濟局勢靈活調整產能和技術方向。
2. 全方位解決方案提供者：強化台灣林口廠與台中廠在提供整合材料、設備及製程技術的 Total Solution 方面的能力，專注於滿足前瞻製程和 AI 晶片製造相關設備的特殊需求。廣州與昆山廠則將持續提升在其他電子製程技術方面的整合與創新能力。
3. 區域領導地位的鞏固與拓展：台灣台中廠與台中二廠將致力於成為半導體先進封裝製程設備的領導者，而台灣林口、廣州與昆山廠則專注於鞏固和拓展在大中華區其他 AI、PCB、電子產業光熱製程設備的市場領先地位。
4. 高效能、高節能、高精度的生產解決方案：台灣台中廠與台中二廠將開發專為半導體先進封裝、IC 載板與 HBM 高效能、高節能、高精度生產技術和設備。
5. 積極參與創新與可持續發展：所有基地將積極切入智動化、節能再利用與環保永續技術的研發和應用，各廠區探索和實踐更多創新技術與環保解決方案，引領產業向著更高效、更綠色的未來發展。

透過這些策略性的調整，我們旨在更精確地滿足半導體先進封裝設備市場需求，加強技術創新，並在全球半導體及電子產業設備中積極佔據領導地位，推動公司的長期發展和行業進步。

三、未來公司發展策略

秉持著公司一貫的經營理念，我們專注於提供壓合 (Bonding)、貼合 (Lamination)、撕離 (Peeling)、熱處理 (Thermal)、紫外線 (UV)、濕式加工 (Wet Process) 及電漿 (Plasma) 技術等設備。隨著 AI 技術及其應用，如雲端計算伺服器、大數據分析、AI 模型的訓練與推理、自動駕駛等領域展現出巨大的成長潛力，半導體先進封裝技術——特別是利用 2.5D/3D 晶片堆疊技術——已成為滿足這些需求的關鍵。這些技術通過將多種晶片整合封裝到一個基板上，不僅縮小了晶片之間的線路間距，還實現了更小的尺寸、更低的功耗、成本節省及性能提升等優勢。

作為全球半導體領域領先廠商的重要設備供應商，我們計劃將創新技術應用到這些先進封裝領域中，以支持 AI 技術的迅速發展和新興需求，並與 G2C+ 策略夥伴技術與市場連結，將過去幾十年來累積的設備核心技術，作為營運上堅實的基礎，將創新技術延伸應用到其他產業，擴大營業與海外觸角，期望深化並擴展核心技術及智動化 AI，提供客戶更完整全面的產品及服務。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 外部競爭環境

隨著半導體行業的不斷進步，台灣在先進封裝技術方面的領先地位尤為關鍵，尤其在 CoWoS (晶片上晶片) 和 HBM (高頻寬記憶體) 等領域。

這些技術為 AI、大數據、高性能計算等前沿應用提供了強大的支持。做為這一進程的核心參與者，我們公司在印刷電路板 ABF/BT 載板製程的壓膜機與剝膜機、IC 封裝烤箱等關鍵設備方面已經取得了全球領導地位。在持續的技術創新引領下，我們計畫在台灣、東南亞及歐美日市場進一步深耕，特別是在 CoWoS 與 HBM 等先進封裝技術領域，我們將持續加強研發投入，並與 G2C+ 合作夥伴攜手，共同推動半導體行業向更高效、更環保、更創新的方向發展。

隨著全球對高性能計算能力需求的不斷提高，我們相信，透過不斷的技術創新與市場策略調整，我們將能夠在激烈的全球競爭中保持領先，為全球領先客戶提供更多元、更高質的產品與服務，共同開創 IC 載板、半導體先進封裝與 HBM 記憶體產業的新未來。

(二) 法規環境

志聖本著合法經營、善盡社會責任為主，對於法規環境的變化也因專業經理人的應變及法律專家的諮詢而得以合法遵循。

(三) 總體經營環境

志聖經營設備產業面廣泛，橫跨 AI PCB、半導體載板、SEMI、先進封裝、Printing & Coating 等產業。隨著客戶策略的變動更突顯核心競爭力的重要。

近年受中美關係、川普政府關稅政策變動等國際情勢影響，使得產業鏈及貿易生態產生巨大的轉變。我們以扁平化組織組成變形蟲隊形，靈活協作及敏捷地適應大環境轉變；並發展多面向的產學合作，藉以深化並擴大核心技術；志聖及 G2C+ 聯盟夥伴以 T 型策略，橫向連結聯盟夥伴資源並整合跨領域技術、縱向落實隱形冠軍精神，榮獲 2023 與 2025 年 TSMC 優良供應商卓越表現獎，表彰志聖在量產支援方面的卓越表現。

展望 2026 年，志聖擴大 G2C+ 聯盟夥伴的陣容，以創新模式穩固及深化既有產品與客戶，倍增半導體設備的營收比重，配合 ESG 與 AI 趨勢開拓新行業與新應用；搭配產業在地化趨勢，提供 One Stop Solution 一站式服務，滿足客戶需求；落實「合力共創、同行致遠」的精神，為顧客、股東及員工創造更大的價值，同時善盡企業社會責任。

最後 敬祝各位股東女士、先生

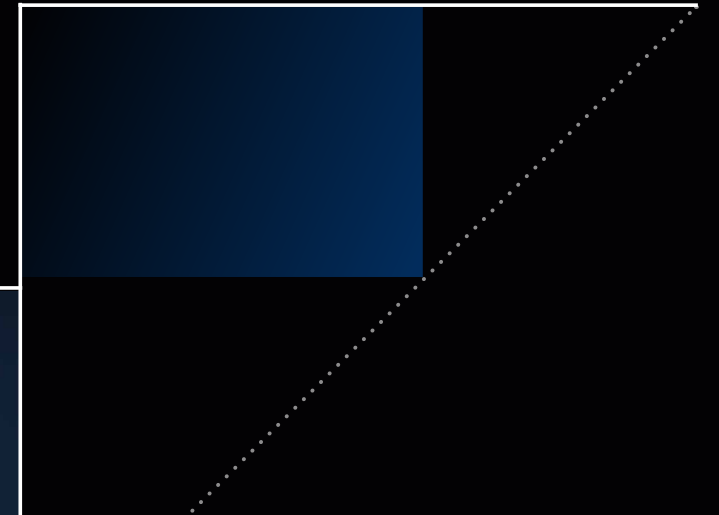
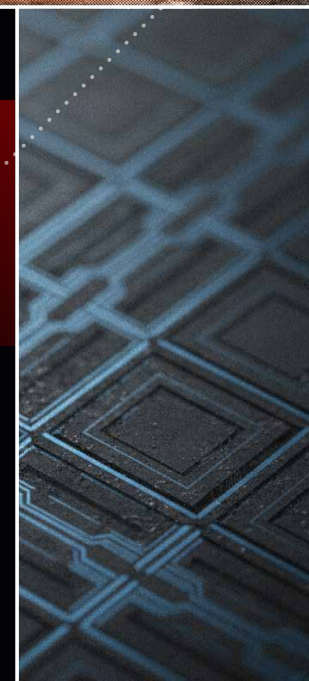
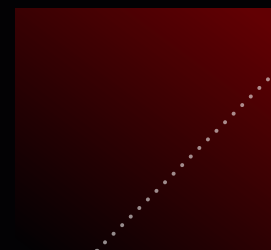
身體健康 萬事如意



梁茂生
董事長 梁茂生

2

公司治理報告



一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一) 董事及監察人資料：

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份 (註2)		現在持有股數 (註2)		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	梁茂生	男 71~80 歲	114.5.27	3 年	67.4.18	2,377,866	1.52%	2,377,866	1.52%	346,222	0.22%	無	—	台灣大學化工系學士 政大企業家班第七期結業 台灣電路板協會 (TPCA) 副理事長 電子設備協會 (TEEIA) 副理事長 台日產業技術合作促進會 (TJCIT) 監事 電路板環境公益基金會 (TPCF) 副董事長 台灣顯示器產業總會 (TDUA) 副理事	擎邦國際科技工程 (股) 公司董事 華達創業投資股份有限公司董事	—	—	—	—
董事	中華民國	朕昇 (股) 公司	—	114.5.27	3 年	114.5.27	1,928,237	1.23%	2,556,237	1.63%	—	—	無	—	—	—	—	—	—	—
		代表人：梁又元	男 41~50 歲	114.5.27	3 年	114.5.27	7,465	0.00%	2,001	0.00%	—	—	無	—	中興大學 EMBA 首固 (上海) 有限公司 董事	本公司董事	—	—	—	—
董事	中華民國	均豪精密工業 (股) 公司	—	114.5.27	3 年	114.5.27	19,957,082	12.73%	19,957,082	12.73%	—	—	無	—	—	—	—	—	—	—
		代表人：嚴璐	女 41~50 歲	114.5.27	3 年	114.5.27	1,000	0%	1,000	0%	—	—	無	—	美國西北大學整合行銷碩士 東台精機 (股) 公司副總兼發言人 東捷科技 (股) 公司法人董事代表人	本公司董事 東台精機 (股) 公司 副總兼發言人 東捷科技 (股) 公司 法人董事代表人 榮田精機股份有限公司法人董事代表人 銳洋精密股份有限公司法人董事代表人 六赫茲股份有限公司董事長 祿妍投資有限公司董事長 亞太菁英股份有限公司董事 富臨科技工程股份有限公司董事 朴子精密企業股份有限公司董事	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	劉士源	男 51~60 歲	114.5.27	3 年	114.5.27	—	—	—	—	—	—	無	—	台北科技大學能源與冷凍空調工程系 洋基工程 (股) 公司總經理	本公司獨立董事 洋基工程 (股) 公司董事長 蘇州市洋基機電工程有限公司董事長 力多投資有限公司董事長 洋基運動育樂股份有限公司董事長	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	曹正鵠	男 51~60 歲	114.5.27	3 年	114.5.27	3,000	0%	3,000	0%	2,150	0%	無	—	淡江大學應用物理學系學士 南澳大學企管碩士 Orbotech Ltd., 大中華區總裁 KLA Corporation,Head of Flat Panel Display 奧寶新技有限公司 董事長 TEEIA 顧問 SID 產業顧問 東捷科技 (股) 公司獨立董事	本公司獨立董事	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	林書賢	男 51~60 歲	114.5.27	3 年	108.6.13	—	—	—	—	—	—	無	—	新應材股份有限公司董事 大昱光電股份有限公司董事 陞遠建設開發股份有限公司法人代表董事 先進微系統股份有限公司董事 展茂光電股份有限公司業務經理 美商 KLA-TENCOR 應用工程師 淡江大學化工系學士	準懋創新投資股份有限公司法人代表監察人 東鈺冷凍股份有限公司法人代表董事長 達振創業投資股份有限公司董事 大昱光電股份有限公司董事 陞遠建設開發股份有限公司法人代表董事 東捷科技股份有限公司法人代表董事	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	廖婉君	女 51~60 歲	114.5.27	3 年	114.5.27	—	—	—	—	—	—	無	—	美國南加大電機博士 國立臺灣大學 教務長 科技部工程技術研究發展司司長 國立臺灣大學電機工程學系系主任 國立臺灣大學計算機及資訊網路中心 網路組組長 國立臺灣大學 教授	本公司獨立董事 國立臺灣大學 副校長 國立臺灣大學 講座教授 國立臺灣大學電機工程學系特聘教授 台大校友創業投資管理顧問股份有限公司董事	—	—	—	—

法人股東之主要股東：詳下表。

註1：董事長與總經理或相當級者 (最高經理人) 為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應說明其原因、合理性、必要性及未來改善措施 (例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式) 之相關資訊：

本公司董事長與總經理互為一親等，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性；此外，董事長及總經理平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理。目前本公司已有下列具體措施：

- 1. 現任四席獨立董事分別在產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
- 2. 每年度安排各董事參加外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
- 3. 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- 4. 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

註2：梁茂生董事長 2,200,000 股，屬於「保留運用決定權之交付信託股份」。

註3：本公司於 114/5/27 董事改選；新任董事梁茂生、梁又元、嚴璐、劉士源、曹正鵠、林書賢及廖婉君 114/5/27 選任生效。

法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
朕昇 (股) 公司	梁碧真	25%
	梁淨閔	25%
	梁又元	25%
	梁又丰	25%
均豪精密工業 (股) 公司 (註)	志聖工業股份有限公司	27.13%
	均豪精密工業股份有限公司庫藏股專戶	2.23%
	兆銀託管日商麥克尼可司株式會社投資專戶	1.65%
	元大證券股份有限公司	0.55%
	陳政興	0.48%
	大通託管 J P 摩根證券有限公司投資專戶	0.46%
	花旗託管柏克萊資本證券有限公司投資專戶	0.45%
	卓一郎	0.43%
	匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶	0.34%
	花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	0.30%

(註) 資料來源取自該公司民國 115 年 3 月 20 日停止過戶日之資料。

註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。
註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱（其持股比率占前十名）及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。
註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人（可參考司法院公告查詢）名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

主要股東為法人者其主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
志聖工業股份有限公司	均豪精密工業股份有限公司	12.73%
	海杏投資股份有限公司	11.37%
	品志投資股份有限公司	7.91%
	梁茂忠	4.39%
	梁茂生	2.92%
	志聖工業股份有限公司庫藏股專戶	2.81%
	花旗託管挪威中央銀行投資專戶	2.30%
	渣打託管 S P D R 組合新興市場 E T F 專戶	2.19%
	匯豐 (台灣) 銀行託管高盛國際公司投資專戶	1.90%
	簡進士	1.79%
	朕昇股份有限公司	1.63%
元大證券股份有限公司	元大金融控股股份有限公司	100%
註 1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人股東名稱。 註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱（其持股比率占前十名）及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。 註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人（可參考司法院公告查詢）名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。		

(二) 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

1. 董事及監察人專業資格

項目	專業資格與經驗 (註 1)	獨立性情形 (註 2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
梁茂生 梁又元 嚴璐	董事專業資格與經驗請 參閱本年報「參、二、 (一) 董事及監察人資 料」	不適用	—
林書賢 曹正鵠 劉士源 廖婉君		所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行 公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註 2) 相關規定 2. 本人 (或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所 取得之報酬金額	—
			—
			—
	—		

註 1：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。

2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。

3. 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者。

4. 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。

5. 使用票據經拒絕往來尚未期滿者。

6. 無行為能力或限制行為能力者。

7. 受輔助宣告尚未撤銷。

註 2：1. 非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。

2. 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。

3. 選任前二年及任職期間無下列情事之一：

(1) 公司或其關係企業之受僱人。

(2) 公司或其關係企業之董事、監察人。

(3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。

(4)(1) 所列之經理人或 (2)、(3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5) 直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。

(7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 (理事)、監察人 (監事) 或受僱人。

(8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 (理事)、監察人 (監事)、經理人或持股 5% 以上股東。

(9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事 (理事)、監察人 (監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

2. 董事會多元化及獨立性：

- (1)本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
- (2)本公司持續進行之董事繼任計畫，依以下標準建置董事人選資料庫：
- I.誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
 - II.具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
 - III.預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並積極遴選 2 席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆需符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
- (3)本公司訂定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括董事會議運作效率、內部

關係經營與溝通、成員組成及能力、董事自評等，以確認董事會有效運作，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

董事會成員多元化政策：

1. 本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第三章第二十條所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，其包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

2. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體須具備之能力如下：

- (1) 營運判斷能力。
- (2) 會計及財務分析能力。
- (3) 經營管理能力。
- (4) 危機處理能力。
- (5) 產業知識。
- (6) 國際市場觀。
- (7) 領導能力。
- (8) 決策能力。

董事會成員多元化具體管理目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。具體管理目標如下：

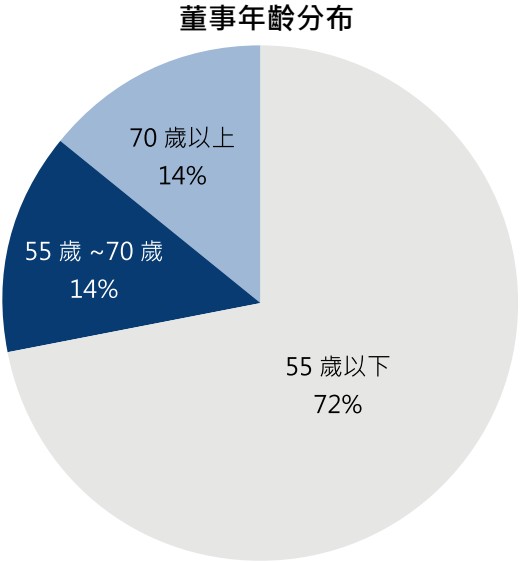
- 1.本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
- 2.本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
- 3.獨立董事不得連任超過 3 屆，以保持其獨立性。
- 4.董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次 1/3，以達監督目的。

董事會成員多元化達成情形：

為強化公司治理並促進董事會組織之健全，本公司董事成員考量多元化，並就營運型態及發展需求，遵行以適當多元方針選任董事成員。公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產

業決策與管理等各項能力，本公司亦持續為董事成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能。

本公司現任董事成員共 7 位，其中包含獨立董事 4 席，占比為 57.14%，4 位獨立董事任期皆未連任超過 3 屆以上，以確保董事會之獨立性；兼任員工身分有 2 位，占比為 28.6%；女性董事 2 席，占比為 28.6%。



本公司重視董事會之專業性、多元化及獨立性，持續依據公司治理最佳實務原則優化董事會結構。董事會成員具備多元且互補之專業背景，涵蓋產業經驗、經營管理、財務會計、法律、風險管理及公司治理等領域，並擁有上市櫃公司之經營企業管理實務，經營管理資歷甚豐，各具相關產業之專業背景，及具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養，能有效提升董事會決策品質與監督功能。



本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

- (1)原因說明：本公司高度重視董事會成員之性別平等及多元化背景。目前董事會成員男性占 71.4%(5 位)，女性占 28.6%(2 位)，未達三分之一之係因受限於產業特定技術背景要求，致短期內合適之女性專業人才媒合不易。
- (2)採行措施：本公司已規劃於下屆董事會屆滿改選時，尋求產業或學校等多方管道人才舉薦增加女性董事席次，預計增加 1~2 名女性董事，確保任一性別董事席次達三分之一以上，藉此落實董事會多元化政策，並提升決策品質與治理效能。

目前本公司董事會七位成員具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

董事會成員多元化政策落實情形							
職稱	董事長	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	梁茂生	梁又元	嚴璐	林書賢	曹正鵠	劉士源	廖婉君
年齡 70 以上	●						
年齡 55~70							●
年齡 55 以下		●	●	●	●	●	
兼任本公司員工	●	●					
專業知識及才能							
商務	●	●	●	●	●	●	●
科技	●	●	●	●	●	●	●
財務 / 會計		●			●		
行銷	●	●	●			●	
能力與經驗							
領導力	●	●	●	●	●	●	●
決策力	●	●	●	●	●	●	●
國際觀	●	●	●	●	●	●	●
產業知識	●	●	●	●	●	●	●
財務管理能力	●	●			●		
營運及製造	●	●	●	●	●	●	●
業務開發	●	●		●	●	●	●
風險管理 / 危機處理	●	●	●	●	●	●	●
環境永續	●	●			●	●	●
社會參與	●	●	●		●	●	●

(三) 董事及獨立董事進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事	梁茂生	114/5/5	114/5/5	社團法人中華公司治理協會	川普 2.0、全球化之死與區域戰爭	3
		114/10/3	114/10/3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年防範內線交易宣導會	3
董事	梁又元	114/6/24	114/6/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人 (含獨立) 暨公司治理主管實務研習班	12
董事	嚴璐	114/7/11	114/7/11	社團法人台灣董事學會	跨世代人才管理與永續準則 IFRS S1/S2 導入實務	6
獨立董事	林書賢	114/02/18	114/02/18	社團法人中華公司治理協會	【董聯會】當前全球經濟情勢 (Current Global Economic Situation)	3
		114/02/21	114/02/21	社團法人中華公司治理協會	川普 2.0、全球化之死與區域戰爭	1
		114/03/11	114/03/11	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
		114/04/25	114/04/25	社團法人中華公司治理協會	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3
獨立董事	曹正鵠	114/7/9	114/7/9	臺灣證券交易所與國泰金控	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		114/7/25	114/7/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		114/11/14	114/11/14	社團法人中華公司治理協會	數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛擬資產的發展趨勢	2.5
		114/11/21	114/11/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		114/12/5	114/12/5	社團法人中華公司治理協會	永續資訊揭露不實 (漂綠) 的法律責任分析	3
獨立董事	廖婉君	114/7/25	114/7/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		114/10/3	114/10/3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年防範內線交易宣導會	3
獨立董事	劉士源	114/11/26	114/11/26	社團法人台灣專案管理學會 (TPMA)	上市櫃董事進修課程 - 接班團隊建構與人才發展	3
		114/11/27	114/11/27	中華民國公司經營暨永續發展協會	以風險管理推動企業永續發展	3

註：係指符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露

(四) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註	
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係			
總經理兼執行長	梁又文	男	中華民國	115.02.25	2,167,861	1.38%	-	-	無	-	政大企家班 第 40 屆 美國華盛頓州立大學商學碩士 MBA 畢 美國西北大學法律碩士畢 美國西北大學商學學程結業 視動自動化科技 (股) 公司監察人 東捷科技 (股) 公司獨立董事	台灣電路板協會 理事 社團法人台灣電子設備協會副理事長 台灣電子製造設備工業同業公會常務理事 均華精密工業 (股) 公司 董事長暨執行長 創峰光電科技 (股) 公司 董事長 薩摩亞商力永企業有限公司 董事長 福盟國際企業 (股) 公司 董事長 蘇州創峰光電科技 (股) 公司 董事 南通創峰光電設備有限公司 董事 廣信創業投資 (股) 公司 監察人 昇陽國際半導體 (股) 公司 法人董事代表人 樂林科技 (股) 公司董事長 / 法人董事 代表人 均豪精密工業 (股) 公司 副董事長暨執行長 宇辰系統科技股份有限公司 獨立董事 敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人 台大校友創業投資管理顧問股份有限公司法人董事代表人	無	無	無	-	無	
副總經理	汪建宏	男	中華民國	109.08.01	68,018	0.04%	664	0.00%	無	-	黎明技術學院 / 機械	志聖科技 (廣州) 有限公司董事長	無	無	無	-	無	
行政副總	童寶煒	男	中華民國	115.02.25	127,113	0.08%	-	-	無	-	東海大學 / 企業管理	無	無	無	無	-	無	
營運長	曾文進	男	中華民國	114.08.05	60,372	0.04%	-	-	無	-	彰化師範大學機光電工程學碩士畢 逢甲大學機械系學士畢	視動自動化科技股份有限公司 法人董事代表人	無	無	無	無	-	無
營運長	呂邦超	男	中華民國	114.08.05	30,610	0.02%	-	-	無	-	中興大學機械所碩士畢 勤益科技大學流通管理碩士畢 勤益科技大學機械系學士畢	無	無	無	無	無	-	無
協理	吳晏城	男	中華民國	107.10.05	103,301	0.07%	-	-	無	-	逢甲大學 / 工業工程與系統管理	樂林科技 (股) 公司 監察人	無	無	無	無	-	無

註 1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註 2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 3：總經理或相當職務者 (最高經理人) 與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施 (例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式) 之 相關資訊：本公司董事長與總經理互為一親等，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性；此外，董事長及總經理平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理。目前本公司已有下列具體措施：

1. 現任獨立董事分別在產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。

2. 每年度安排各董事參加外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。

3. 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。

4. 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

(五) 最近年度支付董事、獨立董事、總經理及副總經理之酬金

(1) 一般董事及獨立董事之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）：

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅後純益 之比例 (註 10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總額 及占稅後純益之比 例 (註 10)		領取來自子公司 以外轉投資 事業或母公司 酬金 (註 11)	
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)				薪資、獎金及特 支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)							
		(註 2)				(註 3)		(註 4)								(註 6)							
		本公司	財務報告內 所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內 所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內 所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內 所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內 所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內 所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內 所有公司 (註 7)	本公司		財務報告內 所有公司 (註 7)		本公司	財務報告內 所有公司 (註 7)		
																現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額				
董事長	梁茂生	—	—	—	—	4,717	4,717	—	—	4,717 0.57%	4,717 0.57%		9,589	9,589	77	77	312	—	312	—	14,695 1.77%	14,695 1.77%	—
副董事長	梁茂忠	—	—	—	—	1,589	1,589	—	—	1,589 0.19%	1,589 0.19%		4,490	4,490	8,397	8,397	—	—	—	—	14,476 1.74%	14,476 1.74%	—
董事	沈顯和	—	—	—	—	1,589	1,589	50	50	1,639 0.20%	1,639 0.20%		—	—	—	—	—	—	—	1,639 0.20%	1,639 0.20%	—	
董事	陳政興	—	—	—	—	1,589	1,589	50	50	1,639 0.20%	1,639 0.20%		—	—	—	—	—	—	—	1,639 0.20%	1,639 0.20%	—	
董事	朕昇 (股) 公司 代表人： 梁又元	—	—	—	—	1,690	1,690	50	50	1,740 0.21%	1,740 0.21%		1,555	1,555	58	58	19	—	19	—	3,372 0.41%	3,372 0.41%	—
董事	均豪精密 工業 (股) 公司 代表人： 嚴璐	—	—	—	—	1,740	1,740	60	60	1,800 0.22%	1,800 0.22%		—	—	—	—	—	—	—	1,800 0.22%	1,800 0.22%	—	
獨立董事	朱知遠	—	—	—	—	1,589	1,589	50	50	1,639 0.20%	1,639 0.20%		—	—	—	—	—	—	—	1,639 0.20%	1,639 0.20%	—	
獨立董事	林明杰	—	—	—	—	1,589	1,589	50	50	1,639 0.20%	1,639 0.20%		—	—	—	—	—	—	—	1,639 0.20%	1,639 0.20%	—	
獨立董事	林書賢	—	—	—	—	3,479	3,479	110	110	3,589 0.43%	3,589 0.43%		—	—	—	—	—	—	—	3,589 0.43%	3,589 0.43%	—	
獨立董事	劉士源	—	—	—	—	1,740	1,740	60	60	1,800 0.22%	1,800 0.22%		—	—	—	—	—	—	—	1,800 0.22%	1,800 0.22%	—	
獨立董事	曹正鵠	—	—	—	—	2,041	2,041	60	60	2,101 0.25%	2,101 0.25%		—	—	—	—	—	—	—	2,101 0.25%	2,101 0.25%	—	
獨立董事	廖婉君	—	—	—	—	1,639	1,639	50	50	1,689 0.20%	1,689 0.20%		—	—	—	—	—	—	—	1,689 0.20%	1,689 0.20%	—	
註：董事會成員已於民國 114 年 5 月 27 日全面改選。 1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： (1) 本公司董事酬金包括報酬及業務執行費用。 (2) 董事酬金評估項目：經營績效、永續績效及同業水準等。 (3) 董事之報酬依本公司章程規定，依其對公司營參與之程度、貢獻之價值，並參動國內外業界水準，授權董事會議定之。 綜合以上考量，主要因營收成長 27%，稅後淨利成長 18%，永續績效大幅提升 (公司治理評鑑級距大幅提升、榮獲金恆獎、ESG for Culture 影響力獎等)，故董事酬金較去年增加 28%，占稅後淨利 3%。 (4) 公司章程中亦明訂不高於年度獲利之 2.25% 作為董事酬勞，董事酬金給付原則： 1) 獨立董事皆擔任審計委員及薪酬委員，考量其所負職責、承循風險及投入時間，另酌訂合理酬金。 2) 業務執行費用為車馬費，依出席次數給付。 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務 (如擔任母公司 / 財務報告內所有公司 / 轉投資事業非屬員工之顧問等) 領取之酬金：無。																							

* 應請分別列示董事 (非獨立董事之一般董事) 及獨立董事相關資訊。

(2) 酬金級距表：

給付本公司各個董事酬金級距	民國 114 年度			
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司 (註 8)	財務報告內所有公司 (註 9) H	本公司 (註 8)	財務報告內所有公司 (註 9) I
低於 1,000,000 元	—	—	—	—
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	梁茂忠、沈顯和、陳政興、 朕昇 (股) 公司 代表人：梁 又元、均豪精密工業 (股) 公司 代表人：嚴璐、朱知 遠、林明杰、劉士源、廖婉 君	梁茂忠、沈顯和、陳政 興、朕昇 (股) 公司 代 表人：梁又元、均豪精密 工業 (股) 公司 代表人： 嚴璐、朱知遠、林明杰、 劉士源、廖婉君	沈顯和、陳政興、 均豪精密工業 (股) 公司 代表人： 嚴璐、朱知遠、 林明杰、劉士源、 廖婉君	沈顯和、陳政興、均豪精 密工業 (股) 公司 代表人： 嚴璐、朱知遠、林明杰、 劉士源、廖婉君
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	曹正鵠	曹正鵠	朕昇 (股) 公司 代表人：梁又元、 曹正鵠	朕昇 (股) 公司 代表人：梁 又元、曹正鵠
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	梁茂生、林書賢	梁茂生、林書賢	林書賢	林書賢
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—	梁茂生、梁茂忠	梁茂生、梁茂忠
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	—	—	—	—

註 1：董事姓名應分別列示 (法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指最近年度董事之報酬 (包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用 (包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工 (包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工) 所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工 (包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工) 取得員工酬勞 (含股票及現金) 者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 7：應揭露合併報告內所有公司 (包括本公司) 給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 9：應揭露合併報告內所有公司 (包括本公司) 給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 11：

a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額 (若無者，則請填「無」)。

b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞 (包括員工、董事及監察人酬勞) 及業務執行費用等相關酬金。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(3) 總經理及副總經理之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)：

職稱	姓名	薪資 (A) (註 2)		退職退休金 (B)		獎金及 特支費等 (C) (註 3)		員工酬勞金額 (D) (註 4)				A、B、C 及 D 等四 項總額及占稅後純益 之比例 (%) (註 8)		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金 (註 9)
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 5)	本公司		財務報告內 所有公司 (註 5)		本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
								現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額			
執行長	梁茂生	2,424	2,424	77	77	7,165	7,165	312	-	312	-	9,978 1.20%	9,978 1.20%	-
副執行長	梁茂忠	1,406	1,406	8,397	8,397	3,084	3,084	-	-	-	-	12,887 1.55%	12,887 1.55%	-
總經理	梁又文	2,836	3,899	108	108	20,489	20,754	891	-	891	-	24,324 2.96%	25,652 3.09%	-
副總經理	汪建宏	1,950	1,950	108	108	1,551	1,551	67	-	67	-	3,676 0.44%	3,676 0.44%	-
營運長	曾文進	1,788	1,788	95	95	3,997	3,997	174	-	174	-	6,054 0.73%	6,054 0.73%	-
營運長	呂邦超	1,714	1,714	87	87	4,072	4,072	177	-	177	-	6,050 0.73%	6,050 0.73%	-

* 不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者 (例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

(3) 總經理及副總經理之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）：

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	民國 114 年度	
	本公司（註 6）	財務報告內所有公司（註 7）
低於 1,000,000 元	－	－
1,000,000 元（含）～ 2,000,000 元（不含）	－	－
2,000,000 元（含）～ 3,500,000 元（不含）	－	－
3,500,000 元（含）～ 5,000,000 元（不含）	汪建宏	汪建宏
5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元（不含）	梁茂生 / 曾文進 / 呂邦超	梁茂生 / 曾文進 / 呂邦超
10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元（不含）	梁茂忠	梁茂忠
15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元（不含）	梁又文	梁又文
30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元（不含）	－	－
50,000,000 元（含）～ 100,000,000 元（不含）	－	－
100,000,000 元以上	－	－
總計	－	－

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。
註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金）。
註 5：應揭露合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註 7：應揭露合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 9：
a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額（若無者，則請填「無」）。
b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。
* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(5) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

職稱（註 1）	姓名（註 1）	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（%）
經理人	執行長	梁茂生	－	2,082	0.25%
	副執行長	梁茂忠			
	總經理	梁又文			
	副總經理	汪建宏			
	營運長	曾文進			
	營運長	呂邦超			
	協理	童寶煒			
	協理	吳晏城			
	財務主管	張瓊瑤			
	會計主管	賴秋燕			

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。
註 2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：
(1) 總經理及相當等級者
(2) 副總經理及相當等級者
(3) 協理及相當等級者
(4) 財務部門主管
(5) 會計部門主管
(6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

(六) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金佔稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：

1. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：

(1) 董事及經理人績效評估與酬金政策如下：

志聖參考市場薪資報酬標準及同業通常水準，訂定董事及經理人的薪資報酬方案。在薪酬決策過程中，綜合考量以下因素，以確保公平性與競爭力：

- 所擔負的職責與投入的時間
- 目標達成情況與個人績效表現
- 在其他職位的整體表現
- 公司近年來對同等職位的薪資報酬標準

此外，志聖評估個人績效與公司經營成果及未來風險之間的合理關聯，兼顧公司短期與長期業務目標及財務狀況，以確保薪酬機制的合理性與穩健性。

(2) 薪酬政策

根據本公司章程第 31 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥 1%~9% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；且前述員工酬勞中以不低於 45% 提撥為分派予基層員工之酬勞。

本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不超過 2.25% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

(3) 經理人薪酬政策

志聖的經理人薪酬制度與公司經營績效緊密連結，目標在於強化經營效率並創造長期股東價值。薪酬架構包括：

- 固定薪資：提供穩定報酬，以吸引及留任優秀人才。
- 變動獎金：依據個人績效與公司經營成果進行發放，以激勵管理團隊提升績效。

為確保薪酬制度與公司營運績效及永續發展策略相符，自 2023 年起，變動薪酬與永續發展策略及目標掛鉤，以推動企業長遠經營。此外，在核定高階經理人薪酬時，薪資報酬委員會亦與外部專業薪資顧問合作，以確保薪酬具市場競爭力，並符合市場趨勢。

(4) 薪資報酬委員會職責與運作

薪資報酬委員會負責定期檢討董事及經理人的績效評估標準、薪酬政策及制度，確保其符合公司發展策略與市場水準。當年度的績效目標檢視及酬勞分配內容，皆需經薪資報酬委員會確認通過。

2025 年，薪資報酬委員會出席率達 94.44%，董事會亦完全採納薪資報酬委員會之建議，無修改或駁回情事。透過薪資報酬委員會的完善運作，志聖確保董事及經理人的績效評估與薪資決策符合合理標準，維護公司利益，並展現對薪酬制度的透明性與定期檢討之重視。

二、公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形：

(1) 最近年度董事會開會 11 次 (A)，董事、獨立董事出 (列) 席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列) 席次數 (B)	委託出席次數	實際出 (列) 席率 %【 B / A 】	備註
董事長	梁茂生	11	0	100	114.5.27 連任
副董事長	梁茂忠	4	0	100	-
董事	沈顯和	3	1	75	-
董事	陳政興	4	0	100	-
獨立董事	林明杰	4	0	100	-
獨立董事	朱知遠	4	0	100	-
獨立董事	林書賢	11	0	100	114.5.27 連任
董事	梁又元	6	0	85.71	114.5.27 新任
董事	嚴璐	7	0	100	114.5.27 新任
獨立董事	曹正鵠	7	0	100	114.5.27 新任
獨立董事	劉士源	7	0	100	114.5.27 新任
獨立董事	廖婉君	4	1	57.14	114.5.27 新任

屆數	第 19 屆						
日期	2025/5/27	2025/6/4	2025/8/5	2025/9/8	2025/10/7	2025/11/7	2025/12/19
梁茂生	V	V	V	V	V	V	V
梁又元	V	V	V	V	—	V	V
嚴璐	V	V	V	V	V	V	V
曹正鵠	V	V	V	V	V	V	V
劉士源	V	V	V	V	V	V	V
廖婉君	—	—	V	V	—	V	V
林書賢	V	V	V	V	V	V	V

其他應記載事項：

- 一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
- (一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱本年報審計委員會運作情形。
- (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
梁茂生	董事酬勞分配案	與董事自身有利害關係	不參與表決

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標 (例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等) 與執行情形評估：

- (1) 規劃策略經營議案之討論方式。
- (2) 本公司致力提升資訊透明度，相關資訊皆於公開資訊觀測站公告，以維護股東權益。
- (3) 本公司設置薪資報酬委員會，負責協助董事會定期評估及檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (4) 本公司於 2025 年 11 月 7 日經董事會決議，將原「永續經營委員會」與「風險管理委員會」整合，更名為「永續發展暨風險管理委員會」，並訂定「永續發展暨風險管理委員會組織規程」。公司將持續強化治理韌性，兼顧員工、股東、客戶及供應商等利害關係人權益，落實企業公民責任。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1) 年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出 (列) 席率 (%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出 (列) 席次數計算之。

(2) 年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出 (列) 席率 (%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出 (列) 席次數計算之。

(2) 董事會評鑑執行情形：

評估週期 ^(註 1)	評估期間 ^(註 2)	評估範圍 ^(註 3)	評估方式 ^(註 4)	評估內容 ^(註 5)
每年 執行一次	114.5.27~ 114.12.31	董事會績效評估、個別 董事會績效評估、審計 委員會績效評估、薪資 報酬委員會績效評估	董事成員自評	董事會績效評估： 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 個別董事會績效評估： 1. 對公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 審計委員會績效評估： 1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 內部控制 薪資報酬委員會績效評估： 1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資報酬委員會決策品質 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任
每三年 執行一次	113.1.1~ 113.12.31	董事會績效評估	委任外部專業 機構評估	1. 董事會專業職能 2. 董事會決策效能 3. 董事會對於企業內部控制之監督 4. 對永續經營之態度

2025 年度董事會及功能性委員會績效評估報告

► 2025 年度董事會及成員績效評估報告

董事會評估問券 _ 綜合評分 4.89 分

五大面向，18 項評估：

評估項目	綜合評分	4.89
A. 對公司營運之參與程度	A 項 4 題，平均得分	4.93
B. 提升董事會決策品質	B 項 4 題，平均得分	4.50
C. 董事會組成與結構	C 項 3 題，平均得分	5.00
D. 董事之選任及持續進修	D 項 4 題，平均得分	5.00
E. 內部控制	E 項 3 題，平均得分	5.00

董事成員評估問券 _ 綜合評分 5.00 分

六大面向，19 項評估：

評估項目	綜合評分	5.00
A. 公司目標與任務之掌握	A 項 3 題，平均得分	5.00
B. 董事職責認知	B 項 3 題，平均得分	5.00
C. 對公司營運之參與程度	C 項 4 題，平均得分	5.00
D. 內部關係經營與溝通	D 項 3 題，平均得分	5.00
E. 董事之專業及持續進修	E 項 3 題，平均得分	5.00
F. 內部控制	F 項 3 題，平均得分	5.00

► 2025 年度功能性委員會績效評估報告

審計委員會評估問券 _ 綜合評分 5.00 分

四大面向 15 項評估：

評估項目	綜合評分	5.00
A. 對公司營運之參與程度	A 項 3 題，平均得分	5.00
B. 審計委員會職責認知	B 項 4 題，平均得分	5.00
C. 提升審計委員會決策品質	C 項 6 題，平均得分	5.00
D. 內部控制	D 項 2 題，平均得分	5.00

薪資報酬委員會評估問券 _ 綜合評分 5.00 分

四大面向 15 項評估：

評估項目	綜合評分	5.00
A. 對公司營運之參與程度	A 項 4 題，平均得分	5.00
B. 薪資報酬委員會職責認知	B 項 3 題，平均得分	5.00
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	C 項 6 題，平均得分	5.00
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	D 項 2 題，平均得分	5.00

- 註 1：係填列董事會評鑑之執行週期；每年執行一次。
- 註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間；對董事會 114 年 5 月 27 日至 114 年 12 月 31 日之績效進行評估。
- 註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 註 4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
- 註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：
- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
 - (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
 - (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

(3) 董事會職責：

- 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。具體管理目標如下：
- (A) 本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
- (B) 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
- (C) 獨立董事不得連任超過 3 屆，以保持其獨立性。
- (D) 董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次 1/3，以達監督目的。

(二) 審計委員會運作情形：

(1) 最近 (114) 年度至年報刊印日審計委員會開會 10 次 (A) ，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列) 席次數 (B)	委託出席次數	實際出 (列) 席率 %【 B / A 】	備註
獨立董事	林明杰	2	0	100	舊任
獨立董事	朱知遠	2	0	100	舊任
獨立董事	林書賢	10	0	100	114.5.27 連任
獨立董事	曹正鵠	8	0	100	114.5.27 新任
獨立董事	劉士源	6	1	75	114.5.27 新任
獨立董事	廖婉君	7	1	88	114.5.27 新任
其他應記載事項：					
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：					
(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。					
日期	會議名稱	內容			
114/02/25	第二屆第十五次審計委員會	1. 擬通過民國 113 年度財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 2. 本公司截至 113 年 12 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請 審議。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 3. 擬通過民國 113 內部控制制度有效性考核及聲明書。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 4. 擬通過民國 113 年營業報告書。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 5. 擬通過民國 113 年度盈餘分配案。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 6. 擬通過民國 113 年度盈餘轉增資發行新股案。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 7. 取得不動產案 - 世貿新都 B1。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 8. 子公司志聖科技廣州有限公司取得不動產案 (東莞辦公室) 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 9. 本公司庫藏股轉讓經理人及員工案，提請 公決。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 10. 擬發行限制員工權利新股予員工案。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。			
114/05/06	第二屆第十六次審計委員會	1. 擬通過民國 114 年度第一季財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 2. 本公司截至 114 年 3 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請 審議。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。			
114/08/05	第三屆第一次審計委員會	1. 擬通過民國 114 年度第二季財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 2. 本公司截至 114 年 6 月 30 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請 審議。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 3. 世貿大樓裝修規劃案 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 4. 捐贈案 - 逢甲大學 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 5. 本公司庫藏股轉讓經理人及員工案，提請 公決。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。			
114/09/08	第三屆第二次審計委員會	1. 擬參與臺中市西屯區逢大段土地標售案，提請 審議。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。			

114/10/07	第三屆第三次審計委員會	1. 本公司庫藏股轉讓經理人及員工案，提請 審議。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。
114/11/07	第三屆第四次審計委員會	1. 擬通過民國 114 年度第三季財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 2. 本公司截至 114 年 9 月 30 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請 審議。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議
114/12/19	第三屆第五次審計委員會	1. 2026 年年度稽核計畫，提請 通過。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 2. 2026 年年度計畫，提請 通過。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 3. 背書保證案 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 4. 現任會計師獨立性及適任性評估案。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 5. 本公司基層員工定義及內部控制制度之「薪工作業循環」修正案。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 6. 擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案，提請 公決。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。
115/01/27	第三屆第六次審計委員會	1. 不動產取得 _ 台中南屯區精科一路 12 號廠房案。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 2. 不動產取得 _ 台南善化區陽光三路 238 號宿舍案。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。
115/02/25	第三屆第七次審計委員會	1. 擬通過民國 114 年度財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 2. 本公司截至 114 年 12 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請 審議。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 3. 擬通過民國 114 年內部控制制度有效性考核及聲明書。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 4. 擬通過民國 114 年營業報告書。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 5. 擬通過民國 114 年度盈餘分配案。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 6. 擬通過民國 114 年度盈餘轉增資發行新股案。 決議：本案併同第五案一起討論，擬建議配發股利每股 5.5 元，本次股利分派以 現金方式為主，故本次不執行盈餘轉增資發行新股。經全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議 7. 更換簽證會計師案。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。 8. 擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案，提請 公決。 決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。
115/03/20	第三屆第八次審計委員會	1. 本公司擬擔任東捷科技股份有限公司私募普通股應募人案，提請審議。 決議：本案林書賢獨立董事及曹正鵠獨立董事，因兼任東捷科技股份有限公司董事、經理人或其他職務，與本案有利害關係，爰於本案審議時迴避，不參與討論及表決。除前開委員依法迴避外，其餘出席委員經主席徵詢後，無異議通過，並提請董事會討論。 1.核准本公司擔任東捷科技股份有限公司私募普通股應募人。 2. 核准本案投資總金額為新台幣 1,017,600 仟元。 3. 授權董事長依繳款通知辦理後續付款及股票過戶等相關事宜。 4. 授權董事長於執行過程中，得視實際情況調整相關細節，以符合法令及公司最佳利益。
公司對審計委員會意見之處理：經全體董事無異議通過。		
(三) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：本公司依證券交易法第 14 條之 5 規定執行且無上述所稱之未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。		
(四) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之審計委員會議決事項：無此情形。		

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 (應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)

(一) 獨立董事與內部稽核主管之溝通政策

1. 獨立董事與內部稽核主管至少每年舉行五次交流會議，就本公司內外部稽核查核主要檢查意見等議題進行充分溝通及作成紀錄，並將交流內容於董事會報告。
2. 本公司審計委員會是由全體獨立董事組成，內部稽核主管每年至少五次向審計委員報告稽核業務執行情形，其內容包括業務稽核執行情形、內部作業事項、稽核人員訓練及內外部稽核查核重大檢查意見及改善辦理情形等；若遇到重大異常事項時得隨時召集會議。

(二) 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通事項	建議及指正
114/02/25	1.113 年度內部稽核執行報告。 2.113 年內部控制制度聲明書。 3. 報告 113 年度查核報告查核結果。	經討論與溝通後，獨立董事對業務執行結果報告無異議。
114/05/06	1.114 年 Q1 內部稽核執行報告。 2. 報告 114 年 Q1 核閱報告核閱結果。	經討論與溝通後，獨立董事對業務執行結果報告無異議。
114/08/05	1.114 年 Q2 內部稽核執行報告。 2. 報告 114 年 Q2 核閱報告核閱結果。	經討論與溝通後，獨立董事對業務執行結果報告無異議。
114/11/07	1.114 年 Q3 內部稽核執行報告。 2. 報告 114 年 Q3 核閱報告核閱結果。	經討論與溝通後，獨立董事對業務執行結果報告無異議。
114/12/19	1. 內部稽核執行報告。 2.115 年度稽核計畫。	經討論與溝通後，獨立董事對業務執行結果報告無異議。
115/02/25	1.114 年度內部稽核執行報告。 2.114 年內部控制制度聲明書。 3. 報告 114 年度查核報告查核結果。	經討論與溝通後，獨立董事對業務執行結果報告無異議。

(三) 獨立董事與會計師之溝通政策

1. 本公司審計委員會是由全體獨立董事組成，會計師每年至少 4 次就 本公司財務狀況海內外子公司財務及整體運作情形及內控之查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

(四) 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通事項	建議及指正
114/02/25	113 年度度個體財務報表及合併財務報表。	業經審計委員會通過 113 年度財務報告及提報董事會通過並如期公告申報主管機關。
114/05/06	114 年第一季合併財務報表。	業經審計委員會通過 114 年度第一季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
114/08/05	114 年第二季合併財務報表。	業經審計委員會通過 114 年度第二季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
114/11/07	114 年第三季合併財務報表。	業經審計委員會通過 114 年度第三季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
115/02/25	114 年度度個體財務報表及合併財務報表。	業經審計委員會通過 114 年度財務報告及提報董事會通過並如期公告申報主管機關。

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率 (%) 以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率 (%) 則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 審計委員會職責：

根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。

本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- (A) 公司財務報表之允當表達。
- (B) 簽證會計師之選 (解) 任及獨立性與績效。
- (C) 公司內部控制之有效實施。
- (D) 公司遵循相關法令及規則。
- (E) 公司存在或潛在風險之管控。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目		運作情形 (註)		與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
		是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？		√		本公司已訂定公司治理實務守則，並揭露於本公司網站： https://www.csun.com.tw/investor-relations/ 公司治理
二、公司股權結構及股東權益	(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並依規定建立發言人制度，由股務單位及股務代理機構處理相關事宜，並於公司網站揭示聯絡窗口。
	(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		本公司每月依規定公告內部人持股情形，並隨時了解其異動情形，以掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。
	(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		本公司訂有「關係人交易作業程序」、「對子公司經營管理之監理作業辦法」等內部控制辦法，建立與關係企業之風險控管及防火牆機制，每年稽核單位依稽核計畫查核其執行情形。
	(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並可至本公司公司網站查詢，每年視需要辦理宣導課程。	√		本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並可至本公司公司網站查詢，每年視需要辦理宣導課程。
三、董事會之組成及職責	(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		本公司訂有「公司治理實務守則」，董事會成員皆具備執行職務所必需之知識、技能及素養，並已設置獨立董事，各獨立董事成員皆具不同產業背景之專長，落實董事會成員多元化。
	(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	√		本公司除依法設置薪資報酬委員會外，另設有由經營團隊所組成之企業永續委員會，執行狀況及成果可至本公司公司網站查詢。
	(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		本公司已訂定董事會績效評估暨酬勞與報酬給付辦法，每年定期對董事會之績效進行評估，每年年度結束後，就公司目標、董事職責、進修等面向，以問卷自我評量方式進行績效評估。評估程序於受評年度結束後至最近一次召開之董事會開會前完成，並將 評分結果報告董事會，以提升董事會運作之功能。董事會績效評估辦法及結果已揭露於本公司網站，另 114 年度董事會及功能性委員會績效評估結果業已於 115 年 2 月 25 日向董事會報告。 本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。本公司委任「社團法人臺灣誠正經營學會」執行董事會效能評估（執行年度為 113 年，受評年度為 113 年度），該機構委派三位執行委員進行評估，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性出具獨立性聲明。社團法人臺灣誠正經營學會以四大構面進行董事會效能評估：董事會專業效能、董事會決策效能、董事會對內部控制之重視程度與監督及董事會對永續經營之態度，透過取得公司內部規範及紀錄、評估問卷及董事個別訪談之方式評核，並於 113 年 12 月 17 日出具董事會效能評估報告向董事會報告。
				無差異

	(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		每年由審計委員會及董事會評估現任會計師之獨立性及適任性；於審查會計師前，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標 (AQIs)」外，並依標準與 13 項 AQI 指標進行評估。經確認簽證會計師與本公司除簽證及稅務案件之費用外，無其他財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水平，另於最近 3 年也將持續導入數位審計工作，提高審計品質。另函請本公司股務代理機構確認其持股情形，經本公司財會單位審查確認符合獨立性及適任性後，送請審計委員會進行審議，提報董事會決議，民國 114 年度會計師審查評核表業已於民國 114 年 12 月 19 日提報審計委員會及董事會通過。本公司評估會計師獨立性要件審查、運作及適任性檢查重要標準項目列舉如下： - 會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。 - 會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有資金借貸。 - 會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。 - 會計師最近二年並無會計師懲戒委員會懲戒紀錄。 - 會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 - 會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。 - 會計師並無現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。 - 會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，是否亦維持形式上之獨立性。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？	√			本公司由企業永續委員會負責推動公司治理相關事務，由財務處最高主管負責督導公司治理相關事宜，依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司登記及變更登記、安排董事進修課程等。 無差異
五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√			本公司設有發言人制度，與利害關係人均保持暢通之溝通管道，並於公司網站揭露相關業務人員之聯絡資訊及設置利害關係人專區，以妥善回應利害關係人所關切之包括企業永續發展在內之相關議題。 無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√			本公司已委任專業股務代理機構 - 統一綜合證券股務代理部處理股東會及股務相關事務。 無差異
七、資訊公開	(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	√		本公司已於網站，揭露相關財務業務及公司治理等相關資訊。 https://www.csun.com.tw/investor-relations 無差異

評估項目		運作情形 (註)			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
		是	否	摘要說明	
	(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式 (如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等) ?	√		本公司依規定定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務、業務資訊；並定期將產品、業務等最新消息揭示於本公司之網站：www.csun.com.tw	無差異
	(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√		本公司於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營收情形。	
	八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊 (包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等) ?	√		員工權益及僱員關懷 本公司成立職工福利委員會，推動各項補助活動，以確保員工權益。 投資者關係 本公司由專責單位依相關規定於公開資訊觀測站公告及公司網站揭露有關財務、業務等相關訊息，期能達到資訊透明公開。 供應商關係 本公司訂有「供應商管理程序」來審核供應商與公司的商業行為，避免損害雙方商譽及利益，必要時於供應商經審核完成後開始合作前，雙方簽署「保密合約」(NDA) 以保障雙方之權利與義務。 利害關係人之權利 本公司已於公司網站設置利害關係人專區，提供溝通管道以維護雙方之合法權益。 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估 客戶政策之執行情形 本公司平時與客戶皆保持密切聯繫，並建構專業的客服團隊及完善售服體系提供全方位優質服務，協助客戶提升競爭力並創造更高附加價值自許。 公司為董事及監察人購買責任保險之情形 本公司已為全體董事購買董監責任險，以降低並分散董事因錯誤或疏失之行為而造成公司及股東重大損害之風險，並已於公開資訊觀測站公告及於董事會報告投保情形。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 本公司秉持永續經營理念，將企業永續經營、與客戶及社會群體建立長期夥伴關係、善盡企業公民責任，於 106 年成立企業永續發展及誠信經營相關事宜，每年向董事會報告執行情形及結果。 改善項目： 1. 新官網持續優化：優化使用介面，提供豐富且公開的企業資料 / 貼近使用者需求，提供更快速且直接的聯絡窗口接洽。 2. 於本公司網站設置企業社會責任專區，讓投資人、客戶、供應商及利害關係人了解本公司企業永續發展推動及執行情形。 尚未改善優先加強事項與措施： 1. 持續優化新官網各項配置，使公司網站內容更符合投資人及相關利害關係人之需求。 2. 持續優化本公司網站之企業社會責任專區，讓投資人、客戶、供應商及利害關係人了解本公司企業永續發展推動及執行情形。					

(四) 公司如有設置薪酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1) 薪資報酬委員會成員資料：

身分別 (註 1)	姓名	條件	專業資格 與經驗 (註 2)	獨立性情形 (註 3)	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家數
獨立董事 (第二屆召集人)	林明杰 (註 4)		本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱本年报「參、二、(一) 董事及監察人資料」之說明。	所有薪酬委員會委員皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之六暨「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」(註)相關規定 2. 本人 (或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	1
獨立董事	朱知遠 (註 4)				-
獨立董事 (第三屆召集人)	林書賢 (註 5)				-
獨立董事	曹正鵠 (註 6)				-
獨立董事	劉士源 (註 6)				-
獨立董事	廖婉君 (註 6)				-

註：選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- (1) 公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
- (3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)(1) 所列之經理人或 (2)、(3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
- (7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 (理事)、監察人 (監事) 或受僱人。
- (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 (理事)、監察人 (監事)、經理人或持股 5% 以上股東。
- (9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事 (理事)、監察人 (監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 OO 頁附表一董事及監察人資料 (一) 相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他 (若為召集人，請加註記)。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬 (或利用他人名義) 持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司 (參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定) 之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註 4：114.5.27 任期屆滿解任：林明杰、朱知遠

註 5：114.5.27 改選後連任：林書賢

註 6：114.5.27 改選後新任：曹正鵠、劉士源、廖婉君

(2) 薪資報酬委員會職責

本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

(A) 訂定並定期檢討董事、獨立董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(B) 定期評估並訂定董事、獨立董事及經理人之薪資報酬。

(3) 薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員共計 4 人。
- 二、本屆委員任期：民國 114 年 5 月 27 日至 117 年 5 月 26 日，最近年度薪資報酬委員會開會 6 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列) 席次數 (B)	委託出席次數	實際出 (列) 席率 %【 B / A】	備註
第五屆召集人	林明杰	2	0	100	舊任
委員	朱知遠	2	0	100	舊任
第六屆召集人	林書賢	6	0	100	114.5.27 連任
委員	曹正鵠	4	0	100	114.5.27 新任
委員	劉士源	3	1	75	114.5.27 新任
委員	廖婉君	3	1	75	114.5.27 新任
其他應記載事項：					
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理 (如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。					
二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。					
日期	會議名稱	內容			
114/02/25	第五屆第十二次 薪酬委員會	1. 本公司民國 113 年度董事酬勞及員工酬勞總數及內容案。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 2. 擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及非經理人案。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。			
114/05/06	第五屆第十三次 薪酬委員會	1. 提請本公司 2025 年調薪擬議案，提請審議。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。			
114/08/05	第六屆第一次 薪酬委員會	1. 副執行長梁茂忠先生退休案。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 2. 本公司 2025 年經理人獎酬擬議案，提請審議。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 3. 本公司庫藏股轉讓經理人及非經理人案，提請審議。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。			
114/10/07	第六屆第二次 薪酬委員會	1. 本公司 2025 年經理人獎酬擬議案，提請審議。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 2. 本公司庫藏股轉讓經理人及非經理人，提請審議。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。			
114/12/19	第六屆第三次 薪酬委員會	1. 本公司經理人 2025 年績效評估結果及年終總所得內容案，提請審議。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 2. 本公司庫藏股轉讓經理人及非經理人案，提請審議。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。			
115/02/25	第六屆第四次 薪酬委員會	1. 經理人派任案 (1) 執行長 (2) 行政副總。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 2. 本公司民國 114 年度董事酬勞及員工酬勞總數及內容案 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 3. 擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案，提請 公決。 決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。			
公司對薪酬委員會意見之處理：經全體董事無異議通過。					

註：

(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有新薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	執行情形 (註 1)		無重大差異情形	
	摘要說明	否		
		是		
		推動項目		
本公司以董事會為永續發展相關議題之最高決策單位，於 2025 年成立功能性委員會：「永續發展暨風險管理委員會」，由梁又文總經理擔任委員會召集人暨主席，負責公司永續發展暨風險管理統籌及推動等相關事務，轄下設有產品創新、客戶關懷、經營管理、社會關懷、環境永續、環境永續、營運與策略風險、財務風險、法遵風險、資安風險、環境風險等 11 個小組，有效進行資源整合，將永續策略落實至各部處執行。	本公司以董事會為永續發展相關議題之最高決策單位，於 2025 年成立功能性委員會：「永續發展暨風險管理委員會」，由梁又文總經理擔任委員會召集人暨主席，負責公司永續發展暨風險管理統籌及推動等相關事務，轄下設有產品創新、客戶關懷、經營管理、社會關懷、環境永續、環境永續、營運與策略風險、財務風險、法遵風險、資安風險、環境風險等 11 個小組，有效進行資源整合，將永續策略落實至各部處執行。	永續發展暨風險管理委員會針對攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針，同時追蹤執行成效。委員會每年至少 1 次向董事會進行永續策略與專案執行成效報告。董事會定期聽取管理階層報告重大議題執行進度，針對管理階層報告內容評估策略可行性或提供其他建議方向，且追蹤執行進度和敦促管理階層評估調整規劃事項。2025 年召開之 12 場董事會中，其中 4 場董事會提及永續發展相關議案，占董事會場次數整體 33%。	無重大差異情形	
其討論議題包括： 1. 選舉風險管理委員會成員案。 2. 風險管理委員會運作情形報告。 3. 訂定「永續發展暨風險管理委員會組織規程」案。 4. 永續發展暨風險管理委員會運作情形 (1) 企業社會責任執行情形報告。 (2) 溫室氣體盤查及查證時程進度報告	本公司永續報告書揭露資訊涵蓋公司於 114 年 1 月至 114 年 12 月間在主要據點之永續發展績效表現，範圍包括林口總部、台北廠、台中廠營運與生產據點之資訊。 永續發展委員會根據公司產業特性與內部關注主題，並參考 GRI、SASB 準則、國內外永續趨勢、產業標準與同業資訊進行辨識，採交集方式鑑別產業中具共通性之主題。分析調查後，共辨識出 8 項重大主題，分別為：產品技術創新、公司治理、客戶服務 / 產品品質與安全、誠信經營、職業安全與衛生、人才吸引與留任、人才發展與培育、氣候變遷因應。 註：詳請見 P.53 附表 1。	V	無重大差異情形	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專 (兼) 職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	本公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專 (兼) 職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V	無重大差異情形	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ (註 2)	本公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ (註 2)	V	無重大差異情形	

推動項目	執行情形 (註 1)		與上市上櫃 公司永續發 展實務守則 差異情形及 原因															
	是	否		摘要說明														
		水資源管理 本公司長年關注水資源節能環保議題，自 112 年起於 CDP 碳揭露專案 (Carbon Disclosure Project) 公開揭露水資源數據，並於 CDP 水安全模組問卷中獲取 B 級成績。 近 2 年用水量： <table><tr><th>年度</th><th>用水量 (百萬公升)</th></tr><tr><td>2024</td><td>15,7297</td></tr><tr><td>2025</td><td>14,3800</td></tr></table> 【廢棄物管理】 本公司致力於環境保護，訂定廢棄物減量目標 目標設定 • 提高回收率：將企業內部可回收材料的回收率每年提高 5%。 • 設立基礎廢棄物管理制度：建立和完善廢棄物分類、收集、處理的制度和流程並持續宣導落實廢棄物分類、資源回收再利用等觀念。 近 2 年廢棄物量： <table><tr><th>年度</th><th>焚化廢棄物量 (公噸)</th><th>回收廢棄物量 (公噸)</th></tr><tr><td>2024</td><td>118.51</td><td>42.12</td></tr><tr><td>2025</td><td>106.6985</td><td>130.495</td></tr></table>	年度	用水量 (百萬公升)	2024	15,7297	2025	14,3800	年度	焚化廢棄物量 (公噸)	回收廢棄物量 (公噸)	2024	118.51	42.12	2025	106.6985	130.495	
年度	用水量 (百萬公升)																	
2024	15,7297																	
2025	14,3800																	
年度	焚化廢棄物量 (公噸)	回收廢棄物量 (公噸)																
2024	118.51	42.12																
2025	106.6985	130.495																
四、社會議題	(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	員工人權保障 志聖為善盡企業社會責任、保障全體同仁及利害關係人基本人權、杜絕任何侵犯及違反人權的行為，也遵守國內外之勞動、性別平等工作法相關法規並制定有關人權保障、勞動政策及執行相關措施。志聖遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等國際公認之人權標準訂定志聖公司人權政策，本政策適用於本公司全體員工以保障員工之權益。 志聖以董事會為最高層級的人權治理架構，由「永續發展暨風險管理委員會」下之永續發展小組成立跨部門之人權工作小組，並依法召開勞資會議，除提供員工多元溝通管道讓員工與管理階層間能夠公開直接進行溝通討論，同時宣導公司政策、福利措施及各項活動，使員工能意見得以充分表達，並適時給予回應和協助。並於不定期新人教育訓練及每月全公司月會進行人權政策宣導。																

		志聖人權政策與承諾 • 健康安全職場：重視職場安全與衛生，以建構安全健康的工作場所及零職災為目標，並定期檢視員工健康安全風險，並依辨識結果進行改善計畫。 • 員工自主性社團：本公司尊重員工的權利，員工可依法自由結社，設立多元社團，積極宣導同仁加入社團。 • 勞資協商：制定員工與管理階層間公開直接之溝通作業程序及提供員工多元溝通管道，宣導公司政策、制度、福利措施及各項活動，同時讓員工意見得以充分表達，並適時給予回應和協助。 • 多元包容與平等機會：提供員工性別平等與多元化的工作環境，秉持開放、公平的原則，不因個人性別、種族及身心障礙等有差別待遇。落實僱用、薪酬福利、訓練、考評與升遷之公平，且提供有效之申訴機制。 • 不僱用童工：符合當地的最低年齡的法律和規定，不僱用童工。 • 母性照護：落實母性保護計畫並建立母性保護措施 • 符合基本薪資與合理工時：提供員工符合甚至優於當地法令所要求之最低限度的工資與福利。 2025 年實績 • 健康安全職場：志聖於 2025 年召開 4 次職業安全衛委員會，檢討和改善員工的健康與安全風險，目標是建設零職災工作環境。 • 員工自主性社團：尊重員工自由結社，並設立愛心社、羽球社瑜珈等社團，為員工提供多元學習機會。 • 勞資協商：2025 年，北中廠區共舉行 6 次勞資會議，加強員工與管理層的有效溝通，並宣導公司政策、福利及活動。 • 多元包容與平等機會：志聖致力於提供性別平等和多元化工作環境，並強調公平僱用、薪酬及升遷機制，加入友善家庭職場企業聯盟，將家庭教育帶入職場，以多元議題講座，方便員工在職場就近學習，兼顧員工在工作與家庭的需要，協助員工平衡工作與家庭生活。 • 不僱用童工：公司 2025 年未僱用童工，並遵守當地法律，反對任何形式的童工雇用。	無重大差異情形
	V		

推動項目		執行情形 (註 1)		與上市上櫃 公司永續發 展實務守則 差異情形及 原因
		是	否	
				無重大差異 情形
				無重大差異 情形
				無重大差異 情形

				無重大差異 情形
				無重大差異 情形
				無重大差異 情形
				無重大差異 情形

推動項目	執行情形 (註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？			本公司發行之永續報告書主要依循全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 於 2021 年公布之 GRI 通用準則 2021(GRI Standards 2021)、永續會計準則委員會 SASB「工業機械與產品」、「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」及「上市上櫃公司氣候相關資訊」，並參考「氣候相關財務揭露框架 (Task Force on Climate related Financial Disclosures, TCFD)」進行編製。	無重大差異情形
			報告書資料及數據由永續經營委員會彙整，呈報董事會審議，在發行前取得董事會核准，並委託資誠聯合會計師事務所按照中華民國確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」針對所選定指標執行獨立有限確信 (limited assurance)，確信報告附於本報告書附錄。另針對品質管理系統 (ISO 9001)、職業安全衛生管理系統 (ISO 45001)、環境管理系統 (ISO 14001) 及溫室氣體盤查 (ISO 14064-1)，每年皆進行內部稽核及請外部機構進行溫室氣體盤查，確保資料及數據之正確性。永續報告書公開於本公司網站： https://www.csun.com.tw/esg/	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂有「企業社會責任守則」、「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」及「永續資訊管理作業辦法」並無重大差異，可至本公司網站或公開資訊觀測站下載；有關企業社會執行情形，請參閱本年報或公司網站。守則」，並依該守則管理公司對經濟、環境及社會之風險與影響，且據以改進。執行至今尚無差異情形。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：各項永續發展運作情形，請參考本公司網站或永續報告書。				

附表 1

重大議題	風險評估項目說明	說明
治理	公司治理	- 由全體獨立董事組成審計委員會，協助強化董事會的監督功能並提高治理績效，確保其有效監督的運作。 - 由薪酬委員會負責制定董事和經理人的績效評估標準，並定期評估其績效目標的達成情況，以此為制定個別薪資報酬的依據，並由薪酬委員會確保董事和經理人的薪酬與其貢獻和績效相符。 - 由二名獨立董事及總經理組成風險管理委員會，協助公司建立完善之風險管理制度，推動穩健經營與永續發展。 - 設立獨立稽核單位，利用內部稽核機制對公司的各項營運活動進行監督。 - 成立公司治理評鑑小組，強化公司治理相關制度與實務，針對公司治理評鑑指標進行分析與改善，提升公司治理品質。
	誠信經營	- 遵循最高道德標準的承諾應體現在所有商業活動中，包括但不限於與員工、客戶、供應商、競爭者、政府和公眾 (包含股東) 的關係。 - 建立內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置互相監督制衡機制。 - 針對各單位之高階主管進行多元誠信經營宣導，提升員工與管理層級之內線交易法規與誠信政策意識。
社會	人才吸引與留任	- 提供良好的工作環境和福利待遇，提高員工對工作的滿意度。 - 建立開放和透明的溝通渠道，鼓勵員工提出建議和意見，並參與公司決策。 - 定期舉辦員工活動和團隊建設活動，增強員工凝聚力和團隊合作。 - 提供具有競爭力的薪酬和福利計劃，包括基本工資、獎金、股票期權、醫療保險等。 - 建立定期的人力資源風險評估機制，分析可能影響人才吸引留任的內外部風險因素。 - 建立完善的危機應對計劃，包括應對員工流失、聲譽損害、工作環境問題等各種可能發生的危機情況。 - 及時回應員工的問題和疑慮，有效管理和解決可能影響員工滿意度和忠誠度的問題。
	人才發展與培育	- 建立專門的人才發展與培育計畫，包括定期的培訓課程和專業培育計畫，以提升員工的專業能力和職業素養。 - 提供員工晉升機會和培訓計劃，鼓勵他們不斷提升自己的技能和知識。 - 建立導師制度，讓員工可以得到來自導師的指導和支持。 - 建立風險評估流程，定期評估人才發展與培育計畫的風險和隱患，及時採取措施降低風險。加強對公司價值觀和道德規範的宣導和培訓，提高員工的職業道德意識，預防因道德問題而引起的負面事件。 - 建立投訴處理流程，及時處理員工提出的投訴和問題，確保公正和有效的解決。 - 舉辦道德倫理培訓和法律法規培訓，提高員工對於職業道德和法律法規的認識和遵從意識，避免和降低負面事件的發生。
	職業安全與衛生	- 以每月與特約醫護人員共同施行健康風險預測、風險管理及健康環境營造，關懷同仁健康。 - 北中各廠區職安巡查，皆保持稽查制度，每週至少 2 次以上。 - 實踐環安衛政策：遵守法令要求、落實教育訓練、有效利用資源、防範意外事件、持續推動改善、全員諮詢參與。
環境	氣候變遷因應	- 逐步推動集團完成合併溫室氣體盤查，並訂定溫室氣體減量目標。 - 評估購買綠電成本，逐年提升再生能源使用比例。 - 申請 SBTi - 獲取 CDP 分數：B-。 2030 年範疇一、範疇二減量 42% 2035 年範疇二減量 37.5%；2050 年達成淨零排放。 - 依循 TCFD 架構，定期執行關鍵氣候機會評估，並訂定因應措施及管理目標。 2025 年於三個先進封裝主力機型導入 ISO 14067 產品碳足跡盤查。 - 進行廠務設備汰舊換新及優化生產組裝之流程及技術，減少能源浪費。 - 鼓勵員工提出節能減碳研發方案，投入低碳產品服務開發。
產品	產品技術創新	- 獎勵創新研究：鼓勵全員參與研發，制定 PAC /YSK 提案改善獎勵與專利申請獎勵制度，提供額外獎金以激勵創新。2024 年發放 PAC /YSK 提案改善發出 61.8 萬元獎勵金； - 專利申請獎勵 50.9 萬元。2024 年合計發出 112.7 萬元。 - 人員教育訓練：安排創新研發課程，由內部資深同仁及外部專業講師授課，並鼓勵同仁參加外部研討會。 - 產學合作：台灣大學、清華大學、成功大學、中興大學、台科大、逢甲大學、高科大、高雄師範大學、勤益科大、明志科大等學校長期合作，整合學校研究資源，強化技術實力。 - 業界技術合作：與國內外研究機構和公司合作開發技術，提升研發設備和內部人員技術力及創新思維。組成 G2C+ 聯盟，整合聯盟公司資源，建立供應鏈和服務體系，提供客戶一站式服務。
	客戶服務 / 產品品質與安全	- 定期提供員工專業培訓，確保員工具備良好的溝通技巧與專業知識。 - 即時回應客戶需求，提供 24 小時客服支援或加快問題處理速度，減少客戶等待時間。 - 建立清晰的服務標準，確保所有客戶都能獲得一致的優質服務。 - 透過數據分析了解客戶偏好，並提供適時的關懷與建議。 - 根據客戶的需求調整方案，採客製化服務，讓客戶感受到獨特性。

(六) 上市上櫃公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1. 根據世界經濟論壇 (World Economic Forum, 簡稱 WEF) 2023 年所發布的《全球風險報告》, 「氣候變遷減緩及調適失敗」、「自然災害及極端天氣事件」為長期顯著之風險, 極端氣候所帶來的威脅愈趨明顯。 志聖為因應氣候變遷對公司造成的潛在衝擊, 並落實有效的氣候管理策略, 自 2023 年起導入國際金融穩定委員會制定之氣候相關財務揭露建議 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures Recommendation, TCFD) , 依循治理、策略、風險管理、指標與目標四大揭露框架, 強化志聖對於氣候風險與機會的鑑別與因應, 擬訂治理策略及目標, 並落實於營運管理流程中, 以持續掌握與因應氣候變遷對志聖的衝擊影響。 董事會 本公司以董事會為永續發展相關議題之最高決策單位, 於 2025 年成立功能性委員會: 「永續發展暨風險管理委員會」, 由梁又文總經理擔任委員會總召集人暨主席, 負責公司永續發展暨風險管理統籌及推動等相關事務, 轄下設有產品創新、客戶關懷、經營管理、社會關懷、環境永續、永續供應鏈、營運與策略風險、財務風險、法遵風險、資安風險、環境風險等 11 個小組, 有效進行資源整合, 將永續策略落實至各部處執行。 永續發展暨風險管理委員會 永續發展暨風險管理委員會為志聖永續發展、氣候治理及風險管理之專責單位。負責鑑別志聖營運相關之關鍵氣候風險與機會議題, 並由總經理定期召集舉辦會議, 與各部門單位協商氣候因應策略、目標設定與管理計畫, 並將執行成果向上呈報董事會, 並協助內部溝通、整合。 永續發展暨風險管理委員會針對攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題, 擬定對應策略與工作方針, 同時追蹤執行成效。委員會每年至少 1 次向董事會進行永續策略與專案執行成效報告。董事會定期聽取管理階層報告重大議題執行進度, 針對管理階層報告內容評估策略可行性或提供其他建議方向, 且追蹤執行進度和敦促管理階層評估調整規劃事項。2025 年召開之 12 場董事會中, 其中 4 場董事會提及永續發展相關議案, 占董事會場次數整體 33%。 其討論議題包括: - 選舉風險管理委員會成員案。 - 風險管理委員會運作情形報告。 - 訂定「永續發展暨風險管理委員會組織規程」案。 - 永續發展暨風險管理委員會運作情形 (1) 企業社會責任執行情形報告。 (2) 溫室氣體盤查及查證時程進度報告
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務 (短期、中期、長期) 。	2. 轉型風險的長期發展之評估下, 存在有市場風險、技術風險、政策與法規風險, 主要由於全球淨零目標之推動發展, 可能促進客戶減碳需求, 需有低碳技術或產品來因應未來的市場需求轉變。另外, 在低碳相關政策及法令的轉型風險, 包含國內碳費、總量管制等排碳新制上路, 以及出口國外的碳邊境調整機制的影響, 將帶來原料成本、產品銷售成本及市場定價的不確定性。 在業務策略配合財務規劃, 短期 (1~5 年) 作為營運轉型之籌備期, 除了結合供應鏈持續強化供應鏈多元化、應急計畫 及備用工作地點外, 同步建立雙供應來源或區域彈性調度計畫、標記高風險供應商與設備, 並開發低碳產品與定期評估市場和法規環境的變化, 設立減碳目標 (如 SBTi、淨零承諾) 以因應中期 (5~15 年) 淨零時代過度時期的新市場需求, 至於長期 (15~30 年) 策略則以國家淨零目標為參考方向, 逐步擬定排放減量等改善計畫。

項目	執行情形																									
	相關評估如下表所示。																									
	重大氣候風險與機會議題策略對照表 風險因子 / 機會	定義	期程	對財務衝擊	對應措施	指標與目標設定																				
	【機會】 產品與服務	開發或增加 低碳產品或服務	中期 (5-15 年)	1. 提高產品利潤 2. 增加營業收入	1. 節約能源 2. 針對性市場推廣 3. 商展活動展演	1. 產品取得 ISO 14067 認證。 2. 開發烤箱能效提升 10% 以上 3. 參加各種商展並展示 低碳產品及熱回收節能設備。																				
	【實體風險】 立即性極端天氣風險	極端氣候事件嚴重性和 頻率增加	短期 (1~5 年內)	1. 營運成本提高 2. 勞動力管理和規劃支出增加 3. 交期延誤之庫存成本支出 4. 營業收入減少 5. 保費或運費提高，位處「高風險」地區的資產難以投保	1. 供應鏈多元化 2. 應急計畫 3. 備用工作地點	1. 建立雙供應來源或區域彈性調度計畫 2. 標記高風險供應商與設備																				
	【轉型風險】 市場風險	利害關係人及客戶對環保 / 低碳要求提升	中期 (5-15 年)	1. 營業收入減少 2. 成本支出提高	1. 風險評估管理 2. 持續改進 3. 溝通與透明度	1. 定期評估市場和法規環境的變化 2. 設立減碳目標（如 SBTi、淨零承諾） 3. 主動與利害關係人溝通，建立良好的企業形象和信任。																				
	【轉型風險】 政策法規風險	國內外碳費 / 碳稅機制造成的財務影響	中期 (5-15 年)	1. 直接費用支出增加 2. 罰款或懲罰性費用增加	1. 維持政策敏感度 2. 導入碳管理機制 3. 掌握客戶與市場脈動	1. 定期盤查與關注國內外永續相關政策法令的推動訊息，降低風險。 2. 導入內部碳定價制度 3. 綠色設備投資與節能改善																				
	【轉型風險】 技術風險	以低碳商品替代現有產品和服務	中期 (5-15 年)	1. 研發成本增加 2. 管理成本上升	1. 調整電力結構 2. 充份調查分析市場、客戶與競品。	1. IoT 用電追蹤 / 能效分析模組 2. 設備熱回收率提升至 30%，導入閉循環系統。																				
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件嚴重性和頻率增加，從近年歷史天氣資訊評估，短期內營運據點所在地區多少都會承受氣候變遷帶來的極端天氣事件影響，包含異常降雨（暴雨、缺水）、氣溫升高、颱風、淹水等自然資源短缺或直接災害的衝擊等立即性實體風險。財務面的影響則多為極端天氣事件直接或間接造成的供應鏈中斷、交通運輸受阻，甚至停班造成的工時損失等，另因為預防災害的資源投入、保險費用提高或災後復原亦有一定的財務影響 現階段評估共有 1 項實體風險，為淹水潛勢間接影響。 使用國家 TCCIP 平台 2 進行 RCPs3 情境模擬，運用平台線上模擬 RCPs 的四種地球暖化升溫情境下，組織營運據點在氣溫、海平面上升以及雨量變化所遭遇到的最嚴重情況，比較 RCP2.6 和 RCP8.5 兩種極端氣候變遷路徑的影響。現階段尚未鑑別出明顯的立即性或長期性風險，唯所在營運據點的周邊範圍如受到暴雨、洪水或其他自然災害，公司仍可能受到交通運輸中斷、員工通勤困難等影響，直接或間接造成原物料及銷售運輸中斷及勞動力營運成本上升等損失。 【災害潛勢模擬】 <table><thead><tr><th>據點名稱</th><th>極端升溫</th><th>淹水潛勢</th><th>異常降雨</th></tr></thead><tbody><tr><td>林口總部</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>台北廠</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>台中廠</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>南區服務中心</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr></tbody></table> 結果類別：●無影響、●間接影響、●直接影響						據點名稱	極端升溫	淹水潛勢	異常降雨	林口總部	●	●	●	台北廠	●	●	●	台中廠	●	●	●	南區服務中心	●	●	●
據點名稱	極端升溫	淹水潛勢	異常降雨																							
林口總部	●	●	●																							
台北廠	●	●	●																							
台中廠	●	●	●																							
南區服務中心	●	●	●																							
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度	董事會為集團內各公司風險控管的最高決策單位，為健全風險評估及強化管理機能，董事會 2025 年決議將「永續發展委員會」更名為「永續發展暨風險管理委員會」，並增設風險管理小組，負責辨識和管理企業營運之風險，包含氣候變遷可能帶來之實體與轉型風險，並主導相關因應措施之規劃。 (1) 辨識氣候風險： 2025 年透過 TCFD 標準框架，評估氣候變遷可能對公司帶來的各種風險，包括極端天氣事件、氣候變化政策風險、市場變化風險等。盡可能利用可取得之科學工具、數據、氣候模型等工具來協助辨識氣候風險。																									

項目	執行情形
	(2) 評估氣候風險： 分析風險的概率和影響程度，以評估氣候風險的嚴重程度和潛在影響。考慮不同氣候情景下的風險，包括極端情況和不確定性，並評估對公司營運、銷售業務、資產、供應鏈、品牌形象等方面可能產生的影響。 (3) 整合至風險管理制度： 將氣候風險納入企業的風險識別、評估、控制、追蹤和回顧等各個階段。 將氣候風險管理納入企業的政策與程序中。 (4) 建立應對措施： 根據評估結果制定具體的應對策略和措施，包括風險轉移、風險避免、風險減輕等。 考慮氣候風險管理與其他風險管理措施的協同作用，以最大程度地減少風險。 (5) 追蹤與改善： 由內部風險管理小組，經由外部專業訓練後建立氣候及自然風險評估能力並定期評估未來短、中、長期風險與機會，向最高管理階層及永續發展暨風險管理委員會提報並每年依實際狀況變化評估是否重新進行TCFD、TNFD。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	(1) 情境描述： 以異常氣候、平均氣溫升高等情境，考量中期、長期的變化以及對營運據點產生的實體風險。 (2) 參數和假設： IPCC 發布之評估報告中，係以代表性濃度途徑(RCPs)提出四種氣候變遷的情境，總結如下： 1：RCP2.6 是低度排放情境，將全球暖化的升溫幅度限制在 2° C 以內（與工業化前相比），也被稱為 2° C 情境。 2：RCP4.5 是中度排放情境，沒有達到 2° C 的限制和 1.5° C 的目標，被認為可能產生約 2.4° C 的升溫。 3：RCP6.0 是中高排放情境，溫室氣體排放在 2060 年左右達到顛峰，並在本世紀末開始下降，被認為可能產生 2.8° C 的升溫。 4：RCP8.5 與現行政策一致，是高度排放的情境，升溫幅度可能達到 4.3° C，被認為代表「BAU」的情境。參考 NDC 國家自定貢獻之減碳目標以及 IPCC AR6 第六次評估報告之路徑，並假設長期地球平均升溫超過 2 度 C 的發展下，以 RCP 4.5 及 RCP 8.5 兩種惡化的氣候路徑作為情境分析的參數和未來氣候情況的假設基礎。 (3) 分析因子： 篩選可能影響公司營運韌性的要素，包含供應鏈、業務銷售、資金週轉等作為評估指標。 (4) 主要財務影響： 透過資訊蒐集與不同的氣候變遷情境下可能對企業財務狀況產生的影響，包括直接損失、間接成本、市場需求變化等。進而評估其對財務績效的潛在影響。 (5) 風險評估： 現階段尚未鑑別出明顯的立即性或長期性風險，唯所在營運據點的周邊範圍如受到暴雨、洪水或其他自然災害，公司仍可能受到交通運輸中斷、員工通勤困難等影響，直接或間接造成原物料及銷售運輸中斷及勞動力營運成本上升等損失。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	為了於 2050 達成淨零排放，本公司已於 SBTi 承諾，將分別針對營運活動的直接排放（範疇一）、能源使用的間接排放（範疇二）於 2030 年減量 42%，以及價值鏈產生的間接排放（範疇三）於 2035 年減量 37.5%。 執行內容包含： S1. 持續將公務車輛積極轉型油電混動或純電動車輛：2025 年已更換公務車 16 部為油電型，當年度耗油量較去年減少約 4.6% S2. 規劃於二廠屋頂增設 500kW 太陽能板，預計提升綠電比例至 15%。 S3. 供應鏈管理：加入政府疫後升級轉型診斷輔導計畫及製造部門淨零轉型推動計畫，以協助供應商掌握自身碳排放量。 本公司辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標如下： 1. 轉型風險：可能受低碳經濟轉型影響。 2. 實體風險：易受氣候變遷影響（包括洪水及乾旱）。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	7. 本公司尚未使用碳定價工具

項目	執行情形
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程、每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	(1) 為有效管理氣候風險帶來的威脅並強化志聖因應氣候變遷能力，志聖已設定氣候相關管理目標以提升氣候韌性，並將各目標落實於廠區與部門營運管理中。自 2023 起依據 Greenhouse Gas Protocol 溫室氣體盤查議定書進行溫室氣體盤查，使用「營運控制權法」盤查營運邊界內（包含本公司所有廠區）運營相關之直接溫室氣體排放源（範疇一）、能源間接溫室氣體排放源（範疇二）及其他間接溫室氣體排放源（範疇三）類別 3-6 / C1~C15 項目。 為於 2050 達成淨零排放，本公司已於 SBTi 承諾，將分別針對營運活動的直接溫室氣體排放源（範疇一）、能源間接溫室氣體排放源（範疇二）於 2030 年減量 42%，以及他間接溫室氣體排放源（範疇三）類別 3-6 / C1~C15 項目於 2035 年減量 37.5%。 (2) 本公司無使用碳抵換或再生能源憑證；
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫（另填於 1-1 及 1-2）。	請詳表 1-1 及 1-2；

(1) 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(A) 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量 (公噸 CO2e)、密集度 (公噸 CO2e/百萬元) 及資料涵蓋範圍。

1. 母公司個體應自民國 (下同)114 年開始盤查。
2. 合併財務報告子公司應自 115 年開始盤查。

近兩年度溫室氣體盤查數據係依據「營運控制權法」盤查營運邊界內（包含本公司所有廠區）之溫室氣體排放量，說明如下：

執行範圍		113 年度		114 年度	
		排放量 (噸 CO2e)	密集度 (噸 CO2e/營業額 新台幣百萬元)	排放量 (噸 CO2e)	密集度 (噸 CO2e/營業額 新台幣百萬元)
本公司	範疇一	490.07	-	498.72	-
	範疇二	1466.74		1,845.62	
	範疇三	87388.99		95745.94	
總計		89345.80	32.07	98090.27	29.00

註 1：直接排放量（範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源）、能源間接排放量（範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放）及其他間接排放量（範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源）。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol）或國際標準組織（International Organization for Standard-ization, ISO）發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品／服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額（新台幣百萬元）計算之數值。

(B) 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

- 1. 母公司個體應自民國 (下同) 116 年開始 執行確信 。
- 2. 合併財務報告子公司應自 117 年開始 執行確信 。

完整確信資訊將於永續報告書揭露。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。
註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。
註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(2) 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

(A) 溫室氣體減量基準年及其數據：

為有效管理氣候風險帶來的威脅並強化志聖因應氣候變遷能力，志聖已設定氣候相關管理目標以提升氣候韌性，並將各項目標落實於廠區與部門營運管理中。志聖個體自 2023 起依據 Greenhouse Gas Protocol 溫室氣體盤查議定書進行溫室氣體盤查，未來將以此作為基準年進行減碳目標設定。目前志聖針對溫室氣體減量已設定相應目標：為了於 2050 達成淨零排放，本公司已於 SBTi 承諾，將分別針對營運活動的直接排放（範疇一）、能源使用的間接排放（範疇二）於 2030 年減量 42%，以及價值鏈產生的間接排放（範疇三）於 2035 年減量 37.5%。並透過永續發展暨風險管理委員會監督各據點年度達成情況，滾動式修正氣候目標並每年呈報董事會，逐年確認其有效性與適宜性。

執行範圍		113 年度		114 年度	
		排放量 (噸 CO2e)	密集度 (噸 CO2e/ 營業額 新台幣百萬元)	排放量 (噸 CO2e)	密集度 (噸 CO2e/ 營業額 新台幣百萬元)
本公司	範疇一	490.07	-	498.72	-
	範疇二	1466.74		1,845.62	
	範疇三	87388.99		95745.94	
總計		89345.80	32.07	98090.27	29.00

114 年度碳排放密集度 (強度) 較前一年度顯著降低。

* 註 1：資料涵蓋範圍為本公司總部、台北廠、台中廠、南區辦公室彙總資訊。
* 註 2：114 年度資訊尚待確信機構審核中，詳細及確信後資訊將於本年度永續報告書中揭露。

(B) 行動計畫：

- 1. 依循 TCFD 架構，定期執行關鍵氣候機會評估，並訂定因應措施及管理目標。
- 2. 逐步擴大溫室氣體盤查範圍，針對先進封裝主力產品導入 ISO 14067 產品碳足跡標準。
- 3. 進行設備汰舊換新及優化生產組裝之流程及技術，減少能源浪費。
- 4. 鼓勵員工提出節能減碳研發方案，投入低碳產品服務開發。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。
註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本金額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

(七) 公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	運作情形 (註)		無差異	無差異	無差異	無差異
	是	否				
評估項目	一、訂定誠信經營政策及方案	(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	為落實公司道德行為及誠信經營，以利公司企業文化健全發展，志聖經董事會通過訂有「誠信經營守則」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，載明不誠信行為之防範措施，如：行賄及收賄、提供非法政治獻金、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益、侵害營業秘密及智慧財產權等。並於每月廠區聯合月會向公司員工進行宣導，使志聖同仁對於道德誠信有更明確的方向及守則可以遵循。	無差異		
		(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	本公司「誠信經營守則」，載明不誠信行為之防範措施，如：行賄及收賄、提供非法政治獻金、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益、侵害營業秘密及智慧財產權等。	無差異		
		(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	本公司除訂定「誠信經營守則」外，尚訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「關係人交易作業程序」等辦法。	無差異		
	二、落實誠信經營	(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	本公司以公平與透明之方式從事商業活動，並於從事商業活動前，審慎評估往來對象，以避免與不誠信之對象進行交易。另與交易對象簽訂商業契約時，由法務單位審查簽立之合約條款，以避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。	無差異		

評估項目	運作情形 (註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期 (至少一年一次) 向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		公司成立「永續發展暨風險管理委員會」，每年定期向董事會報告執行情形。委員會建立企業誠信與倫理規範，維持清廉秩序，落實營運及財務管理，維護公司利益，保障股東權益，恪守商業行為及道德準則規範，使公司穩健成長。 該委員會負責推動各項企業社會責任計畫及統籌擬定全公司社會責任目標和永續發展方向相關政策，並向董事會報告執行情形，最近一次於 2025 年 11 月 7 日向董事會報告執行情形。 1. 本公司於 2025 年 7 月 31 日邀請台中市法制局李善桓局長蒞臨分享「詐騙防制」相關課程，協助同仁掌握最新詐騙資訊，保護自身與家人的安全。透過課程深化誠信經營理念，提升防詐與識詐能力，強化員工警覺，共築安全透明的職場環境，打造守法、誠信、值得信賴的企業文化；本次課程參與人次 99 人，時數 198 小時。 2. 本公司新進員工入職時皆簽署誠信廉潔承諾書，並加強宣導公司誠信經營的重要性，2025 年度共簽署 101 份。
		V	本公司對內相關內部規章與員工公司工作 守則均公佈於公司內部網站，並於修訂時函知全體同仁。對外於公司網站設置利害關係人專區。 (網址：https://www.csun.com.tw/investor-relations/ 利害關係人)
		V	本公司已訂有內部控制制度、內部稽核實施細則、會計制度及各項管理規章，且運作情形正常並落實誠信經營之要求，本公司內部稽核依稽核計畫進行查核並製成稽核報告，定期於董事會報告稽核結果。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		無差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		無差異

三、公司檢舉制度之運作情形	(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	公司定期辦理與誠信經營相關之教育訓練，並已將相關規範之作業程序及辦法置於本公司內部網站，以供員工隨時查閱。 本公司宣導單位不定時於廠區聯合月會宣導同仁對於遵循誠信經營規範的堅定承諾，以求落實，宣導情形如下： <table><tr><th>日期</th><th>教育訓練名稱</th><th>對象</th><th>人次</th><th>時數</th></tr><tr><td>2025/5/28</td><td>違反職業道德申訴管道</td><td>全體員工</td><td>156</td><td>78</td></tr><tr><td>2025/9/25</td><td>貪腐零容忍</td><td>全體員工</td><td>207</td><td>104</td></tr><tr><td>2025/9/25</td><td>內線交易宣導</td><td>全體員工</td><td>207</td><td>104</td></tr></table>	日期	教育訓練名稱	對象	人次	時數	2025/5/28	違反職業道德申訴管道	全體員工	156	78	2025/9/25	貪腐零容忍	全體員工	207	104	2025/9/25	內線交易宣導	全體員工	207	104	無差異
日期	教育訓練名稱	對象	人次	時數																				
2025/5/28	違反職業道德申訴管道	全體員工	156	78																				
2025/9/25	貪腐零容忍	全體員工	207	104																				
2025/9/25	內線交易宣導	全體員工	207	104																				
四、加強資訊揭露	(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V	本公司對違反法令規章或道德行為準則之行為，訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，設有檢舉及申訴管道，如電子郵件、員工意見箱及相關懲戒措施，並不定期檢討修正，以達有效及充分意見溝通之管道，使問題發生時，得以快速及有效溝通解決，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員。	無差異																				
	(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V	本公司設有檢舉辦法，且於公司設置檢舉信箱，對檢舉人身份及檢舉內容將絕對以保密。	無差異																				
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形；無。	(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	本公司對於檢舉人負保密之責，避免檢舉人因檢舉而遭受不當之處置之措施。	無差異																				
	公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	本公司誠信經營守則已上傳至公開資訊觀測站，並揭露於本公司網站 https://www.csun.com.tw/category	無差異																				
六、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形；無。				無差異																				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊 (如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：				無差異																				
1. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。				無差異																				
2. 本公司 < 董事會議事規則 > 中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論或表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。				無差異																				
3. 本公司訂有「防範內線交易管理作業」，明訂董事、監察人、經理人及受僱人不得洩漏所知悉之內部重大資訊與他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其洩漏。				無差異																				
4. 本公司簽證會計師事務所為資誠聯合會計師事務所，該會計師並未擔任本公司董事，兼具專業及獨立性，本公司每年皆會審查會計師之獨立性，會計師定期查核各大循環及內部控制，對本公司內部控制及會計處理事項建議。				無差異																				

(八) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

本公司於公司網站投資人專區揭露。

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

志聖致力於營運資訊透明化、即時化，進而為股東創造最大投資利益，且一直是志聖基本經營理念，本公司公司治理情形如下：

- 1. 董事會成員包含四位具多年產業經驗之獨立董事。
- 2. 專業獨立董事定期參與決策機制 (每三個月例行召開一 ~ 兩次董事會)
- 3. 定期委託會計師查核兩岸營運機制。
- 4. 會計師定期參與董事會，扮演監督及諮詢的角色。
- 5. 公司網站設立投資人專區並定期更新，讓公司之所有股東有統一且公平的管道獲取公司即時資訊。
- 6. 建立專業董事諮詢制度。

(十) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：

志聖工業股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：民國 115 年 2 月 25 日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 (含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」) 規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 114 年 12 月 31 日的內部控制制度 (含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 115 年 2 月 25 日董事會通過，出席董事 7 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

志聖工業股份有限公司

董事長：梁茂生



總經理：梁又文



2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

日期	會議名稱	內容
114.1.10	第十八屆第十七次 董事會	1. 本公司擬解除經理人競業禁止之限制案
114.2.25	第十八屆第十八次 董事會	1. 擬通過民國 113 年度財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。 2. 本公司截至 112 年 12 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請審議。 3. 擬通過民國 113 內部控制制度有效性考核及聲明書。 4. 擬通過民國 113 年營業報告書。 5. 擬通過民國 113 年度盈餘分配案。 6. 擬通過民國 112 年度盈餘轉增資發行新股案。 7. 取得不動產案。 8. 子公司志聖科技廣州有限公司取得不動產案。 9. 擬與銀行及票券金融公司，取得融資及從事與資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約。 10. 投資案。 11. 本公司民國 113 年度董事酬勞及員工酬勞總數案。 12. 擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案，提請公決。 13. 擬發行限制員工權利新股予員工案。 14. 第十九屆董事、獨董選舉案。 15. 擬通過民國 113 年股東會時間、地點、議程、受理股東提案期限。
114.04.08	第十八屆第十九次 董事會	1. 擬提請通過董事會提名及檢查董事 (獨立董事) 候選人名單，謹提請 核議。 2. 解除董事競業禁止案。 3. 擬提請通過訂定本公司 113 年度現金配息基準日相關事宜。
114.04.16	第十八屆第二十次 董事會	1. 本公司 114 年第一次買回本公司股份案。 2. 擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案，提請 公決。
114.05.06	第十八屆第二十一 次 董事會	1. 擬通過民國 114 年度第一季財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。 2. 本公司截至 114 年 3 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請 審議。 3. 擬與銀行及票券金融公司，取得融資及從事與資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約。 4. 本公司 2025 年調薪擬議案，提請審議。
114.05.27	第十九屆第一次 董事會	新任董事推選董事長、副董事長各一人。
114.06.04	第十九屆第二次 董事會	選任薪酬委員成員案。
114.08.05	第十九屆第三次	1. 擬通過民國 114 年度第二季財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。 2. 本公司截至 114 年 6 月 30 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請 審議。 3. 本公司 2025 永續報告書執行成果，報請核備。 4. 選舉風險管理委員會成員。 5. 擬與銀行及票券金融公司，取得融資及從事與資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約。 6. 世貿大樓裝修規劃案 (1) 12F (2) B1 7. 經理人派任案 (1) 執行長 (2) 永續長、副永續長 (3) 營運長 (4) 幕僚長 8. 內部稽核主管任命案。 9. 捐贈案 - 逢甲大學。 10. 副執行長梁茂忠先生退休案。 11. 本公司 2025 年經理人獎勵擬議案。 12. 擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案。
114.09.08	第十九屆第四次	1. 擬參與臺中市西屯區逢大段土地標售案。
114.10.07	第十九屆第五次	1. 本公司 2025 年經理人獎勵擬議案。 2. 擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案，提請 公決。

日期	會議名稱	內容
114.11.07	第十九屆第六次	1. 擬通過民國 114 年度第三季財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。 2. 本公司截至 114 年 9 月 30 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請 審議。 3. 擬與銀行及票券金融公司，取得融資及從事與資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約。 4. 訂定本公司「永續發展暨風險管理委員會組織規程」案。 5. 擬辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債乙案，提請 討論。
114.12.19	第十九屆第七次	1. 2026 年年度稽核計畫。 2. 2026 年年度計畫。 3. 背書保證案 - 先放後稅 4. 現任會計師獨立性及適任性評估案。 5. 本公司基層員工定義及內部控制制度之「薪工作業循環」修正案。 6. 子公司蘇州創峰光電智能科技有限公司—吳江建廠預算案。 7. 投資案 (1) 敦品創新伍號杏林股份有限公司案 (2) 設立美國子公司案。 8. 本公司經理人 2025 年績效評估結果及年終總所得內容案。 9. 擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案。
115.01.27	第十九屆第八次	1. 不動產取得 _ 台中南屯區精科一路 12 號廠房案。 2. 不動產取得 _ 台南善化區陽光三路 238 號宿舍案。
115.02.25	第十九屆第九次	1. 擬通過民國 114 年度財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。 2. 本公司截至 114 年 12 月 31 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，提請審議。 3. 擬通過民國 114 內部控制制度有效性考核及聲明書。 4. 擬通過民國 114 年營業報告書。 5. 擬通過民國 114 年度盈餘分配案。 6. 擬通過民國 114 年度盈餘轉增資發行新股案。 7. 擬與銀行及票券金融公司，取得融資及從事與資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約。 8. 更換簽證會計師案。 9. 投資案：樂林科技 (股) 公司成立日本子公司案。 10. 經理人派任案 (1) 執行長 (2) 行政副總。 11. 本公司民國 114 年度董事酬勞及員工酬勞總數案。 12. 擬提請通過本公司庫藏股轉讓經理人及員工案。 13. 擬通過民國 115 年股東會時間、地點、議程、受理股東提案期限。
115.03.20	第十九屆第十次	1. 本公司擬擔任東捷科技股份有限公司私募普通股應募人案。

(2) 民國 114 年 5 月 27 日股東常會重要決議內容及執行情形：

重要決議：

1. 通過民國一一三年度決算表冊。
2. 通過民國一一三年度盈餘分配案。
3. 修正本公司「公司章程」
4. 通過發行限制員工權利新股予員工案。
5. 第十九屆董事、獨立董事選舉案
6. 解除董事競業禁止之限制案

執行情形：

114 年 4 月 8 日董事會訂定 114 年 6 月 3 日為除息除權基準日，發放現金 (每股 5 元)，於 114 年 6 月 20 日發放現金予股東，分派金額與股東常會決議無差異。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

三、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣 / 仟元						
會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	李典易 吳偉豪	114.1.1 ~ 114.12.31	2,500	330	2,830	合併及個體財務報表 英文財報翻譯 移轉訂價

請具體敘明非審計公費服務內容：(例如稅務簽證、確信或其他財務諮詢顧問服務)

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

- (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：不適用。
- (二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。
- (三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

四、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師：

更換日期	115 年 2 月 25 日 (註)			
更換原因及說明	事務所內部輪調			
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師	委任人
	情 況			
	主動終止委任		不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不再接受 (繼續) 委任		不適用	不適用
	最近二年度均出具無保留意見。			
	與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露	
			查核範圍或步驟	
			其 他	
	無	V		
	說明			
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	不適用。			

(二) 關於繼任會計師：

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	吳偉豪 江采燕
委任之日期	115 年 2 月 25 日 (註)
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用。
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用。

註：係本公司董事會正式通過委任案之日期。

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：請詳公開資訊觀測站內之『董事、監察人、經理人及大股東持股餘額彙總表』。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

115 年 3 月 24 日 (停止過戶日)
單位：股；%

姓名 (註 1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。 (註 3)		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
均豪精密工業股份有限公司 代表人：陳政興	19,957,082	12.73%	—	—	—	—	—	—	—
	15,760	0.01%	—	—	—	—	—	—	—
海杏投資 (股) 公司 代表人：傅梁秀鴻	17,827,743	11.37%	—	—	—	—	梁茂生 梁茂忠	負責人 為姊弟	—
	742,714	0.47%	—	—	—	—	梁茂生 梁茂忠	負責人 為姊弟	—
品志投資 (股) 公司 代表人：梁碧茹	12,400,560	7.91%	—	—	—	—	梁茂生	負責人 為子女	—
	1,348,393	0.86%	—	—	—	—	梁茂生	負責人 為子女	—
梁茂忠	6,875,949	4.39%	1,137,260	0.73%	—	—	梁茂生	兄弟	—
							海杏投資 (股) 公司	負責人 為姊弟	—
梁茂生	4,577,866	2.92%	346,222	0.22%	—	—	梁茂忠	兄弟	—
							海杏投資 (股) 公司	負責人 為兄妹	—
							品志投資 (股) 公司	負責人 為子女	—
志聖工業股份有限公司庫藏股專戶	4,399,143	2.81%	—	—	—	—	—	—	—
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	3,598,000	2.30%	—	—	—	—	—	—	—
渣打託管 S P D R 組合新興市場 E T F 專戶	3,428,139	2.19%	—	—	—	—	—	—	—
匯豐 (台灣) 銀行託管高盛國際公司投資專戶	2,976,098	1.90%	—	—	—	—	—	—	—
簡進士	2,800,155	1.79%	—	—	—	—	—	—	—
朕昇 (股) 公司 代表人：梁碧真	2,556,237	1.63%	—	—	—	—	梁茂忠	負責人 為子女	—
	—	—	—	—	—	—	梁茂忠	負責人 為子女	—

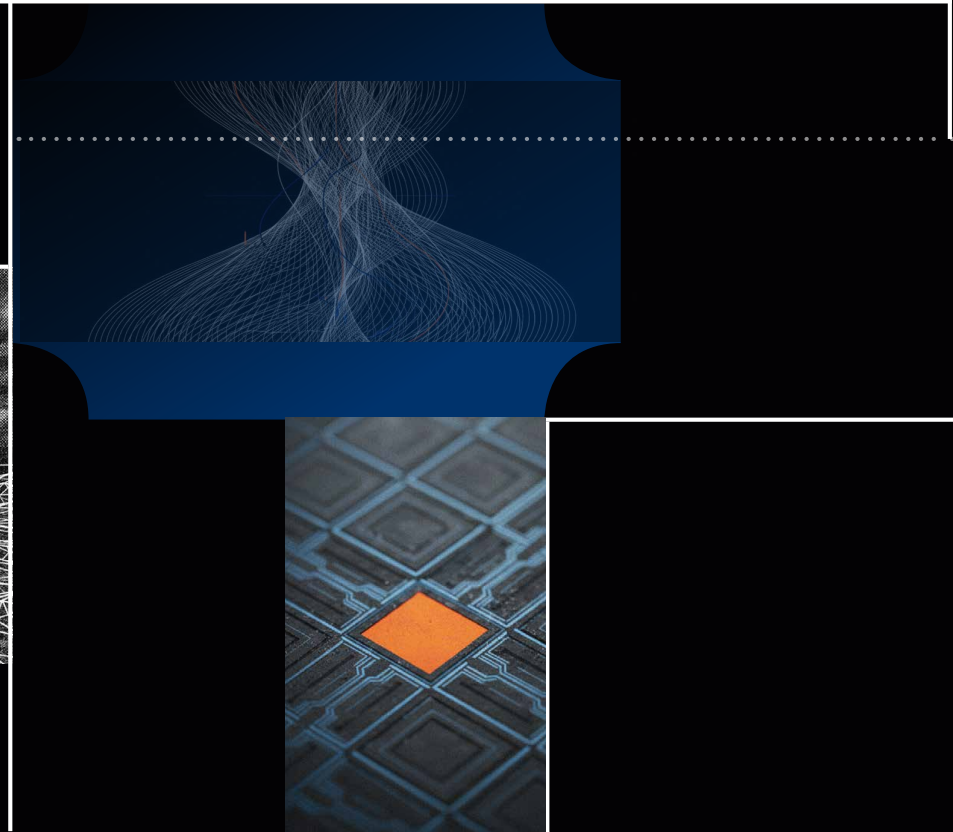
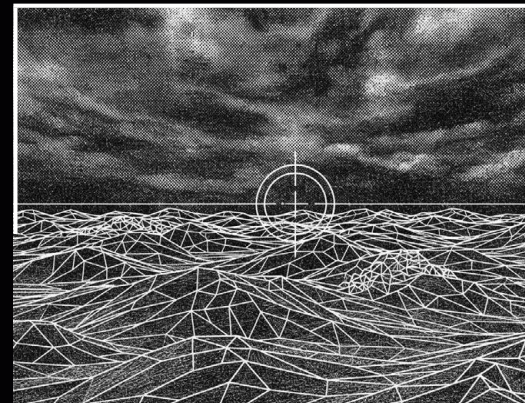
註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

八、公司、公司董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

綜合持股比例
114 年 12 月 31 日
單位：股；%

轉投資事業 (註 1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
C SUN(B.V.I.) LTD.	—	100.00%	—	—	—	100.00%
志聖科技 (廣州) 有限公司 (註 2)	—	100.00%	—	—	—	100.00%
蘇州創峰光電科技有限公司 (註 2)	—	77.47%	—	—	—	77.47%
K SUN (SAMOA) LTD.	—	100.00%	—	—	—	100.00%
宏騰實業股份有限公司	700,000	70.00%	—	—	700,000	70.00%
樂林科技股份有限公司	1,000,000	50.00%	—	—	1,000,000	50.00%
CSUN EQUIPCARE & TRADE (THAILAND) CO., LTD.	10,000	100.00%	—	—	10,000	100.00%
Alpha Joint Ltd.	580,000	100.00%	—	—	580,000	100.00%
力永企業有限公司	—	77.47%	—	—	—	77.47%
福盟國際企業有限公司	6,000,000	77.47%	—	—	6,000,000	77.47%
創峰光電科技股份有限公司	750,000	77.47%	—	—	750,000	77.47%
蘇州創峰光電智能科技有限公司	—	77.47%	—	—	—	77.47%
江蘇創高新材料科技有限公司	—	100.00%	—	—	—	100.00%
南通創峰光電設備有限公司 (註 2)	—	77.47%	—	—	—	77.47%
均豪精密工業股份有限公司	44,697,827	27.75%	—	—	44,697,827	27.75%
均華精密工業股份有限公司	2,137,000	7.56%	—	—	2,137,000	7.56%
視動自動化科技股份有限公司	676,504	21.87%	—	—	676,504	21.87%
首固 (上海) 光電有限公司	—	25%	—	—	—	25%

註 1：係公司採用權益法之長期投資。
註 2：透過第三地區投資設立公司，再投資大陸公司。



3 募資情形

一、公司資本及股份

(一) 股本與來源：

股本來源

115 年 3 月 24 日 (停止過戶日)

單位：股

年 月	發行 價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本 來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
67.04	10,000	300	3,000,000	300,000	3,000,000	創立	無	-
73.05	10,000	600	6,000,000	600,000	6,000,000	現金增資 3,000 仟元	無	-
74.07	10,000	1,500	15,000,000	1,500,000	15,000,000	現金增資 9,000 仟元	無	-
83.10	10	4,000,000	40,000,000	4,000,000	40,000,000	現金增資 25,000 仟元	無	-
84.10	10	6,000,000	60,000,000	6,000,000	60,000,000	現金增資 20,000 仟元	無	-
85.11	10	8,500,000	85,000,000	8,500,000	85,000,000	現金增資 25,000 仟元	無	-
86.07	10	30,000,000	300,000,000	17,300,000	173,000,000	現金增資 33,000 仟元 盈餘轉增資 25,000 仟元 資本公積轉增資 30,000 仟元	無	86.11.4(86) 台財證 (一) 第 79879 號函
87.07	10	30,000,000	300,000,000	25,900,000	259,000,000	現金增資 49,260 仟元 盈餘轉增資 36,740 仟元	無	87.6.5(87) 台財證 (一) 第 48830 號函
88.06	10	30,600,000	306,000,000	30,600,000	306,000,000	盈餘轉增資 47,000 仟元	無	88.6.10(88) 台財證 (一) 第 53483 號函
89.05	10	88,600,000	886,000,000	46,700,000	467,000,000	現金增資 91,000 仟元 盈餘轉增資 70,000 仟元	無	89.5.23(89) 台財證 (一) 第 42313 號函、 89.5.16(89) 台財證 (一) 第 42314 號函
90.05	10	101,300,000	1,013,000,000	60,280,000	602,800,000	盈餘轉增資 135,800 仟元	無	90.5.25(90) 台財證 (一) 第 132351 號函
91.06	10	101,300,000	1,013,000,000	76,493,000	764,930,000	盈餘轉增資 101,850 仟元 資本公積轉增資 60,280 仟元	無	91.6.18(91) 台財證 (一) 第 0910132850 號函
92.08	10	101,300,000	1,013,000,000	81,395,500	813,955,000	盈餘轉增資 33,726.4 仟元 資本公積轉增資 15,298.6 仟元	無	92.8.28(92) 台財證 (一) 第 09201253670 號函
93.07	10	121,300,000	1,213,000,000	89,915,000	899,150,000	盈餘轉增資 52,636.8 仟元 資本公積轉增資 32,558.2 仟元	焦	93.7.14(93) 金管證 (一) 第 0930131353 號函
94.07	10	121,300,000	1,213,000,000	93,729,908	937,299,080	合併現金增資 38,149.08 仟元	無	94.7.21(94) 金管證 (一) 第 0940125887 號函
94.09	10	134,700,000	1,347,000,000	102,482,700	1,024,827,000	盈餘轉增資 81,271 仟元 資本公積轉增資 6,256.92 仟元	無	94.9.9(94) 金管證 (一) 第 0940137840 號函
95.01	10	134,700,000	1,347,000,000	103,292,700	1,032,927,000	員工認股權憑證換發新股 8,100 仟元	無	95.1.25 經授商字第 09501012510 號函
95.05	10	134,700,000	1,347,000,000	103,627,700	1,036,277,000	員工認股權憑證換發新股 3,350 仟元	無	95.5.17 經授商字第 09501089280 號函

年 月	發行 價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本 來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
95.08	10	200,000,000	2,000,000,000	115,959,700	1,159,597,000	盈餘轉增資 107,670 仟元 資本公積轉增資 14,000 仟元 員工認股權憑證換發新股 1,650 仟元	無	95.8.18 經授商字第 09501176280 號函
95.11	10	200,000,000	2,000,000,000	116,124,700	1,161,247,000	員工認股權憑證換發新股 1,650 仟元	無	95.11.13 經授商字第 09501251590 號函
96.03	10	200,000,000	2,000,000,000	129,106,561	1,291,065,610	合併現金增資 129,268.61 仟元暨 員工認股權憑證換發新股 550 仟元	無	96.03.06 經授商字第 09601035250 號函
96.05	10	200,000,000	2,000,000,00	129,171,561	1,291,715,610	員工認股權憑證換發新股 650 仟元	無	96.05.09 經授商字第 09601100380 號函
96.09	10	200,000,000	2,000,000,000	134,998,361	1,349,983,610	資本公積轉增資 58,268 仟元	無	96.09.03 經授商字第 09601215250 號函
96.11	10	200,000,000	2,000,000,000	135,123,361	1,351,233,610	員工認股權憑證換發新股 1,250 仟元	無	96.11.16 經授商字第 09601280890 號函
97.03	10	200,000,000	2,000,000,000	135,128,361	1,351,283,610	員工認股權憑證換發新 50 仟元	無	97.03.06 經授商字第 09701055510 號函
97.07	10	200,000,000	2,000,000,000	135,287,361	1,352,873,610	員工認股權憑證換發新 1,590 仟元	無	97.07.02 經授商字第 09701156110 號函
97.09	10	200,000,000	2,000,000,000	139,762,861	1,397,628,610	盈餘轉增資 44,755 仟元	無	97.09.24 經授商字第 09701246900 號函
98.07	10	200,000,000	2,000,000,000	139,792,861	1,397,928,610	員工認股權憑證換發新股 300 仟元	無	98.07.13 經授商字第 09801140360 號函
98.08	10	200,000,000	2,000,000,000	143,661,610	1,436,616,100	盈餘轉增資 38,687 仟元	無	98.08.20 經授商字第 09801189850 號
99.02	10	200,000,000	2,000,000,000	143,707,610	1,437,076,100	員工認股權憑證換發新股 460 仟元	無	99.02.05 經授商字第 09901026100 號
99.05	10	200,000,000	2,000,000,000	146,711,620	1,467,116,200	員工認股權憑證換發新股 8,450 仟元；公司債轉換股份 21,590.1 仟元	無	99.05.07 經授商字第 09901092890 號
99.09	10	200,000,000	2,000,000,000	150,107,558	1,501,075,580	員工認股權憑證換發新股 7,640 仟元；公司債轉換股份 26,319.38 仟元	無	99.09.02 經授商字第 09901199890 號
99.11	10	200,000,000	2,000,000,000	151,184,208	1,511,842,080	員工認股權憑證換發新股 4,510 仟元；公司債轉換股份 32,986.5 仟元；註銷庫藏 26,730 股仟元	無	99.11.09 經授商字第 09901251530 號
100.03	10	200,000,000	2,000,000,000	152,338,304	1,523,383,040	員工認股權憑證換發新股 4,855 仟元；公司債轉換股份 6,685.96 仟元	無	100.03.08 經授商字第 10001044350 號
100.05	10	200,000,000	2,000,000,000	153,056,510	1,530,565,100	員工認股權憑證換發新股 3,185 仟元；公司債轉換股份 3,997.06 仟元	無	100.05.13 經授商字第 10001096720 號
100.09	10	200,000,000	2,000,000,000	155,152,820	1,551,528,200	員工認股權憑證換發新股 905 仟元；公司債轉換股份 20,058.10 仟元	無	100.09.08 經授商字第 10001208720 號
100.11	10	200,000,000	2,000,000,000	156,045,219	1,560,452,190	員工認股權憑證換發新股 2,200 仟元；公司債轉換股份 6,723.99 仟元	無	100.11.02 經授商字第 10001252220 號
101.03	10	200,000,000	2,000,000,000	156,129,130	1,561,291,300	員工認股權憑證換發新股 370 仟元；公司債轉換股份 469.11 仟元	無	101.03.21 經授商字第 10101048670 號

年 月	發 行 價 格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本 來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
101.06	10	200,000,000	2,000,000,000	158,224,515	1,582,245,150	公司債轉換股份 20,953.85 仟元	無	101.6.08 經授商字第 10101105390 號
101.10	10	200,000,000	2,000,000,000	158,744,548	1,587,445,480	公司債轉換股份 5,200.33 仟元	無	101.10.31 經授商字第 10101226550 號
108.04	10	200,000,000	2,000,000,000	149,205,548	1,492,055,480	公司庫藏股註銷 95,390 仟元	無	108.4.23 經授商字第 10801042370 號
110.08	10	200,000,000	2,000,000,000	152,189,659	1,521,896,590	盈餘轉增資 29,841 仟元	無	110.8.30 經授商字第 11001149340 號
111.08	10	200,000,000	2,000,000,000	156,755,348	1,567,553,480	盈餘轉增資 45,657 仟元	無	111.8.02 經授商字第 11101144060 號

(二) 資本及股份

115 年 3 月 24 日 (停止過戶日)

股份種類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
記名式普通股	156,755,348 股	43,244,652 股	200,000,000 股	

(三) 總括申報制度相關資訊：不適用。

(四) 主要股東名單

主要股東名單

115 年 3 月 24 日 (停止過戶日)

主要股東名稱	股分	持有股數	持股比例 (%)
均豪精密工業股份有限公司		19,957,082	12.73%
海杏投資股份有限公司		17,827,743	11.37%
品志投資股份有限公司		12,400,560	7.91%
梁茂忠		6,875,949	4.39%
梁茂生		4,577,866	2.92%
志聖工業股份有限公司庫藏股專戶		4,399,143	2.81%
花旗託管挪威中央銀行投資專戶		3,598,000	2.30%
渣打託管 S P D R 組合新興市場 E T F 專戶		3,428,139	2.19%
匯豐 (台灣) 銀行託管高盛國際公司投資專戶		2,976,098	1.90%
簡進士		2,800,155	1.79%
朕昇股份有限公司		2,556,237	1.63%

(五) 公司股利政策及執行狀況：

(1) 股利政策：

► 公司章程第三十一條：

本公司年度如有獲利，應提撥 1%~9% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；

且前述員工酬勞中以不低於 45% 提撥為分派予基層員工之酬勞。

本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不超過 2.25% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

本公司年度決算如有盈餘：

一、依法繳納稅捐，

二、彌補累積虧損後，

三、再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，

四、其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；

如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會視公司營運情況酌予保留部份後擬具分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。並依第三十一條之一本公司股利政策。

本公司依法授權董事會得以特別決議，將應分派股息及紅利之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

本公司得依法令規定分派法定盈餘公積及資本公積，以發行新股方式為之時，提請股東會決議分派之；以現金方式為之時，應經董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過二分之一決議，並報告股東會。

► 公司章程第三十一條之一：股利政策

• 本公司考量公司所處環境及成長情形，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金之需求，就前條股東股利中現金股利不低於百分之 20。

本公司章程未明訂股東股息紅利之分派比率，考量公司資金需求、長期財務規劃等因素及兼顧股東利益，本公司對股東股息紅利之提撥以不低於當年度本期稅後淨利之百分之二十為基礎。

二、公司債 / 特別股 / 海外存託憑證辦理情形：

(一) 公司債辦理情形：

公 司 債 種 類 (註2)		第二次(期)無擔保公司債 (註5)	第三次(期)無擔保公司債 (註5)
發行(辦理)日期		115/1/9	115/1/22
面額		100,000	100,000
發行及交易地點(註3)		國內	國內
發行價格		105 元	123.34 元
總額		總面額 700,000,000 元 總金額 735,000,000 元	總面額 1,000,000,000 元 總金額 1,233,408,370 元
利率		0%	0%
期限		三年期；到期日：118/1/9	三年期；到期日：118/1/22
保證機構		不適用	
受託人		台北富邦商業銀行股份有限公司	
承銷機構		富邦綜合證券股份有限公司 凱基證券股份有限公司 元大證券股份有限公司 群益金鼎證券股份有限公司	富邦綜合證券股份有限公司 凱基證券股份有限公司 元大證券股份有限公司
簽證律師		翰辰法律事務所	
簽證會計師		李典易會計師、吳偉豪會計師	
償還方法		依債券面額以現金一次償還	
未償還本金		700,000,000 元	1,000,000,000 元
贖回或提前清償之條款		請參閱本公司債發行及轉換辦法第 18-19 條	請參閱本公司債發行及轉換辦法第 18-19 條
限制條款(註4)		無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用	
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	截至年報刊印日止，尚無任何轉換情形。	
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱公開資訊觀測站債信專區之債券發行資料	
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		本次發行無擔保轉換公司債主要用於償還銀行借款，旨在支持未來營運發展並適度改善財務結構。這將進一步增強公司的營運競爭力，並為整體營運發展提供支持。此舉預期對未來年度每股盈餘產生正面影響，因此不會造成獲利稀釋。此外，本公司已充分考量未來發展前景，並在不損害股東權益的前提下制定發行條件，對股權稀釋的影響可控，無重大風險。	
交換標的委託保管機構名稱		不適用	

註1：公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效(核准)者；辦理中之私募公司債係指已經董事會決議通過者。

註2：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註3：屬海外公司債者填列。

註4：如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

註5：屬私募者，應以顯著方式標示。

註6：屬轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債，應依性質按表列格式再揭露轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。

(二) 特別股 / 海外存託憑證辦理情形：無。

三、員工認股權憑證辦理情形：

(一) 尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二) 取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新臺幣三仟萬元以上員工之姓名、取得及認購情形：無。

四、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

(一) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

五、資金運用計劃執行情形

截至年報刊印日止，資金運用計畫為 114 年發行國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債，茲就資金運用計畫內容及執行情形說明如下：

(一) 計畫內容：

1. 本計畫所需資金總額：新台幣 1,968,408 千元。
2. 資金來源：
 - (1) 發行國內第二次無擔保轉換公司債上限 7,000 張，每張轉換公司債面額 100,000 元，發行總面額 700,000 千元，票面利率 0%，發行期間三年，依票面金額之 105% 發行，募集總金額新台幣 735,000 千元。
 - (2) 發行國內第三次無擔保轉換公司債 10,000 張，每張面額新台幣 100,000 元整，發行總面額為新台幣 1,000,000 千元整，發行期間 3 年，票面利率為 0%，採競價拍賣方式辦理公開承銷，實際發行金額以票面金額之 123.34% 發行，實際募集總金額為 1,233,408,370 元。
3. 計畫項目、運用進度

單位：新台幣千元

項目	預計完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			115 年第一季
償還銀行借款	115 年第一季	1,735,000	1,735,000
充實營運資金	115 年第一季	233,408	233,408
合計		1,968,408	1,968,408

4. 預計可能產生之效益

本公司本次計畫資金運用總額為新台幣 1,735,000 千元，擬全數用以償還本公司之銀行借款，本次辦理國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債預計於 115 年 1 月資金到位，依擬償還銀行借款之利率估算，預計 115 年度可節省利息支出 30,755 千元，116 年及以後年度可節省利息支出 33,550 千元。

5. 未足額發行導致募集資金不足時處理方式

本公司本次擬發行之國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債，發行總金額上限為 1,735,000 千元，如未足額發行時導致募集資金不足時，將以自有資金或其他方式因應；惟若致募集資金增加時，則將增加充實營運資金。

(二) 執行情形：

1. 執行情形

計畫項目	執行情形	截至 115 年第一季	進度超前或落後之原因及改進計畫
償還銀行借款	支用金額	1,735,000	本公司資金運用進度係依原預定計劃執行，無進度超前或落後之情形。
		1,735,000	
	執行進度	100%	
		100%	
充實營運資金	支用金額	233,408	
		233,408	
	執行進度	100%	
		100%	
合計	支用金額	1,968,408	
		1,968,408	
	執行進度	100%	
		100%	

2. 預計產生之效益

本公司本次計畫資金運用總額為新台幣 1,968,408 千元，其中 1,735,000 千元用以償還本公司之銀行借款，本次辦理國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債預計於 115 年 1 月資金到位，依擬償還銀行借款之利率估算，預計 115 年度可節省利息支出 30,755 千元，116 年及以後年度可節省利息支出 33,550 千元。

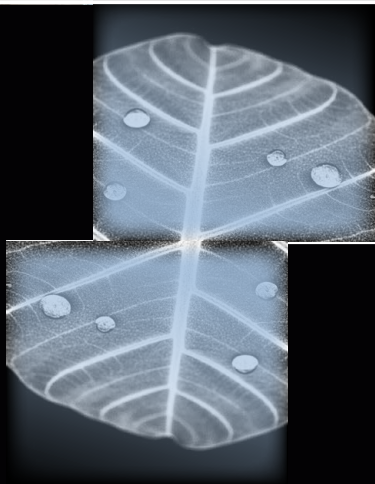
另因募集資金增加之 233,408 千元擬於 115 年第一季用於充實營運資金，若以募得之資金取代銀行融資，以本公司截至目前為止之平均借款利率 1.91% 估算，預估往後每年度將可節省利息支出 4,452 千元。

3. 截至 115 年第一季止，本次償還銀行借款金額 1,735,000 千元已依原訂計劃全數支用完畢，其節省利息之效益業已顯現，改善財務結構及提升償債能力。比較說明如下：

項目	115 年第一季 (註 2)	114 年度第四季	差異 (%)
流動資產	8,865,027	6,800,510	30.36%
流動負債	8,456,659	5,060,637	67.11%
負債總額	13,363,110	8,324,548	60.53%
流動比率 (%)	104.83%	134.38%	-21.99%
負債比率 (%)	60.83%	54.36%	11.90%
利息支出 (註 1)	21,121	67,236	10.15%
營業收入	2,261,506	6,102,155	29.46%
每股盈餘	3.06	5.5	76.88%

註 1：本公司 115 年第一季利息支出包含國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債攤銷之利息費用，若扣除該項影響，整體利息支出較前一季減少 12.74%。

註 2：115 年度第一季財務報表尚未經會計師核閱。



營運概況

一、業務內容

1. 業務範圍：

(1) 所營業務之主要內容：

- A. AI 相關電子印刷電路板產業供應鏈相關之去水、烘乾、固化、成型、除泡、退火、測試燒機解熱、貼膜、壓合、整平、相關製程設備之製造。銷售水平與垂直除膠渣、化學銅設備，及水平顯像、蝕刻、光阻剝離等各類水平濕製程設備。
- B. 提供 AI 晶片所需之半導體先進封裝 (2D, 2.1D, 2.3D, 2.5D, FoPLP, CPO 與 SoIC 3D) 領域、HBM 所需之關鍵設備及配件，包括但不限於：暫時貼合機、晶圓壓膜機、混合鍵結製程設備、各類製程烤箱、測試燒機爐、紫外線乾燥機。紫外線表面清潔機。
- C. 代理國內外廠商前項有關產品之報價投標經銷業務。
- D. E604010 機械安裝業。
- E. CB01990 其他機械製造業 (自動化設備) 。
- F. CE01030 光學儀器製造。
- G. CB01010 機械製造業。
- H. CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- I. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- J. F401010 國際貿易業。
- K. I199990 其他顧問服務業。
- L. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(2) 營業比重：

產品種類	113 年銷貨比例	114 年銷貨比例
半導體製程設備	35%	40%
印刷電路板製程設備	50%	50%
前瞻製程與其他電子應用設備	15%	10%
總計	100%	100%

(3) 目前之商品 (服務項目)：

志聖工業目前生產之製程設備應用領域主要包括半導體業先進封裝製程、印刷電路板業 (PCB) 與載板前瞻先進製程、其他製程設備三大產業分類，針對各產業製程發展之產品分述如下：

- 1 半導體先進封裝製程與相關製程設備應用
 - 晶圓級乾膜貼合設備、暫時貼合設備：針對超薄晶圓提供精準溫控與壓力管理，核心價值在於解決 晶圓翹曲 (Warpage) 問題，確保後續製程的穩定性。
 - 混合鍵結製程設備：實現微米級對位與無縫接合，是提升 傳輸頻寬與散熱效能 的關鍵，直接滿足高階晶圓代工與封測需求。
 - 多元化專業烤箱：涵蓋自動化、真空及壓力烤箱，主攻 Underfill 固化與去氣泡 (Void-

free)，極大化封裝體的長期可靠度。

- 測試燒機爐：建構高溫動態環境，用於執行晶片的 可靠度與壽命評估，確保出貨品質。
- 高潔淨度 / 無氧 / 熱風烘烤設備：提供 Class 100 等級的超低氧環境，防止鋼墊片或精密線路在熱處理中氧化，適用於微汙染敏感製程。
- 面板級封裝 (FoPLP) 製程設備系統：高均勻性與高產能的自動化方案，協助客戶從晶圓級轉向 面板級量產，優化成本結構。
- 表面清潔電漿處理設備：利用電漿技術去除有機汙染物並活化表面，顯著提升金屬打線與接合的 附著力與良率。

2 印刷電路板業 (PCB) 製程、IC 載板製程設備應用

- 光阻 (乾、濕膜) 製程設備：自動 / 手動壓膜系統、真空壓膜系統、濕膜塗佈系統、剝膜機 (Dry film/ABF)。
- 光固化 / 曝光製程設備：紫外線乾燥設備、內外層 / 乾溼膜 / 防焊製程之手動、半自動及全自動曝光設備、新世代曝光機。
- 熱固化製程設備：熱風烘烤設備、連續式乾燥設備、板彎壓平設備、預熱設備、烤箱節能器。
- 濕製程設備：電鍍前處理領域，水平除膠渣化學銅設備、水平化學錫設備。
- 其他：表面改質設備及耗材。

3 前瞻先進製程與其他製程設備

- 平面顯示器業 (FPD)：TFT 製程、其他 FPD (Touch Panel / TN / STN)、Mini LED、MicroLED 製程及自動化系統整合軟體
- 其他電子組裝與印刷塗裝業 (Printing & Coating)：紫外線乾燥系統、熱風烘烤設備、耗材、高頻元件製程設備、AR/VR 製程相關設備、LEO 製程相關設備、鏡頭 Lens 製程相關設備。

(4) 計劃開發之新商品 (服務)：

志聖專注 AI 產業供應鏈的技術發展與趨勢前景，延伸在印刷電路板壓膜製程之核心技術，持續發展先進封裝製程中晶圓真空壓膜系統、SoIC 混合鍵合的 3D 封裝製程設備、次世代 2.5D 封裝相關如 FoPLP 與 CPO 製程設備、半導體矽晶圓深蝕刻系統及 HBM 相關半導體高階熱相關製程設備與壓膜製程設備。

因應 HPC、AI 伺服器主板與網路通訊印刷電路板新製程演進、良率提升需求、及大陸勞動成本上升趨勢，志聖積極開發高自動化、高對位精度、高解析度及高節能之黃光室製程設備，包括防焊曝光機、對準機、真空壓膜機、壓膜預熱機、貼片機、軟板 R/R 曝光機、軟板壓膜機等。

2. 產業概況：

(1) 產業現況與發展：

過去數十年，半導體製程技術已將電晶體的線寬從數十微米逐步縮小到納米級別。然而，設計和製造成本的增加、臨界餘裕度的縮小以及其他挑戰，限制了製程技術的進一步發展。同時，隨著晶片內電晶體密度的增加，I/O 接腳數量和晶片間的互連速度面臨限制，使得單純依靠製程微縮難以滿足摩爾定律預期的效能提升，效果有限。因此，半導體行業轉向超越摩爾定律的策略，不再只關注電晶體尺寸和數量，而是包括效能、功耗、晶片面積和成本在內的多個方面。透過 2.5D 和 3D 的異質整合先進封裝製程，多種不同功能的晶片（如邏輯電路、射頻電路、微機電系統、感測器、神經運算單元等）被整合到同一封裝中。這種整合不僅延續了摩爾定律的經濟效益，也推動了半導體產業的持續發展，特別是在與 AI 應用、物聯網和 5G 等技術結合時。在消費電子產品追求更小、更輕、更薄的趨勢下，異質整合技術成為新常態。而隨著 5G、物聯網與人工智慧時代的到來，高效能與 AI 晶片成為資料中心、深度學習訓練與推理等關鍵技術的硬體架構需求大幅度增加，用以推動重要的應用市場發展。

根據 IDC，全球伺服器市場正進入由 AI 驅動的結構性成長階段，GPU 伺服器的大規模部署成為主要成長動能。AI 基礎設施建置需求已明顯凌駕總體經濟放緩、地緣政治與關稅等不利因素，顯示市場成長來自長期算力需求重構，而非短期景氣循環。2024 年全球伺服器市場規模約 2,530 億美元，年增 71.8%，反映 AI 伺服器首次大規模導入；2025 年市場規模進一步擴張至 4,554 億美元，年增 80.0%，由超大規模雲端服務商主導投資。2026 年市場規模預計達 5,659 億美元，年增率回落至 24.3%，雖成長趨於正常化，但在基期墊高下仍維持高品質成長。展望中期，IDC 預估 2024 至 2029 年全球伺服器市場年複合成長率約 28.7%。儘管 AI 模型效率持續提升，訓練與推論需求的擴張速度仍高於效率改善幅度，使市場對 AI 基礎設施投資放緩的疑慮自 2025 年起明顯降溫。整體而言，AI 驅動的算力需求將持續支撐伺服器市場成長，在 Hyperscalers 主導與企業混合部署模式並行下，全球伺服器市場至 2029 年前仍可望維持接近 30% 的年複合成長率。

然而，台灣主要客戶在先進封裝技術領域持續引領業界，致力於推動半導體技術創新，以滿足人工智慧、高效能運算、5G 和物聯網等領域對高效能晶片的需求。隨著傳統單晶片系統（SoC）在晶片間傳輸效率與運算性能方面遭遇瓶頸，公司主要客戶積極推動各類先進封裝技術，透過製程技術與異質整合技術，使不同功能的晶片能夠高效集成，進一步提升系統靈活性、擴展性及晶片間的傳輸效率，以應對市場對高效能與低功耗解決方案的需求。

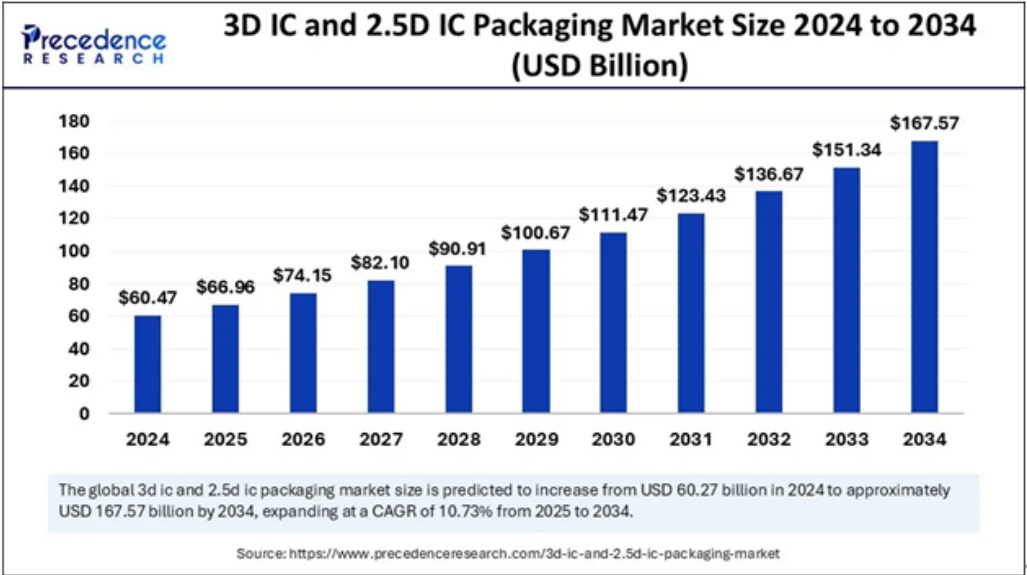
在 AI 訓練與推理應用日益廣泛的趨勢下，台灣主要客戶的 CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）和 SoIC（System on Integrated Chips）、全球領先市場的 OSAT 廠商積極導入自有先進封裝製程技術，FoPLP 製程等已成為 AI 晶片的首選方案之一。CoWoS 透過高頻寬

記憶體 HBM 與 AI 晶片的緊密整合，使數據傳輸效率顯著提升，同時保持低功耗特性，成為現今 AI 晶片的關鍵技術之一。而 SoIC 則進一步推動 3D 堆疊技術的發展，使不同晶片能以極高密度整合，實現更高效能的異質運算架構，為未來 AI 與 HPC 的發展奠定基礎。

隨著生成式 AI 的崛起，後續 Google Gemini 與 Anthropic Claude 應用多元發展。市場對高效能 AI 晶片的需求激增，直接推動 CoWoS 和 SoIC 相關封裝技術的應用與產能擴張。根據台灣主要客戶近期的法說會說明，為了應對 AI 晶片市場的強勁需求，台灣主要客戶已大幅增加先進封裝的投資，並計劃擴建新產線，提升 CoWoS 產能，確保能滿足 AI 產業對高效能晶片的需求。此外，客戶也積極發展 N3、N2 製程與先進封裝的協同設計，進一步優化晶片性能與功耗效率。

目前，台灣主要客戶已經宣布擴建 CoWoS 產線，確保 AI 晶片設計公司與雲端服務供應商能夠獲得足夠的先進封裝產能支持。由於 AI 伺服器市場需求爆發，主要客戶持續投資數十億美元於先進封裝產能擴建，並預計在 2026 年將 CoWoS 產能進一步提升，以支援如 NVIDIA、AMD、Broadcom 等主要 AI 晶片客戶。為此，主要客戶也積極與供應鏈夥伴合作，確保先進封裝材料與設備的穩定供應，以因應市場對 CoWoS 產能的迫切需求。

2025 年 AI 伺服器在 CSP 廠商中的軍備競賽般的佈建與強力需求，驅動 HPC 晶片市場迎來爆發性成長，先進封裝市場正經歷重大變革。受美國半導體禁令、美國關稅明朗化的影響與新工廠建設、OSAT（封測廠）重資源投入及產業聯盟影響，供應鏈動態正在積極重塑。預計 2024 至 2034 年間，3D IC 與 2.5D IC 先進封裝市場的年均複合成長率達 11%，並於 2034 年達到 1675.7 億美元（如下圖）。在這場技術競賽中，產業領導者正透過跨界整合鞏固護城河。台積電、英特爾與三星電子等晶圓代工與 IDM 巨擘，憑藉其在前段製程的優勢，積極主導高階異質整合技術的發展，試圖通過 CoWoS、Foveros 等自有技術綁定高階客戶；與此同時，日月光投控、艾克爾及力成科技 (PTI) 則在後段封測領域持續深化技術積累，維持市場領先地位。

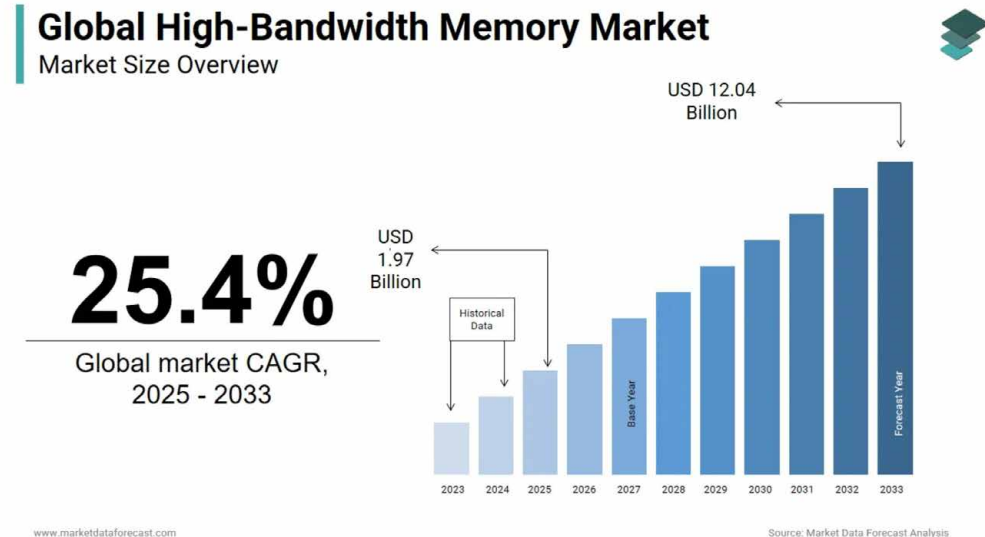


主要客戶憑藉其完整的晶圓製造與先進封裝解決方案，定義 Foundry 2.0 概念，提供客戶一站式服務，從先進製程技術到先進封裝，全方位滿足 AI、高速運算及數據中心市場的需求。隨著晶片異質整合技術的進步，主要客戶的 CoWoS、SoIC、InFO 與 WMCM 等技術將進一步發展，為 AI、HPC 與 5G 市場提供更強大的硬體支撐。此外，主要客戶也正積極開發 2.5D/3D 封裝衍伸技術，並透過與全球 AI 晶片設計公司合作，共同推動高效能運算架構的創新。

展望未來，隨著主要客戶與 OSAT 廠主導的產業發展進程，不斷優化先進封裝技術並擴展產能，其在全球 AI 晶片供應鏈中的戰略地位將進一步鞏固。未來數年，主要客戶預計將持續擴大 CoWoS 和 SoIC 產能，以應對市場對高效能 AI 晶片的龐大需求，進一步鞏固其在 AI 時代的核心地位。

除此之外，隨著 AI 晶片對高頻寬記憶體 (HBM) 和半導體先進封裝技術的需求日益增加，我們作為記憶體製造的設備供應商，也面臨前所未有的商機。HBM 技術因其能在較小體積內提供更高的數據傳輸速率和更低的功耗而成為 AI 數據中心的關鍵技術。同時，先進的半導體封裝技術，如美光 (Micron) 近期與台積電在 HBM4e 產品上展開合作，採用台積電的先進邏輯代工製程技術，為特定客戶客製化基礎晶片，以提升性能與功能。這種客製化方案允許美光在 HBM4e 中整合更多緩存和邏輯，進一步增強 AI、高效能運算等應用的數據處理能力。隨著美光與多家客戶共同開發 HBM4e，市場對客製化記憶體解決方案的需求將持續增加，進一步鞏固美光與台積電在高頻寬記憶體市場的競爭優勢。

這種技術進步不僅對終端用戶有利，也為我們提供了巨大的機遇。作為設備供應商，我們有機會開發和銷售支持這些先進技術的製造設備。從精密 3D 堆疊熱製程相關設備和封裝製程貼合用設備，這些需求推動了對創新半導體製造解決方案的探索。依據 Market Data Forecast 的預估，全球高頻寬記憶體 (HBM) 市場規模 (2024 至 2032 年) 全球高頻寬記憶體市場在 2023 年的市場價值為 12.5 億美元，預計在 2024 年將達到 15.7 億美元，並在 2032 年成長至 96 億美元，預測期間的年均複合成長率 (CAGR) 為 25.4%。



隨著 Micron 與 TSMC 等半導體製造巨頭之間合作加深，我們作為全球領先的半導體設備供應商，看到了與這些企業合作的潛力，以支持他們的先進製程和封裝技術的發展進程。這樣的合作不僅能確保我們的技術符合最新製造標準，也為進一步創新奠定了基礎。在智慧時代，從 PC、智慧手機到 AI 數據中心的所有終端應用都對半導體技術提出更高要求，而 CoWoS、SoIC 等先進封裝技術的發展正是滿足這些需求的關鍵。隨著這些技術的持續進步和應用範圍的擴大，我們預期未來將見證我們製程設備產能的高成長，為公司帶來前所未有的發展機遇。我們的壓膜、貼合、混合鍵結製程設備與各式前瞻製程烤箱不僅支持現今技術需求，也為未來 AI 應用的快速發展提供堅實基礎。隨著 CoWoS 與 SoIC 製程與 HBM 記憶體製程的需求激增，特別是在雲端計算、數據中心和深度學習領域，晶片設計廠商對高效能、高頻寬記憶體的需求將進一步推動我們設備的市場擴張。

(2) 總體經濟與產業發展趨勢：

AI 時代的台灣半導體產業：全球經濟與產業趨勢更新

隨著美國關稅解放日對各國關稅談判結果更加清晰，全球經濟和貿易政策正在進入新的調整期。川普政府將延續其「美國優先」的政策，並可能強化對中國的科技限制與關稅措施，加速全球供應鏈重組。此外，減稅與基礎設施投資計畫可能推動美國經濟成長，但也可能帶來通膨壓力與財政赤字擴大。這些變化將直接影響台灣的半導體產業，特別是在美中科技戰持續升級的情況下，台灣企業將面臨更複雜的市場環境與機會。

具體來說，川普政府可能採取以下幾項政策，影響全球半導體與 AI 產業：

1. 強化對中國的半導體與 AI 技術封鎖：
 - 美國商務部可能擴大對中國 AI 晶片與高階運算設備的出口管制，包括更嚴格的技術轉移限制和對 NVIDIA、AMD、Intel 等美國企業對華出貨的額外審查。
 - 加強對中國半導體產業的圍堵，可能阻止 ASML、台積電等企業向中國供應最先進製程 (3nm 及以下) 技術。這將進一步推動中國尋求半導體自給自足，但短期內也將增加對台灣、日本、韓國晶片的依賴。
2. 關稅談判促進美國本土半導體製造與供應鏈回流：
 - 川普政府關稅談判已顯示，他的政府將擴大《晶片法案》補助以外，吸引更多台積電、三星、Intel 在美國建立晶圓廠。
 - 可能對進口半導體與電子產品加徵額外關稅，影響台灣企業出口美國市場的成本。
3. 推動美國科技業的大規模減稅與基礎設施投資：
 - 預計將減少企業所得稅，激勵 Amazon、Google、Microsoft、Meta 等科技巨頭增加 AI 資本支出，進一步拉動 AI 伺服器與半導體需求。
 - 可能推動新一輪 5G/6G、雲端數據中心、軍事科技、低軌衛星等基礎設施計畫，帶動

對高效能運算晶片與 AI 晶片的需求。

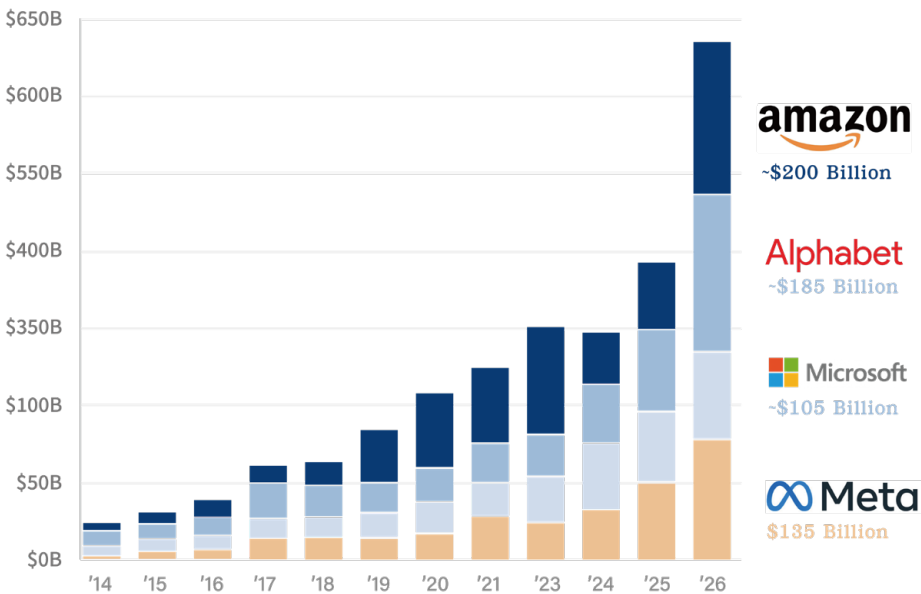
整體而言，川普的政策可能帶來全球科技產業的分裂，美中科技戰升級將迫使企業重新調整供應鏈，而美國 AI 產業的發展則可能進一步加速台灣半導體業的成長。

產業前景展望：AI 基礎設施的「重工業化」轉型與吉瓦級 (GW) 競賽

1. 典範轉移：從軟體服務到「AI 工廠」的重資產競賽 2025 年至 2026 年標誌著人工智慧產業從「模型訓練競賽」正式轉向「能源與基礎設施競賽」的歷史性轉折。正如 NVIDIA 執行長黃仁勳所定義，資料中心已不再是單純的儲存與運算單元，而是具備重工業特徵的「AI 工廠」。在此典範轉移下，算力的衡量單位已正式從「百萬瓦 (MW)」躍升至「吉瓦 (GW)」，這不僅代表運算規模的指數級增長，更確立了能源獲取能力將成為科技巨頭未來十年的核心護城河。
2. 資本支出的歷史性擴張：6,500 億美元的入場券 為了支撐此一轉型，美國四大科技巨擘 Alphabet、Meta、Amazon 與 Microsoft，正以前所未見的規模進行資本軍備競賽。市場預估，這四家公司在 2026 年的合計資本支出將高達 6,500 億美元，此金額已超越多國的全年生產總值，凸顯了 AI 基礎設施建設的高昂門檻。

- Amazon 展現最強烈的擴張企圖，預計 2026 年支出將達 2,000 億美元，遠超市場預期，重點佈局晶片、機器人與低軌衛星的垂直整合。
- Alphabet 預計將支出由 2025 年的 914.5 億美元翻倍至 2026 年的 1,850 億美元，反映其在能源資產上的激進佈局。
- Meta 亦不遑多讓，資本支出預計從 722.2 億美元跳增至 1,350 億美元，專注於長期算力儲備。
- Microsoft 則在 2026 會計年度維持 1,050 億美元的高檔投資，持續深化與 OpenAI 的基礎設施合作。

儘管如此龐大的現金消耗引發了市場對於「AI 泡沫」與「投資回報率 (ROI)」的短期擔憂，



但從長遠戰略視角來看，這是為了在吉瓦級時代維持技術主權的必要之惡。

3. 「吉瓦級」戰略佈局：能源即算力，算力即國力 在 NVIDIA Blackwell 架構大幅提升能源效率的背景下，1 GW 的電力容量約對應 50 萬顆高階 GPU 的算力集群。因此，誰能率先穩定獲取 GW 級電力，誰就能在模型訓練與推論上取得壓倒性優勢。各大 CSP 的策略已出現顯著分化與升級：

- 分散式叢集與實體化 (OpenAI & Oracle)：雙方的「Stargate」計畫已進入實質執行階段，目標於 2026 年底前完成 10 GW 的基礎設施部署，並透過分散於德州等地的 GW 級站點規避單一電網瓶頸。
- 極致密度與速度 (xAI)：採取快速迭代策略，其曼非斯「Colossus」資料中心目標在單一站點實現 2 GW 的超高密度算力，並透過自建燃氣電廠解決即時供電問題。
- 能源供應鏈的垂直整合 (Google)：Google 透過收購 Intersect Power 直接掌握 10.8 GW 的能源專案管線，並在印度建設 1 GW 樞紐，顯示其策略已從「購電」轉向「控電」，以確保 2030 年淨零碳排目標下的擴張可持續性。
- 核能與超大規模規劃 (Meta)：提出了最具野心的「Meta Compute」計畫，鎖定 6 GW 核能供應，並展望數百 GW 的長期規模，試圖透過掌控基載電力建立長期成本優勢。

總體而言，AI 產業的競爭維度已從單純的「晶片供應」與「算法優劣」，擴展至「晶片 + 能源 + 土地」的複合式博弈。未來的企業競爭將不再僅取決於 GPU 的持有量，更取決於其將數千億美元資本轉化為穩定「吉瓦級運算能力」的執行效率。這場由 NVIDIA 定義標準、四大 CSP 投入鉅資的工業革命，將在 2026 年進入決勝的關鍵週期。

AI 雙引擎驅動下的 2026 年台灣半導體：從軍備競賽到基礎設施重構

進入 2026 年，隨著生成式 AI 正式從探索期邁向規模化部署，台灣半導體產業已處於全球運算革命的絕對核心，其成長動能亦出現結構性轉變，由過往 NVIDIA 的單一獨霸，演化為「NVIDIA 通用 GPU」與「CSP 自研 ASIC」雙引擎競速的新格局。儘管市場競爭加劇，NVIDIA 仍以 Blackwell 架構及試產中的 Rubin 晶片穩居 AI 訓練市場霸主，為確保供貨，其已鎖定台積電 2026 年超過六成的 CoWoS 先進封裝產能，並積極推動技術向整合 HBM4 的 CoWoS-L 遷移，確立了台灣供應鏈在後摩爾定律時代透過異質整合延續效能的關鍵角色。

與此同時，雲端巨頭為優化總擁有成本並降低對單一供應商依賴，正掀起第二波強勁的 ASIC 自研浪潮，直接為聯發科、世芯與創意等設計服務業者注入活水。Google 的 TPU v7 與 Microsoft 的第二代 Maia 加速器已分別成為台積電 3nm/4nm 製程的重要動能，前者支撐龐大的多模態模型，後者採取「訓練 + 推論」的混合策略；Amazon 則以 Trainium 3 激進追求性價比，甚至開始探索面板級封裝等替代方案以緩解瓶頸。面對三大巨頭的同步搶單，產能

缺口迫使訂單外溢至日月光、力成科技等一線封測廠，這不僅印證了台積電執行長魏哲家關於 AI 營收年複合成長率將逾 50% 的上修預測，更顯示產業價值鏈正因晶片尺寸變大與封裝複雜度提升而倍增。

2026 年的台灣半導體已非單純依附單一客戶的週期性成長，而是成為全球 AI 基礎設施重構的基石。隨著美國「Stargate 計畫」等兆美元級基礎設施專案的推進，這波由 AI 引領的結構性成長週期，將比過往 PC 或手機時代更為持久且強勁，台灣的先進製程與封裝聚落已成為這場「晶片 + 能源」戰爭中不可或缺的戰略高地。

先進封裝技術創新：CoWoS 與 3D 堆疊

滿足 AI 需求不僅需要更多晶圓產能，晶片封裝技術的突破同樣至關重要。當前的 AI 加速器運算能力極高，功耗驚人，傳統封裝技術已經成為限制效能的主要因素。因此，台灣在先進封裝技術方面已取得領先地位，其中台積電的 CoWoS 技術是最關鍵的創新之一。CoWoS 技術允許多個大型晶片與高頻寬記憶體堆疊於同一矽中介層上，這使得 NVIDIA 的 GPU 可以與 HBM 記憶體並排整合，提供 AI 訓練所需的極高記憶體頻寬。這項技術已成為高端 AI 晶片的標準配置，不僅 NVIDIA 最新的 Blackwell GPU 依賴此技術，AMD、Google 及其他 AI 加速器也廣泛應用 CoWoS。

CoWoS 產能配置 (%)				台積電客戶組成 (晶圓)			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
輝達	52.10%	51.40%	50.10%	輝達	52.10%	51.40%	50.10%
博通	16.90%	16.20%	17.40%	博通	16.90%	16.20%	17.40%
AWS	12.40%	12.70%	11.00%	AWS	12.40%	12.70%	11.00%
AMD	10.90%	7.70%	9.20%	AMD	10.90%	7.70%	9.20%
微軟	0.00%	0.00%	0.80%	微軟	0.00%	0.00%	0.80%
聯發科	0.00%	0.00%	1.90%	聯發科	0.00%	0.00%	1.90%
賽靈思	1.20%	1.00%	0.50%	賽靈思	1.20%	1.00%	0.50%
英特爾	1.70%	1.00%	0.50%	英特爾	1.70%	1.00%	0.50%
其他	4.90%	10.00%	4.70%	其他	4.90%	10.00%	4.70%
總計 (UTR)	100.00%	100.00%	96.10%	總計 (UTR)	100.00%	100.00%	96.10%

資料來源：富邦研究

根據富邦證券研究數據顯示 (如上圖)，NVIDIA 在 2026 年將占據全球 CoWoS 產能的 50%，遠遠超過其他公司。簡而言之，如果沒有 CoWoS 這類先進封裝技術，當前的 AI 硬體效能將受到嚴重限制。因此，台積電正全力擴大 CoWoS 產能，以應對市場對 AI 晶片不斷增長的需求，確保台灣在 AI 產業供應鏈中的核心地位。進入 2026 年第一季，NVIDIA 在 AI 算力軍備競賽中的統治地位，已透過對台積電 CoWoS 產能的絕對鎖定而展露無遺。根據最新供應鏈數據，NVIDIA 今年將囊括全球約 60% 的 CoWoS 供給量，在最高階的 CoWoS-L 製程上更已鎖定近七成產能，這意味著「先進封裝」已正式超越晶圓微縮，成為定義 AI 硬體效

能與市場份額的終極護城河。

面對此一結構性需求，台積電的產能擴張策略已從被動追趕轉為主動重塑。雖然過去兩年產能已實現連續翻倍，但截至 2026 年初，市場供需缺口仍未見收斂。為此，研究機構預估台積電將 2026 年底的 CoWoS 月產能目標進一步上修至 13 萬至 14 萬片水準，並加速嘉義等新廠的擴建，全年產能達一百萬片以上。NVIDIA 執行長黃仁勳在 2026 年 2 月初於台北的談話中更直言，未來十年台積電的產出可能需要再翻倍，以應對 AI 需求的指數級增長。

這股動力也讓台積電的營收結構發生了質變。2025 年全年財報顯示，先進封裝業務的營收貢獻已正式突破 10% 的關鍵關卡，且成長增速遠超公司平均水準。這標誌著台積電已成功從傳統的「晶圓代工製造商」轉型為「系統級整合服務商」，在 AI 價值鏈中，其定價權與不可替代性已隨著摩爾定律的演進而同步攀升，確立了台灣在全球半導體地緣政治與經濟版圖中更為核心的戰略地位。。

為了加快擴產，台積電甚至開始將部分 2.5D 封裝業務外包，其中包括委託日月光旗下的矽品精密工業進行 2.5D CoWoS 封裝代工，並計劃於 2025 年第二季開始大規模生產 AI 晶片的 CoWoS 封裝。這種前所未有的供應鏈合作模式，顯示出台灣半導體業者正在聯手應對產能瓶頸，以確保 AI 晶片供應穩定。

在 2.5D 矽中介層技術之外，半導體的下一個發展方向是 3D 堆疊技術。台積電的 SoIC (System on Integrated Chips) 技術透過 直接銅對銅鍵結 (direct copper-to-copper bonding)，以極高密度將晶片垂直堆疊。這種技術允許 邏輯晶片 (logic die) 直接堆疊於 I/O 晶片或其他計算單元之上，等同於在三維空間內建構 CPU 或 AI 加速器，使得效能大幅提升。

SoIC 採用混合鍵結 (Hybrid Bonding) 技術，目前已能達到 6μm 的互連間距，並預計在 2027 年縮小至 3μm，能夠支援數千個晶片內部的互連點，其訊號密度遠超傳統凸塊 (bump bonding) 封裝技術。台積電正在積極擴充 SoIC 產能，以滿足市場需求。與 CoWoS 相比，SoIC 由於屬於前端晶圓製程 (front-end wafer bonding)，較少受到封裝基板與設備工具的瓶頸影響。這項大規模的產能擴張顯示，台積電認為 3D 堆疊技術將成為 AI 高效能運算與高端消費電子產品的主流封裝方式。透過持續的技術創新與產能擴充，台積電正穩固其在 全球 AI 晶片與先進封裝市場的領導地位，確保台灣在未來 AI 產業供應鏈中的關鍵角色。

未來，半導體產業將逐步進入異質整合 (Heterogeneous Integration) 的時代，這將結合多種封裝技術，以進一步提升 AI 晶片的效能。台積電的技術路線圖已經構想將 SoIC 3D 堆疊晶

粒 (chiplets) 放置在更大的 CoWoS 矽中介層之上，這種方法將 3D 堆疊與 2.5D 技術融合，形成「系統級封裝 (System on Package, SoP) 」。這樣的創新對於 AI 晶片來說至關重要，因為隨著摩爾定律 (Moore’ s Law) 放緩，提升運算能力的關鍵將轉向先進封裝技術。隨著晶片架構日益複雜，封裝技術必須同步進化。未來會在封裝內部整合矽光子 (Silicon Photonics) 技術，讓多顆 GPU 透過光學互連，這種技術不僅能突破傳統電子訊號的頻寬限制，還能顯著降低功耗，提高 AI 訓練與推理的效率。

未來的先進封裝可能會加入光學連接 (Optical Links) 和其他創新技術，以突破電氣訊號在頻寬與功耗上的限制。這些技術創新幾乎全部圍繞台灣展開——台積電與其合作夥伴已經建立完整的 3DIC 生態系統 (3D Fabric Alliance)，推動封裝技術的前進。G2C+ 聯盟夥伴亦均為聯盟成員之一。

台灣：從晶片製造者到 AI 計算核心的設計者

這些發展顯示，台灣已經不再只是全球晶片的製造中心，更正在主導 AI 晶片的封裝與組裝技術。如今，先進封裝技術的重要性已經等同於先進製程節點的發展，因為封裝創新將直接影響 AI 晶片的效能與功耗。而台灣正在大舉投資，以確保自己能在這場 AI 革命中保持領先地位。趨勢已經十分明確：為了滿足全球對 AI 運算的「無限需求」，先進封裝技術將成為未來半導體產業競爭的關鍵，而台灣正穩步邁向 AI 晶片生態系統的核心。

下一代伺服器主機板與 PCB 技術：邁向高層數與 HDI 的整合

AI 伺服器的運算需求正在徹底重塑 PCB 技術規格。為了支援 NVIDIA、AMD 等高性能 GPU 及 ASIC，伺服器主機板正從傳統設計轉向高密度互連 (HDI) 與超高層數多層板 (HLC MLB)。目前的 AI 伺服器應用 (如 OAM 加速器模組與 UBB 通用基板) 已普遍採用 20 至 30 層甚至更高的板層結構，且必須使用極低損耗 (Extreme Low Loss) 的材料與 HVLP 銅箔來確保訊號完整性。此外，隨著傳輸速度需求提升，技術路徑正朝向 2026 年導入的 CPO (共同封裝光學元件) 與光學互連技術演進，這將進一步推動對先進封裝基板的技術要求。

台灣半導體生態系統：產能擴張與「台灣 + 東南亞」的供應鏈韌性

台灣 PCB 產業的產能擴張已不再侷限於本地，而是形成「台灣研發、東南亞製造」的雙軌韌性。為了應對地緣政治風險與關稅挑戰，台灣主要 PCB 製造商 (如臻鼎、欣興、滬士電、華通等) 正積極將產能擴展至東南亞，其中泰國已成為最關鍵的 PCB 新興製造中心。這種供應鏈的重新佈局不僅分散了風險，更確保了在全球貿易緊張局勢下，台灣供應鏈仍能穩定為全球雲端服務供應商 (CSP) 提供關鍵零組件。

依據近期 Prismark 報告調查主要 PCB 供應商正以前所未有的速度在東南亞建立產能，以縮

短從建廠到營收貢獻的 4-5 個季度週期：

- 臻鼎：作為產業龍頭，其 2025 年前三季資本支出激增 120.9% 至 7.92 億美元，積極在泰國建設高階產能以應對 AI 與伺服器需求。
- 欣興：除了台灣，亦在泰國與越南擴展產能，並在德國進行投資，維持全球化佈局韌性。
- 滬士電子受惠於 AI 伺服器強勁需求，營收大幅成長 47.2%，並正積極建設泰國廠以分散風險。
- 金像電專注於高階伺服器板，營收成長高達 55%，其泰國新廠是支撐未來產能的關鍵。

產能擴展與 AI 驅動的高成長

AI 驅動的成長不再只是願景，而是具體的數據爆發。Goldman Sachs 研究預估，全球 AI 伺服器 PCB 與 CCL 市場在 2025 至 2027 年間將分別以 140% 與 179% 的年複合成長率高速增長，整體市場規模預計在 2027 年達到 270 億美元。這一波成長主要由 AI 伺服器 (包含 GPU 與 ASIC)、高速網路交換機以及衛星通訊的需求所推動。為了搶佔這波商機，供應商正積極擴充高階 HDI 與多層板產能，特別是針對 OAM 與交換機板 (Switch board) 的高毛利產品。為了搶佔這塊「贏者全拿」的市場，Goldman Sachs 指出關鍵玩家展現了驚人的資本支出力道：

- 勝宏科技 (Victory Giant)：為了鎖定 NVIDIA 與 Google TPU 的訂單，其 2025 年前三季資本支出暴增 377.6% 達到 5.07 億美元，顯示出極其激進的擴產企圖心。
- TTM Technologies：作為北美重要供應商，其資本支出也成長了 122.4%，主要用於馬來西亞與美國的擴產。
- 深南電路 (Shennan Circuits)：資本支出成長 28.9%，並預計在 2027 年後獲得更多 Google TPU 訂單份額。

解決先進基板瓶頸：從 ABF 到 Low-CTE 玻纖布再到類 CoWoS 的多元製程迭代
雖然 ABF 載板短缺問題已隨著產能擴充而逐步緩解，但產業瓶頸正明顯上移至上游先進材料與更高階的封裝技術節點。其中，最關鍵的限制來自用於大尺寸 FCBGA 基板的低熱膨脹係數 (Low-CTE) 玻纖布與核心材料。隨著封裝尺寸放大與 I/O 密度持續提升，傳統材料在翹曲控制、尺寸穩定性與良率上的極限逐漸浮現，成為制約高階載板量產的核心因素。為強化供應鏈韌性並突破摩爾定律與有機中介層的物理限制，產業正加速投入玻璃核心基板與細間距 (Fine-pitch) 2.3D 先進封裝載板技術的研發。玻璃基板具備更低的 CTE、更佳的平坦度與尺寸穩定性，被視為支援未來超大尺寸封裝與高 I/O 密度的關鍵解方，尤其適用於下一代 AI 與 HPC 晶片。在先進封裝產能方面，TSMC 的 CoWoS 仍受限於製程與設備瓶頸，使市場對替代或補充方案的需求持續升溫，包括 Intel EMIB 等異質整合技術的應用彈性亦受到關注。展望 2026 年以後，隨著封裝尺寸邁向更大規模 (例如達到 9 倍光罩尺寸的 A16 SoIC 架構)，產業勢必需突破現有有機中介層在光罩尺寸與製

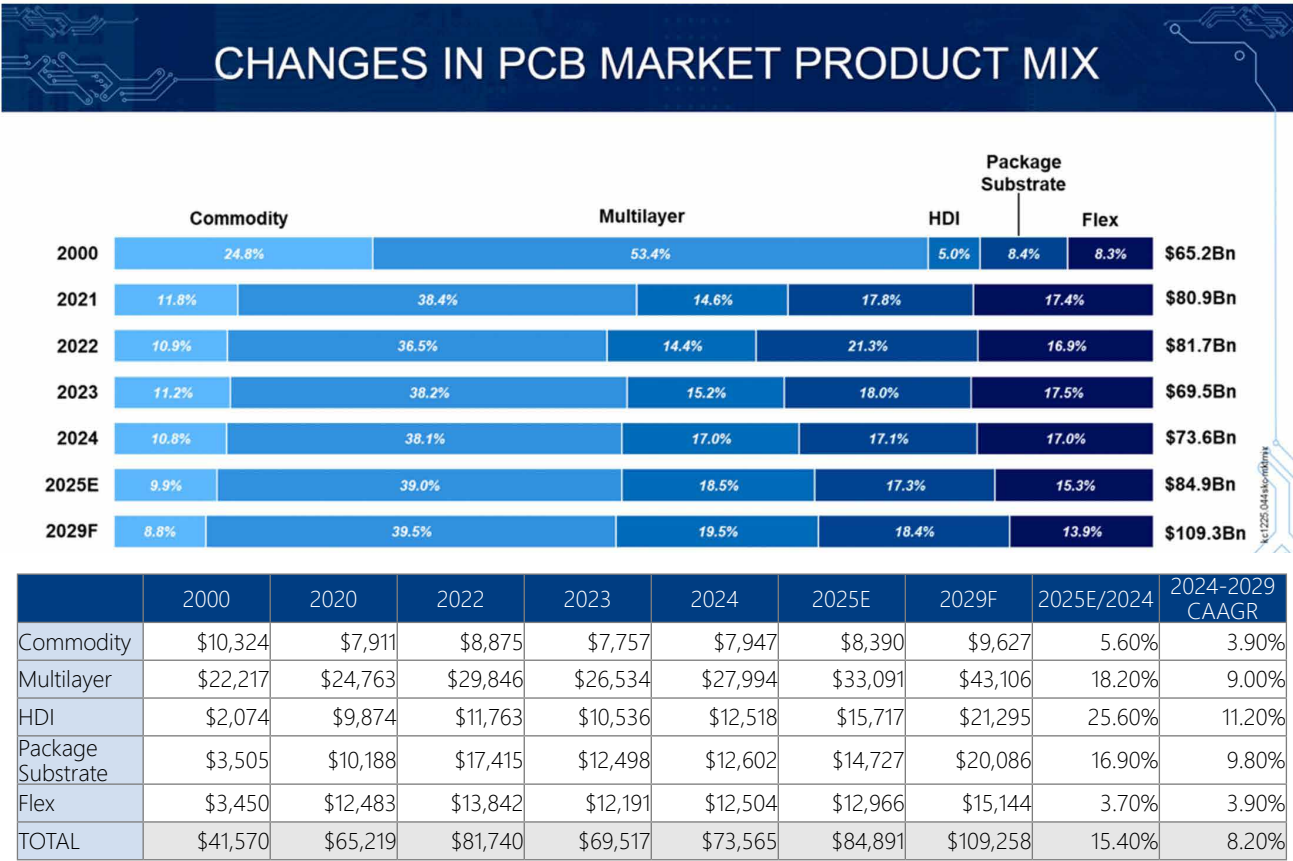
程良率上的限制，進一步推動玻璃核心基板與細間距 2.3D 封裝的商用化進程。

在此趨勢下，欣興等台灣載板大廠，已與上游材料供應商展開深度合作，積極進行新型低-CTE 材料與玻璃基板的認證與共同開發；同時，Ibiden 等國際載板廠亦持續加大在高階 ABF 與先進封裝基板領域的投資。這類「材料 × 載板 × 封裝」的協同開發能力，將成為 2026 年後 AI 晶片封裝競賽的關鍵價值鏈變化。

台灣的關鍵地位：從晶片製造到先進封裝的完整產業鏈

台灣在 AI 時代的關鍵地位，已從單純的晶片製造延伸至包含光學封裝（如 TSMC 的 COUPE 技術）與 PCB 設備的完整生態系，。台積電的 CoWoS 產能與技術路徑（如將光學引擎整合至中介層）引領著封裝技術的演進，而台灣的設備供應商與 PCB 廠則緊隨其後，提供必要的製程支援，。主要 PCB 供應商如臻鼎、欣興在 2025 年的營收表現回復強勁，顯示台灣在全球 AI 硬體供應鏈中「贏者全拿」的優勢地位日益鞏固。

PCB 針對 AI 應用需求的產業展望



2025 年標誌著電子產業強勁復甦的轉折點，PCB 市場預計將成長 15.4%，並由 AI 伺服器與高速網路基礎設施領軍。展望 2026 年及更長遠的未來，AI 的影響力將從雲端資料中心外溢至邊緣裝置（AI PC、手機）與汽車電子，。我們可以預期：

- 1. 技術持續突破：從傳統多層板向 HDI、玻璃基板及矽光子技術的快速遷移。

- 2. 供應鏈深度合作：NVIDIA、Google 等超大規模業者將更深度參與 PCB 與材料的規格制定，與台灣製造商形成更緊密的共生關係，。
- 3. 生態系共榮：對 AI 算力的追求將刺激超越 AI 本身的技術進步（如低損耗材料、先進鑽孔設備），使得整個電子供應鏈受惠。

在沒有重大地緣政治干擾的情況下，台灣結合了卓越的製造能力、靈活的跨國產能佈局以及對尖端 AI 需求的快速響應能力，已為未來十年的產業領導地位奠定了堅實基礎。台灣廠商將繼續扮演研發與高階製造的核心角色，同時透過泰國等地的海外產能，構建出「台灣研發、全球製造」的強韌供應鏈，為未來十年的產業領導地位奠定基礎。

3. 技術及研發概況：

(1) 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品：

單位：新台幣仟元

年度	研究發展支出	開發成功的技術或產品	合作對象
114 年	542,579 仟元 (佔營收 8.89%)	大尺寸自動滾輪壓膜機、高階滾輪壓膜機、多腔真空壓膜機、STR 滾輪壓膜機、二代 ABF 剝膜機開發、半導體真空 OVEN、面板及封裝熱處理設備及壓膜設備、半導體自動化 Plasma 及 oven、	日本設備商、國內 PCB、SEMI、FPD 領導廠商
115 年 第一季	164,847 仟元 (佔營收 7.29%)	智慧滾輪壓膜設備研發、G8.5 PI Prebake 設備開發、Micro LED 貼膜機、車載保護膜貼合、車載壓力脫泡設備、半導體產創計畫 - 晶圓級 RDL 介電製程設備	

4. 長、短期業務發展計劃：

(1) 短期計劃：

A. 行銷策略

- a. 推展 2.5D/3D IC 製程之壓合、貼膜、混合鍵結製程設備、半導體用各式烤箱設備。
- b. 深耕固有市場與客戶並持續推出高階產品，並評估參與潛在客戶的前瞻製程開發案。
- c. 持續深耕兩岸市場並推廣至泰國、東南亞、印度與歐美日。
- d. 將觸角推向新能源領域及關注環境變遷的需求（循環經濟）。

B. 生產策略

- a. 精實管理，以不斷改善，降低成本，穩定品質，為研發資材因應景氣循環及微利時代之首要任務。
- b. 提升資材製造管理能力，致力於庫存最佳化的管理。
- c. 加強共用零組件模組化、標準化的設計，並留意環保減廢。
- d. 提升零組件，材料及粗加工外包之議價及品質控管能力。
- e. 進一步完備及修正調整各項產品之生產裝配工序，組裝規範，製程檢驗規範，使生產

- 易製化及標準化、同時提升產品功能客製化的能力。
- C. 產品發展策略
 - 整合核心關鍵技術，擴大產品組合，延伸產業應用，並與策略夥伴技術與市場合作。
- D. 品質策略
 - 以 PDCA (計劃、執行、檢討、修正) 的循環管理模式依據 ISO-9000 品質系統由 QC 提昇為 QA 品質保證，加強客戶滿意度，滿足客戶之品質需求。
- (2) 長期計劃：
 - A. 行銷策略：
 - a. 以自有品牌與 G2C+ 聯盟為方針。
 - b. 以壓、貼、撕、烤、濕、電漿為技術基礎，成為設備領導廠商，客戶的前瞻設備研製中心為定位。
 - c. 從大中華地區為市場，擴大至新興經濟體與先進國家。
 - d. 以優勢產品組合及整合性服務解決方案為市場區隔訴求，與策略夥伴市場合作。
 - B. 生產策略
 - a. 建立並發展核心供應商體系。協助提升供應商因應景氣循環之應變能力及大陸地區快速穩定供貨的能力。
 - b. 深化兩岸研發能力，深耕引領產業發展的核心技術。
 - c. 因應情勢調整大陸生產基地及台灣的兩岸有效分工，循環經濟產業，與策略夥伴研發合作。
 - C. 產品發展策略
 - 以核心技術為基礎，配合科技產業、新興再生能源產業、環保醫療產業的技術演進及市場的需求，延伸應用領域之發展。
 - D. 品質策略
 - a. 配合公司經營成長、堅持品質、專業踏實，循序漸進導入 QA 品質保證，提升公司競爭優勢，滿足顧客需求，使企業邁向國際化。
 - b. 以顧客為導向為提升整體服務、創造整體顧客價值。

二、市場及產銷概況

1. 市場分析：

- (1) 銷售地區：台灣、大陸、日本、美國、韓國、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、印度等地。
經銷商：香港 (大陸)、日本、美國、韓國、新加坡、越南、泰國、印度。
- (2) 市場佔有率
公司專注於提供高度專業化的半導體先進封裝製程設備於客戶製程中驗證後於量產中使用。我們的產品線涵蓋了一系列前瞻專用的設備，專為滿足客戶技術要求而設計，從而支援客戶實現更小型化、更高性能和更高效率的晶片封裝製程。在這個細分市場中，公司設備不僅關鍵且獨特，部分甚至達到獨家供應，這反映了我們在技術創新和客戶需求解決方案方面的專注地位。
由於我們專注於特定且高度專業化的製程技術，傳統的市場佔有率計算方法可能難以完全捕捉我們設備的市場影響力和價值。在這種情況下，我們更重視深化技術領導地位、擴大技術影響範圍以及與客戶建立和維護長期合作關係，而非關注市場佔有率。透過這種方式，我們先進封裝技術的細分市場中為客戶提供了無可替代的價值，並持續推動行業向前發展。僅以市場調研機構報告分別闡述各區塊潛在規模產值，對應當前公司產業區塊的產值或營收。

- (3) 市場未來之供需狀況與成長性
志聖為台灣電子產業製程設備領導廠商，以五大核心技術整合為基礎，應用在七大產業，為大中華區之主要電子產業提供相應的製程解決方案。各主要電子產業的資本支出計畫為志聖工業產品市場主要之指標，因此以下將以主要之客群產業之資本支出作為志聖產品供需狀況及成長性的說明。

半導體市場：

半導體產業分布廣泛，大致可區分為上游 IP 設計及 IC 設計業；中游 IC 製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等業，以及下游 IC 封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件 (如基板、導線架)、IC 模組、IC 通路等業。產業中每家公司各司其職，從 IC 設計公司設計完成產品，委由專業晶圓代工廠或 IDM 廠 (整合型半導體廠，從 IC 設計、製造、封裝、測試到最終銷售都一手包辦) 製作成晶圓半成品，再經由前段測試，後續轉給專業封裝廠進行切割及封裝，最後由專業測試廠進行後段測試，測試後之成品則經由銷售管道售予系統廠商裝配生產成為系統產品，銷售至全世界各處。台灣半導體產業發展較早，人才技術具有領先優勢，因此擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工。

根據 WSTS (世界半導體貿易統計) 與 SIA (半導體產業協會) 在 2025 年秋季至 2026 年初發布的最新報告與數據，全球半導體市場的展望已大幅上調。市場在 2024 年確立了強勁的反

彈態勢，最終全年產值達到 6,280 億美元，年增幅為 19.1%。進入 2025 年，成長動能不僅延續且更為強勁，受惠於人工智慧 (AI) 與雲端運算的龐大需求，2025 年全球半導體銷售總額創下歷史新高，達到 7,917 億美元，年增率高達 25.6%，遠超乎原先預期的雙位數成長。

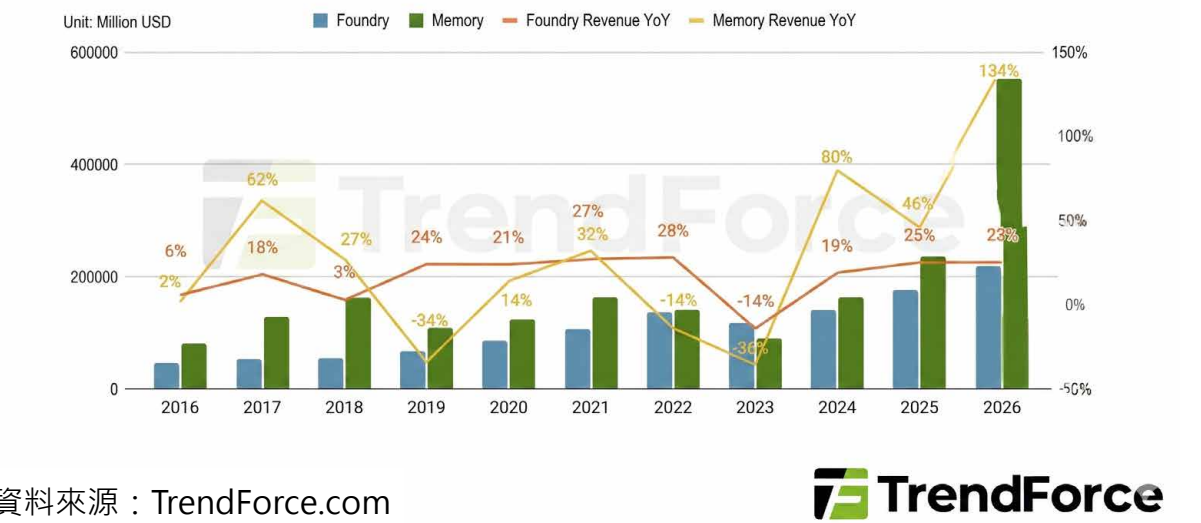
展望 2026 年，WSTS 預期全球半導體市場將持續擴張，年度產值預估將達到 9,750 億美元，甚至有望挑戰 1 兆美元的里程碑，預計年增率約為 23% 至 26%。這波成長趨勢持續由邏輯晶片 (Logic) 與記憶體 (Memory) 兩大領域主導，特別是在 AI 基礎設施建設的推動下，這兩大類別的強勁需求將繼續扮演產業成長的核心引擎。

Autumn 2025	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Americas	195,123	251,926	338,574	45.2	29.1	34.4
Europe	51,250	54,127	60,429	-8.1	5.6	11.6
Japan	46,739	44,835	50,164	0	-4.1	11.9
Asia Pacific	337,437	421,354	526,293	16.4	24.9	24.9
Total World - \$M	630,549	772,243	975,460	19.7	22.5	26.3
Discrete Semiconductors	31,026	30,900	33,436	-12.7	-0.4	8.2
Optoelectronics	41,095	42,597	45,020	-4.8	3.7	5.7
Sensors	18,923	20,894	22,713	-4.1	10.4	8.7
Integrated Circuits	539,505	677,852	874,291	25.9	25.6	29
Analog	79,588	85,552	91,988	-2	7.5	7.5
Micro	78,633	84,839	96,620	3	7.9	13.9
Logic	215,768	295,892	390,863	20.8	37.1	32.1
Memory	165,516	211,568	294,821	79.3	27.8	39.4
Total Products - \$M	630,549	772,243	975,460	19.7	22.5	26.3

資料來源：WSTS.org

再細看半導體代工市場的規模，根據市場分析機構 TrendForce 在 2026 年初發布的最新報告，全球晶圓代工市場的成長動能遠超乎預期。受惠於 AI 基礎設施建設的爆炸性需求，以及 CSP (雲端服務供應商) 對 AI 伺服器的龐大投資，2025 年市場表現優於原先預期，推升全年產值規模遠超原始預估。展望 2026 年，TrendForce 預測全球晶圓代工產值將進一步年增 25%，達到 2,187 億美元的歷史新高。

Global Memory and Wafer Foundry: Market Revenue Trends (2016–2026)



資料來源：TrendForce.com

市場競爭格局方面，2025 年下半年「大者恆大」趨勢更為顯著。台積電至 2025 年第三季與第四季，全球市佔率已攀升至 70%~72%，穩居絕對龍頭地位。這波增長主要由 NVIDIA Blackwell 平台、Apple iPhone 新機及 CSP 自研晶片對 3nm 與 5/4nm 先進製程的強勁需求所驅動。相較之下，成熟製程受限於中國產能擴張與價格競爭，復甦力道溫和，產業呈現明顯的兩極化發展。

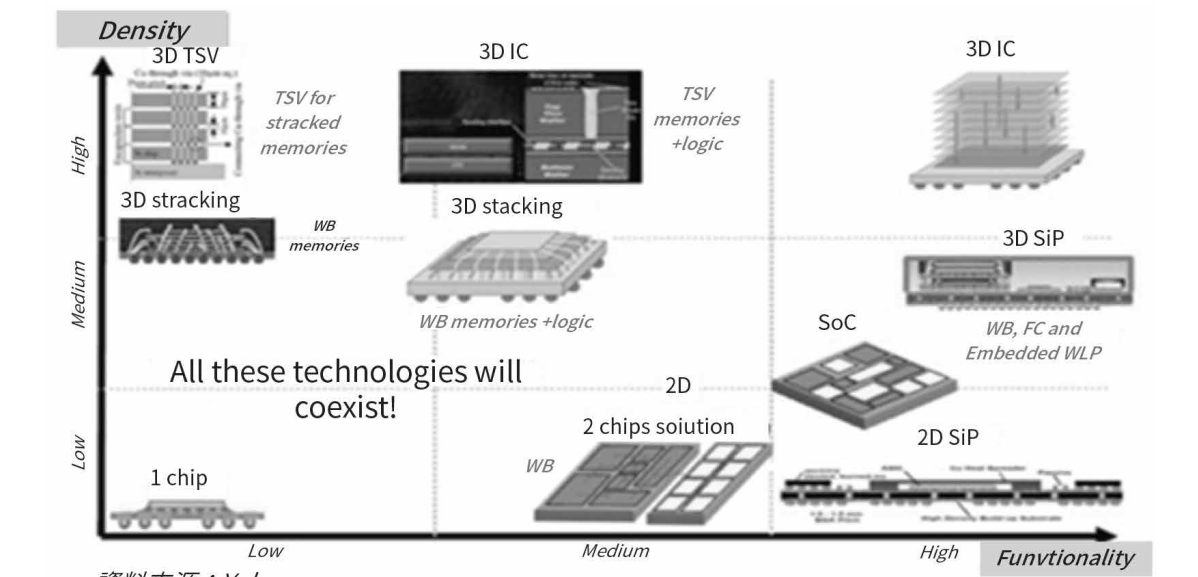
在技術與封裝趨勢上，台積電不僅在前段先進製程保持領先，其後段先進封裝產能更是市場關鍵。隨著 AI 晶片算力需求激增，市場對 CoWoS 與 SoIC 等 3D/2.5D 先進封裝技術的需求呈爆發式增長，訂單能見度已延伸至 2026 年之後。

現今晶圓代工技術發展依然以製程微縮為主，因為 IC 要提升效能最快的方式就是微型化，在越小的空間佈更多的線路效能越佳，下圖為半導體產業先進製程變化及新製程技術預估，其中，台積電 2021 年開始導入 5 奈米製程，並在 2022 年開始量產 3 奈米產品，其技術持續領先其他晶圓代工廠，成為這波新技術演進中的最大受惠者。



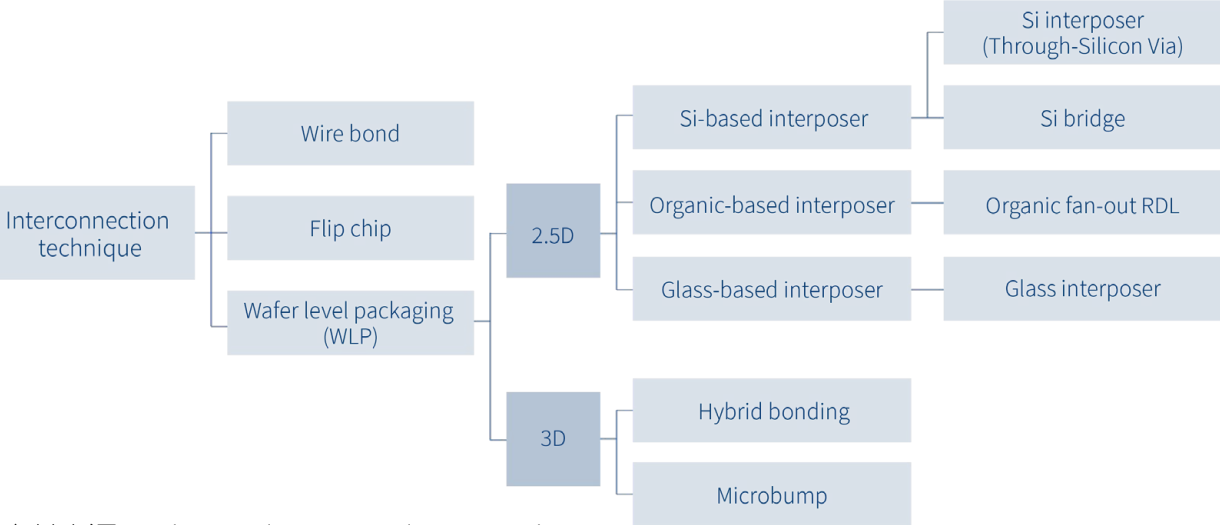
資料來源：工研院產科國際所

在各種不同系統封裝技術中，最有機會讓封裝遵循摩爾定律演進的互連技術，稱為 3D TSV 直通矽晶穿孔 (Through-Silicon Via) 封裝技術，其設計概念是來自於印刷電路板 (PCB) 多層化的設計，TSV 可像三明治一樣堆疊數片晶片，是一種可以電力互相連接的三次元堆疊封裝 (Stack Package)，TSV 使 2D 平面晶片配置技術演進至 3D 堆疊技術，目前晶圓代工及封測廠已積極切入 3D IC 封測。



在接下來的這幾年，3D IC 堆疊晶片技術的應用會在更多更廣泛的種類明顯增加，特別是需要強大計算能力和記憶體容量的應用，包括多核伺服器 and 人工智慧相關應用。另外，隨著系統內部組成越來越異質化，3D IC 堆疊技術則成為關鍵，一個異質化的系統會由各種不同的零組件構成，如記憶體、影像感測器、用於類比功能和射頻的三五族電子設備、處理器、低功耗電子設備等，以最適合的技術去設計和加工每一個零組件，然後再利用 3D IC 堆疊技術將其封裝成單元件，藉此可使電子系統的運作效能增進、成本和功耗降低。

2.5D and 3D Packaging technology:



資料來源：Advanced Semiconductor Packaging 2024-2034

	3D-SIP			3D-SIC	3D-SOC			3D-IC
3D Technology	"PoP"	"Chip last"	"Chip first"	Die stacking	Parallel W2W		Sequential FEOL	
3D-Wiring level	Package I/O	Chip I/O	Chip I/O	Global	Semi-global	Intermediate	Local	FEOL
Partitioning	Functional unit	subsystem	Embedded die	Die	Chip BEOL Wiring Hierarchy		Standard cells	Transistors
Technology	Package-to Package reflow	Multi-die SIP 3D/2.5D stack	FO-WLP Embedded die	3D D2D, D2W 2.5D Si-interposer	Wafer-to-Wafer bonding		Active layer transfer or deposition	
2-tier stack Schematic					Hybrid bonding	Via-last		
Characteristic	Solder ball Stack	• C4, Cu-pillar • Si-Organic • Through-Mold-vias	• Bumpless • Si-RDL • Through-Package-vias	• μbump • Si-to-Si • Through-Silicon-Via	BEOL between 2 FEOL layers		FEOL stack	
Contact Pitch	400⇒350⇒300μm	120⇒80⇒60μm	60 ⇒40 ⇒20μm	40 ⇒20 ⇒10⇒5μm	5μm ⇒ 1 μm	2 μm ⇒ 0.5 μm	200nm ⇒ 100nm	< 100 nm
Relative density:	1/100⇒1/77⇒1/55	1/9⇒1/4⇒1/2.3	1/2.3 ⇒ 1 ⇒ 4	1 ⇒ 4 ⇒ 16⇒ 64	64 ⇒ 1600	400 ⇒ 6400	4 10 ⁴ ⇒ 1.6 10 ⁵	> 1.6 10 ⁵

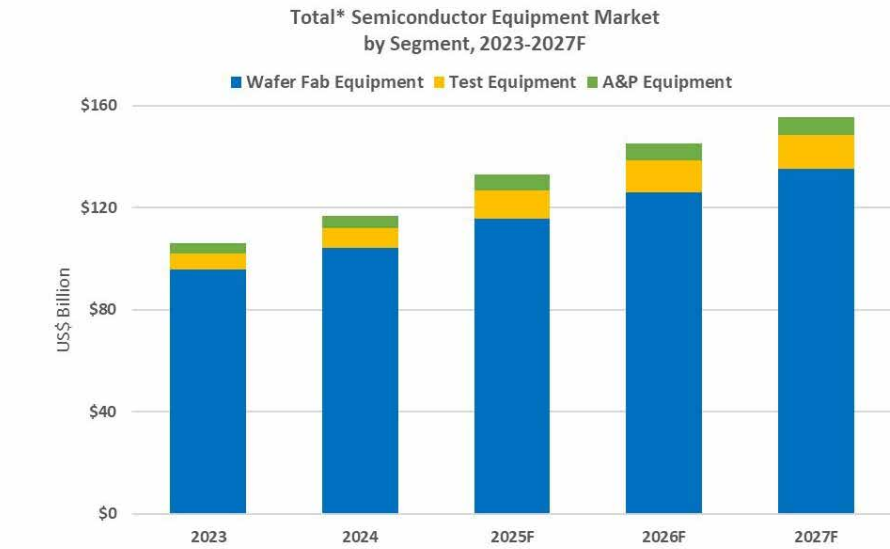
資料來源：愛美科技

隨著全球半導體產業晶圓廠設備持續擴增，資本支出正朝向歷史新高邁進。SEMI 國際半導體產業協會於 2025 年 12 月發布的年終整體 OEM 半導體設備預測報告 (Year-End Total Semiconductor Equipment Forecast) 中指出，2025 年全球半導體製造設備銷售總額預計將年增 13.7%，攀上 1,330 億美元的歷史新高紀錄。這股成長力道預計將延續至 2026 年，在前、後段製程需求共同驅動之下，年度銷售總額可望再創佳績，來到 1,450 億美元 (部分

預測甚至上看 1,560 億美元) 。

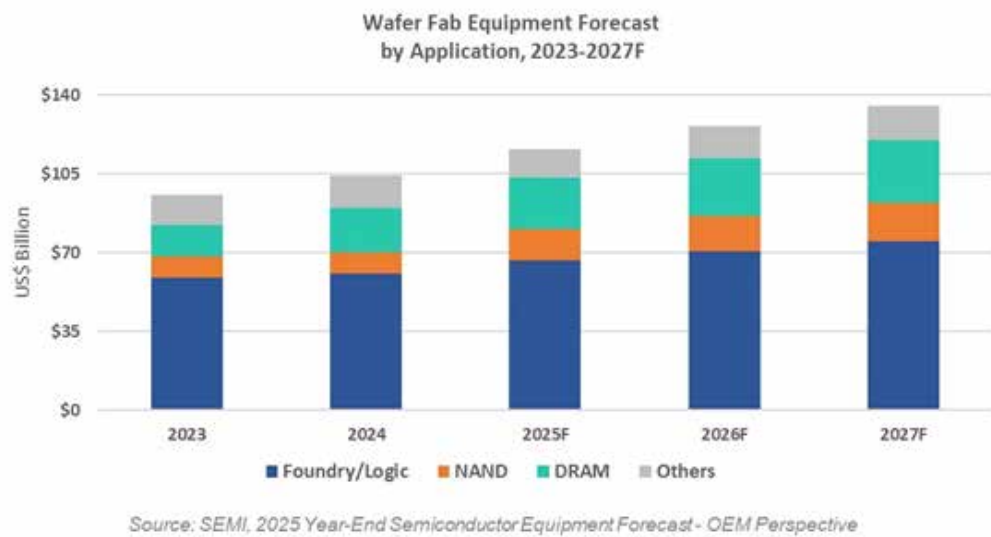
其中，人工智慧 (AI) 伺服器、高效能運算 (HPC) 與資料中心的需求仍是主要推手，而電子裝置作為其骨幹，需求持續呈現爆炸性的成長，穩居這波設備支出來源的最大宗。在區域市場方面，中國大陸憑藉成熟製程的龐大產能擴充，持續位居全球最大設備市場；而台灣則受惠於台積電在先進製程與先進封裝 (CoWoS、SoIC) 的絕對領導地位，帶動相關供應鏈與邏輯晶片製造商大舉投資，穩居全球第二大設備市場，並持續拉大與第三名韓國之間的差距，成為全球先進製程設備需求的核心重鎮。

在後段設備方面，歷經先前的調整後，復甦力道遠超乎預期。2025 年半導體測試設備銷售額出現驚人的 48.1% 成長，達到 112 億美元；組裝和封裝設備則有 19.6% 的增幅，銷售額達 64 億美元。SEMI 預估，這股後端部門的飆升趨勢將延續至 2026 年，背後成長動能主要來自日益複雜的 AI 高效能運算晶片對異質整合封裝的依賴，以及針對汽車、工業和消費性電子終端市場需求的預期復甦。此外，後段製程產能必須隨時序推展而大幅擴充，才能消化晶圓廠不斷往上攀升的先進製程供應量能。由此可推算，後段設備佔總體半導體產業晶圓廠設備約 11.2%(112 億美元加上 64 億美元 v.s. 1560 億美元)



Source: SEMI, 2025 Year-End Semiconductor Equipment Forecast - OEM Perspective
*Total equipment includes new wafer fab, test, assembly, and packaging, but does not include wafer manufacturing equipment
Totals may not add due to rounding.

以半導體設備銷售類別來看，晶圓廠設備 (Wafer Fab Equipment, WFE，含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備)，2025 年銷售額預計成長 11.0%，達到 1,157 億美元，高於原先預期。SEMI 指出，AI 運算效應全面發酵、中國設備支出維持高檔，以及對 DRAM 和高頻寬記憶體 (HBM) 的巨額投資，都是數字上修的主因。展望 2026 年，在先進邏輯 (2nm/A16) 和記憶體應用需求增加帶動下，晶圓廠設備銷售額可望更上一層樓，預估將成長至 1,250 億美元以上。



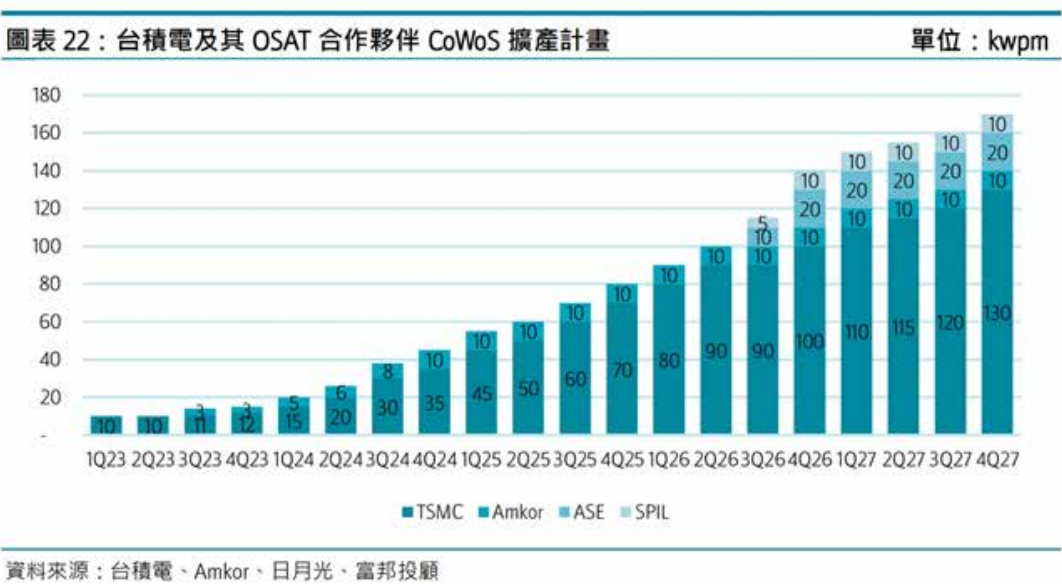
以半導體設備銷售應用別來看，2025 年晶圓代工和邏輯應用晶圓廠設備銷售額維持穩健成長，預計達到 648 億美元，這主要受惠於先進技術需求不斷增長、新設備架構引進以及 2nm 等先進產能擴張採購增加；預計 2026 年將持續成長，來到 690 億美元。

記憶體相關資本支出在 2025 年成長最為顯著，並預計於 2026 年持續走揚。受惠於 3D NAND 技術堆疊層數推進，2025 年 NAND 設備銷售額強勢反彈，大幅成長 45.4% 至 140 億美元，為 2026 年續增至 157 億美元奠定基礎。DRAM 設備銷售額則在 AI 應用元件上所需的 HBM 記憶體產能競賽，以及製程微縮需求激增的推波助瀾下，2025 年上漲 15.4% 至 225 億美元，2026 年預計將再成長 15.1%，顯示記憶體產業正處於一波由 AI 驅動的超級循環中。

綜合上述產研報告預估 2026 年金額 (US\$B) 整理相對佔比

半導體總體產值	975.5	100%		
半導體代工產值	218.7	22.4%	100%	
TSMC 產值	160.0	16.4%	73.2%	
半導體設備資本支出	156.0	16.0%	71.6%	100%
半導體封裝與測試設備資本支出	17.6	1.8%	8.0%	11.2%
半導體先進封裝設備規模	11.2	1.15%	5.1%	7.2%

過去兩年，CoWoS 先進封裝技術已成為 AI 晶片產能提升的關鍵瓶頸。隨著 AI 運算需求爆發，NVIDIA 作為台積電 CoWoS 技術的最大客戶，其 GPU 產品的高度需求導致封裝產能持續緊張。為了解決供需失衡的問題，台積電在 2023 年宣布擴大 CoWoS 產能，並在 2024 年將該技術的產能提升至兩倍以上。然而，市場需求仍然遠超供給，促使台積電加速擴展先進封裝產能，以確保 AI 晶片供應的穩定。



根據市場研究資訊（如上圖），台積電目前的 CoWoS 產能約為 7 萬片（wafer per month, WPM），並預期於 2026 年底將年產能提升至超過 10 萬片 / 月。進一步來看，以支撐 NVIDIA、AMD、Google 及其他 AI 晶片客戶的高速成長需求。此外，HBM（高頻寬記憶體）封裝的技術突破也是影響產能的關鍵，業界預測，2025–2026 年 HBM4 及後續版本的導入將進一步驅動台灣半導體公司在先進封裝技術的擴張。

為進一步鞏固市場領先地位，台積電在 2024 年宣布，計劃於嘉義、台南等地興建新的先進封裝廠，專注於 CoWoS 及 3D 堆疊（SoIC）技術。這些新工廠的產能將在 2025-2026 年逐步開出，預計 2025 年進入大規模量產。這一系列投資顯示，台積電不僅致力於提升現有的 2.5D CoWoS 產能，更著眼於 3D 堆疊（SoIC）及矽光子（Silicon Photonics）等異質整合技術的發展，以確保未來 AI 與高效能運算（HPC）市場需求的長期供應能力。

在台積電擴充 CoWoS 產能的過程中，志聖工業作為關鍵設備供應商，持續提供關鍵的製程設備，確保產線順利擴展。此外，隨著 OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly and Test, 封裝測試代工）廠商如日月光（ASE）和矽品（SPIL）擴建 CoWoS 或 2.5D 先進封裝產能，志聖也確保其設備能夠對應這些 OSAT 廠商的製程需求，確保台積電的 CoWoS 封裝擴張計畫能夠順利進行，並在供應鏈中維持高品質與高效能的封裝技術標準。

CoWoS 及 3D 堆疊等先進封裝技術，將在滿足當前與未來運算需求方面發揮關鍵作用，推動全球半導體行業向更高效、更整合的方向發展。隨著技術的進步與市場需求的增長，這些創新技術將帶來新的產業機會與挑戰。志聖工業作為 CoWoS 供應鏈的重要一環，透過高精度設備確保台積電及 OSAT 廠商的產線穩定擴張，並與台灣半導體生態系統共同迎接 AI 時代的挑戰與機遇。

印刷電路板：

2025 年 PCB 產業的前景與趨勢分析：

整體市場展望與成長預測：

市場研究機構 Prismark 預測，2025 年全球 PCB 產值預估年增 15.4%，隨著 AI 應用快速發展，伺服器需求顯著提升，帶動 PCB 產業進入新一輪成長周期。在 AI 伺服器的強勁需求下，已成為產業升級的重要推手 2024~2029 年 CAGR 上修至 8.2%，全球 PCB 產值將提升至 1,092.6 億美元。其中，HDI 與 IC 載板的年複合成長率 (CAGR) 分別達 11.2% 和 9.8%。

主要驅動 PCB 成長的因素：

- 雲端運算與主權 AI 需求強勁：

雲端資料中心資本支出雖趨謹慎，但整體產值持續上升，伺服器出貨量預計將有高個位數成長。GB200 預計於 2026 年進入放量期，加上雲端 CSP 業者自研 ASIC 需求火爆，將帶動上游原材料和 PCB 供應鏈產能滿載。主權算力需求亦快速提升，預計 2026 年將更上一層樓。AI 算力建設和終端換機加速是推動 PCB 市場發展的重要因素。伺服器及存儲器 PCB 的產值預計在 2024-2029 年的 CAGR 為 18.7%，增速快於其他 PCB 種類。

- 先進封裝技術發展：

後摩爾時代，先進封裝成為集成電路發展的關鍵路徑，帶動封裝基板的需求高增長。預計未來先進封裝有望以約 5% 的數量支撐超過 50% 的封裝市場規模。2024-2029 年全球封裝基板市場規模的 CAGR 有望達到 9.8%。ABF 基板因適用於線路較細、高腳數高傳輸的 IC，受益於 HPC 晶片需求，2025 年全球 ABF 基板市場規模佔封裝基板比重達 17%，亦將因 AI 雲端伺服器的規模擴大而持續成長。

- AI 終端需求：

AI 升級趨勢有望加速終端消費電子產品的換機週期，例如 AI 手機和 AI PC 對電性能和信號傳輸有更高要求，可能帶動 PCB 規格升級 (如 HDI 階數提高，HDI 升級至類載板，線寬線距精度提升)。

- 網通產業復甦：

隨著總經環境改善及規格升級，網通應用需求預計將在 2025 年全面復甦。AI 伺服器熱潮將帶動資料中心建置及更高的傳輸速率要求，進而推動光通訊產業的發展，利好網通 IC 業者和台灣供應商。

技術趨勢：

- 高階 HDI 板需求增加：

AI 計算與汽車三化驅動的高速數字信號傳輸均指向對 HDI 板的更高需求，也對 HDI 的性能提出更高要求。預計高階 HDI 的需求增量將更加顯著。Prismark 預計 2024-2029 年全球 HDI 板市場規模的 CAGR 為 11.2%。

- 軟板 (FPC) 應用擴展：

FPC 在新能源汽車的動力電池模組中大規模使用，且在 Mini-LED 照明和 XR 設備中亦有廣泛應用。

- 封裝基板朝更大尺寸發展：

隨著台積電 CoWoS 封裝持續變大以支援更大的 AI 晶片，對更大尺寸的封裝基板需求將會增加。

- 玻璃基板的潛力：

玻璃基板在成本和性能方面具備優勢，被視為下一代封裝基板，預計 2030 年前有望實現量產。英特爾等龍頭企業積極投入玻璃基板的研發與量產。

2026 年 PCB 產業預計將在雲端運算、AI、800G 高速傳輸、汽車智能化與電動化以及先進封裝等需求的驅動下持續成長。高階 HDI 板和軟板 (FPC) 的應用將更加廣泛，封裝基板的需求將持續強勁。此外，供應鏈去風險化 (脫鉤) 將為中國以外的供應商，特別是東南亞地區的供應商，提供重要的機會。台灣和中國大陸的 PCB 廠商有望在這一波趨勢中受益，但仍需關注市場競爭、原材料價格波動以及新技術發展帶來的挑戰。

(4) 競爭利基：

- A. 優勢品牌：創立 59 年之品牌，榮獲 2019 年第 16 屆台灣金根獎與第 5 屆卓越中堅企業獎、2023 年與 2025 年榮獲台積電優良供應商獎、2023 臻鼎優良供應商獎等殊榮。
- B. 核心技術 (五大核心技術)。
- C. 綿密的服務及銷售通路 (七大應用產業及超過 3,000 家客戶)。
- D. 高品質之設備。
- E. 優良之售後服務及維修能力。
- F. 高效率的研發設計能力。
- G. 高度彈性的製造能力。

(5) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

► 有利因素：

- A. 進口替代持續：本地半導體產業永續性為台積電企業社會責任的重要一環，積極輔導在地關鍵原物料供應商提升技術與品質，持續推動供應鏈在地化。
- B. 大陸市場持續內資化；志聖已深耕大陸市場多年，通路佈局完整。
- C. 志聖為知名 UV 光、壓合、貼膜、& 熱處理技術品牌，並持續延伸核心技術至 PCB 濕製程及 Plasma，構成堅強的商業策略基礎。
- D. 技術經驗及研發成果之累積傳承完整、有利生產效率與品管之提升。
- E. 通過 ISO 9001 評鑑，且關鍵技術多自行研發，品質保證與研發能力深受肯定。

- F. 志聖為上市公司，財務穩健，自 2019 年下半年起梯隊接班，持續年輕化。
- G. G2C+ 聯盟成立：One Stop Shopping 一站式，滿足客戶需求。

►不利因素及其因應對策：

A. 國內高科技生產設備製造業起步較晚，徵才留才易受高科技行業影響。

因應對策：

本公司致力從機械製造導向轉向於解決方案供應商的導向，將材料及製程整合於本公司產品平台上，大幅增加本公司提供給客戶的附加價值，由此進而產生對跨領域知識技術整合的迫切需求，透過產學合作引進人才，人員更需用心的帶領及耐心陪伴成長，如此而成的企業文化加上同仁共同創造的終身學習環境，將持續改變本公司的人力素質，以期能更貼近本公司像台積電等一流客戶的水平，才能持續與一流的客戶在世界一流的舞台上共同合作。

B. 由於機械設備業係下游產業延伸性需求，且產品生命週期長，通常於下游客戶設立、擴廠、製程改變、或產品層次提升時才有相關設備之需求，故客戶需求之變動較大。

因應對策：

- a. a. 配合市場變化及客戶個別需求，持續研發新技術及新產品，以開發多樣化及高附加價值之產品提升競爭力，進而誘發客戶新需求。
- b. b. 要求業務部門主動定期蒐集下游客戶所處產業之相關資訊，與 G2C+ 聯盟整合，並積極參與不同區域之展覽及研討會議，提高品牌專業形象，此外亦與國、內外關聯廠商保持良好關係，尋找合適共同合作對象。

C. 材料及匯率波動影響長交期的設備獲利。

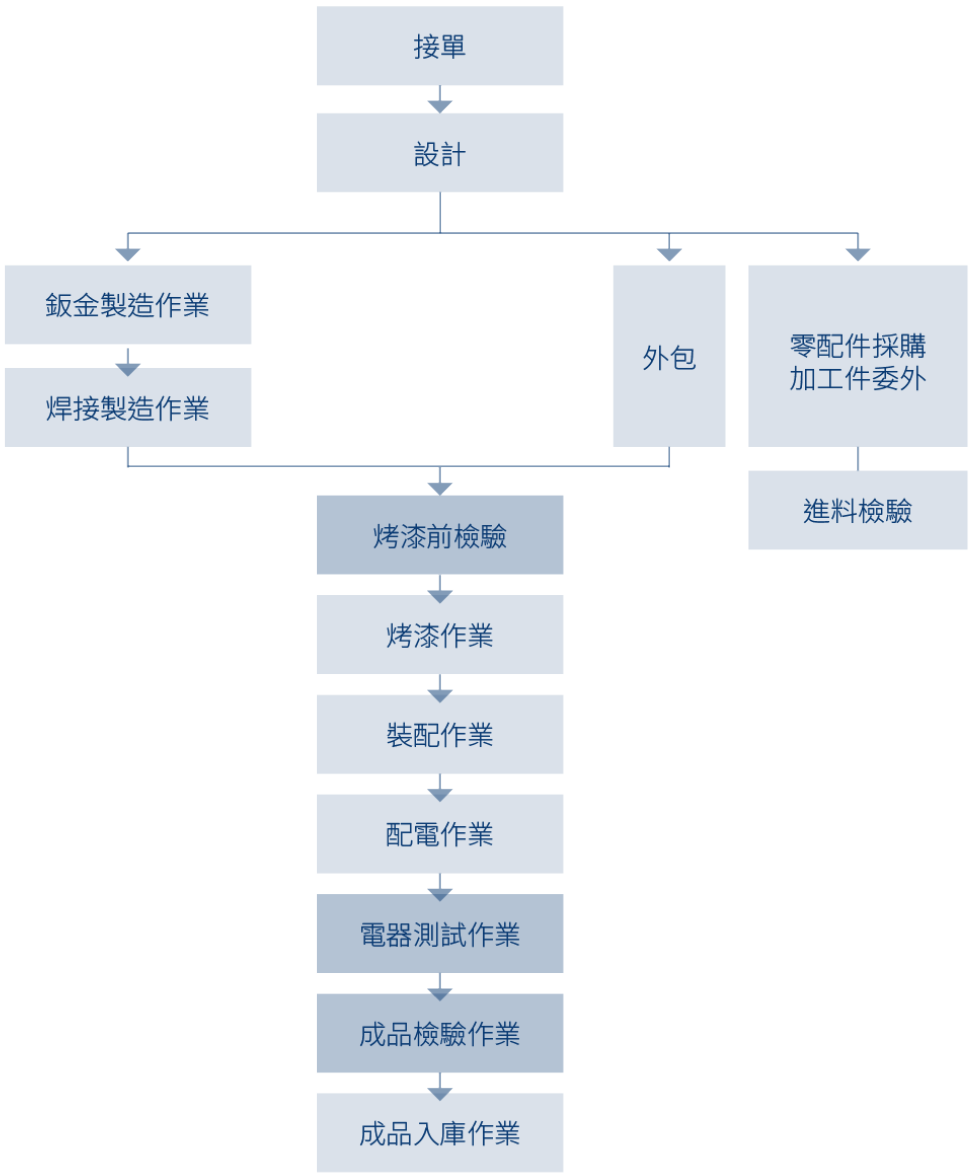
因應對策：匯率部份詳見風險管理內容詳本年報伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理之、六、風險管理及評估 (二) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施。

2. 主要產品重要用途及產製過程：

(1) 主要產品之重要用途：

產品類別	產品重要用途
熱製程設備	電子元件產業如半導體 /PCB/LCD/ 太陽光電 /LED/ 鏡頭 / 高頻元件及運動鞋、印刷塗裝業產品之烘烤、固化、乾燥、改質、純化、定向
UV 光製程設備	電子元件產業及運動鞋、印刷塗裝業產品、半導體封裝之乾燥、固化、影像轉移、清洗、定向
真空壓力烤箱	用於半導體封裝 underfill de void 製程、SMT de void 應用。
乾、溼膜製程設備	電子元件產業產品之上光阻、表面保護
載板壓膜機	適用於載板增層製程之 ABF/RCC & Solder mask 全自動真空壓膜、整平、精密整平需求，達到高填覆性及平坦度要求
載板剝膜機	適用於載板 ABF/RCC & Solder mask 壓膜 (曝光) 後之保護膜 (Mylar) 全自動雙面撕除，取代人工減少接觸、高穩定自動異常檢出
晶圓 Bonder	用於先進封裝製程將 Carrier 和 device wafer 作 bonding 後薄化製程或因製程需求需 transfer wafer 工作面使用

(2) 主要產品之產製過程：



3. 主要原料之供應狀況：

本公司產品主要原料零件為加熱器、尋邊機、Robot、氣壓元件、HEPA、滾珠螺桿、伺服馬達及溫控器等，取自國內外大廠如：Festo、柏堅、益民、合欣技研、近藤、興保、上銀、三菱及RKC等，由於長期配合，已建立彼此穩定之供應關係，貨源供應充足，其品質與交期均能維持一定的水準。

4. 最近二年度任一年度中曾佔進（銷）貨總額百分之十以上之客戶及供應商名稱：

(1) 最近二年度主要供應商資料：

單位：新台幣 / 仟元；%

項目	113 年				114 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 %	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 %	與發行人之關係
佔進貨總額 10% 以下之供應商	其他	2,824,794	100%	-	其他	4,482,281	100%	-
進貨淨額	-	2,824,794	100%	-	-	4,482,281	100%	-

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。
註 2：無佔進貨額 10% 以上之供應商。

(2) 最近二年度主要銷貨客戶資料：

項等目	113 年				114 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係
佔銷貨總額 10% 以上之客戶	甲公司	986,956	20%	-	甲公司	1,191,564	20%	-
佔銷貨總額 10% 以下之客戶	其他	3,831,253	80%	-	其他	4,910,591	80%	-
銷貨淨額	-	4,818,209	100%	-	-	6,102,155	100%	-

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。
註 2：最近二年度任一年度佔銷貨總額 10% 以上之客戶其銷貨金額增減變動原因：因應客戶年度擴線需求增加所致。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

(一) 從業員工結構：

115 年 2 月 28 日

年度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 2 月 28 日
員工 人數	職員	313	322	328
	技術員	674	738	737
	合計	987	1060	1065
平均年歲		37.32	37.37	37.37
平 均 服 務 年 資		9.09	8.96	9.11
學 歷 分 布 比 率	博士	4	4	4
	碩士	105	115	117
	大專	663	725	730
	高中	175	174	172
	高中以下	40	42	42

(二) 員工行為或倫理守則：

為提高工作環境及員工人身安全保護措施，本公司編制有員工工作規則手冊（計十二章節），針對紀律與守則、僱用與解僱、工資津貼與獎金、工作時間、休息休假、請假、退休、考勤、獎懲與考核、職業災害補償與撫卹、社會保險、福利措施與安全衛生、勞資溝通等進行規範。並另訂『獎懲管理辦法』作為員工獎懲之依據。

(三) 工作環境與人身安全健康的保護措施：

項目	內容
政策、承諾及重要性	志聖導入 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，遵守勞安衛要求持續改善工作環境、預防工安事件發生降低職災風險，藉由工作環境、人員組成及作業活動等之危害辨識評估，預防減少職場不法侵害，企業留任率提高；發生職安事故未良好處理，導致員工流失與媒體報導企業聲譽下降。
權責單位	職業安全衛生委員會
申訴機制	人資單位電話：886-2-26010706 申訴信箱：csunzskhr@csun.com.tw
短中長期目標	<u>短中期：</u> - 強化意外事故及虛驚事件管理，降低事故發生率。 - 培育各級人員在職業安全衛生管理系統上，均能接受安全衛生管理教育訓練，具備必須之安全衛生意識與建立危害預知能力。 5S 現場環境整頓，有效執行安全衛生管理規定確保工作環境安全與健康。 2025 年獲得新北市工安獎及台中幸福企業 3 星獎認證。<u>長期：</u> 2027 年失能傷害頻率 (FR) 0.22 。 - 降低化學品風險，精進化學品分級與危害預防管理。 - 促進身心平衡發展，營造健康友善職場。
行動計畫	- 以每月與特約醫護人員共同施行健康風險預測、風險管理及健康環境營造，關懷同仁健康。 - 北中南各區工程案，皆保持稽查制度，每月至少 1 次以上。 - 實踐環安衛政策：遵守法令要求、落實教育訓練、有效利用資源、防範意外事件、持續推動改善、全員諮詢參與。
2025 年績效	- 獲得 ISO45001/14001 認證系統。 - 定期每月一次執行職安衛稽核，2025 年共舉 287 次稽核；缺失 436 項，缺失改善率 100%。 2025 年辦理員工職業安全衛生訓練課程，總計舉辦 2 場，總受訓人次 203 人，總受訓時數 6 小時 (3 小時 / 場)。 - 廠區迄今未發生任何職業病案例。 2025 年職災案件計 7 件 (交通意外事故 3 件、工作意外 4 件)，影響職業災害人數為 7 人。 - 參與員工健康檢查服務的員工共計 393 人次，投入員工健康健康檢查金額達新臺幣 35 萬元；50 歲以上員工補助腸胃鏡檢查共計 11 人次，健康檢查金額 11.6 萬元。 2025 承攬商職安衛教育訓練總計舉行 8 場，共有承攬商計 111 人受訓、受訓時數達 5 小時 / 場。 - 廠區自 106 年 7 月 1 日起已完成 AED 自動體外心臟除顫器裝設，並委請廠商每年到廠實施 AED 操作教學訓練。 - 兩廠每月四次委請專業護理師駐廠實施 2 小時 / 次衛教輔導。

職業安全衛生管理系統

志聖依循 ISO45001：2018 職業安全衛生管理系統，訂有《環安衛管理手冊》、《環境作業管制程序書》與《職安衛自動檢查管理程序書》等作業辦法，適用範圍涵蓋台灣各廠區 (台北廠區、台中廠區) 之所有工作者 (員工、承攬商與訪客)，整體場域覆蓋率 100%。而為評估管理系統的有效性，志聖依據 ISO 45001 每年定期對各廠區進行內部稽核，2024 年已對各生產基地進行各一次的職業安全衛生外部稽核，並已取得 ISO45001：2028 第三方認證。志聖建立環安衛管理系統各項要求事項，以有效管理其對環安衛上造成之任何負面衝擊或不符合規定事項，並對整體環安衛績效進行持續改善。目前，公司所取得的 ISO 14001 與 ISO 45001 證書有效期限為 2023 年 12 月 23 日至 2026 年 12 月 22 日。

在未來三年中，我們將以「零工安事故」為目標，持續強化管理系統，努力提升公司整體安全管理水準，提升員工安全意識，優化工作環境，並與所有合作夥伴共同打造可持續發展的安全與健康職場。

為落實職業健康與安全各項計畫執行與推動，志聖各廠區設立職業安全衛生委員會，並依《職業安全衛生管理辦法法規》規定設置委員七人以上，其三分之一委員為職安衛勞工代表。委員會每三個月定期召開會議，會議主要討論上下班通勤同仁安全議題、封裝作業工作安全、防疫及健康安全等議題。一般員工亦可透過電話、電子郵件，向單位主管、職安衛勞工代表提出建議，以於委員會中進行討論；而相關職安衛法令與規範布達，全體員工可透過廠內海報、部門宣導等方式瞭解安全衛生資訊。

職業事故調查程序

為確保全體工作者之安全，志聖訂有《事故通報與調查管理程序書》，藉由完整的調查程序以使災害事故調查更有效率，確認事故發生原因和決定改善對策，藉以降低事故再發生之機率，此規範適用員工、承攬人以及公司、工廠內外所引起之災害事故。如作業同仁於工作場所發現危險情況，可自行停止作業並退避至安全場所，並得向上級呈報以採取適當之應變措施，並得免於遭受處分。

如有志聖之工作者發生職業災害，事故發現者應於災害事故發生後，應對傷患進行緊急救治，並進行災害事故現場處理，隨即通報行政單位，行政單位接獲通報後將隨即通報行政單位主管及廠區最高主管，公司將召集相關人員組成調查小組 (需包含勞工代表)，共同進行調查，並提出事故調查報告與防止再發生對策提出建議，做成會議紀錄，必要時透過「矯正處理管理程序書」督導事故單位進行改善。

志聖災害事故調查及矯正流程

事故單位於事故發生起三日內將「事故災害通報及調查表 (含虛驚事件)」送至行政單位。行政單位召集相關人員組成調查小組 (需包含勞工代表)，共同進行調查。事故單位擬定防止再發生對策與執行改善措施送至行政單位，並提出事故調查報告與防止再發生對策提出建議，做成會議紀錄。若預防再發生處理對策涉及廠內其他單位，行政單位得召集相關單位召開會議，做成會議記錄，並由行政單位追蹤防止再發生處理措施執行進度，必要時透過「環安矯正處理單」督導管理單位進行改善。

事故發生後適當的審查現有職業安全衛生風險及其他風險，必要時予以更新及修正。單位相關人員應負責追蹤改善措施之執行情況，並記錄查核結果，待改善措施完成後，將環安矯正處理單送交行政單位審核，經行政單位審核通過後，結案歸檔。

行政單位應每季彙整虛驚事件及事故調查分析等結果，於職安委員會會議中提報檢討，做為日後職業安全衛生管理系統持續改善之參考。

各相關單位及發生事故之單位對於事故調查結果得加以宣導或是納入職業安全教育訓練教材之中，以強化員工對於安全的認知。

A. 災害預防與應變提升

- 1. 設備檢查增加：自 2025 年起，新增廠區高壓電氣設備紅外線檢查，針對使用中之高壓電氣設備各線路以紅外檢檢視是否有過熱或破損情況，發掘潛在危機立即改善，避免危害發生。
- 2. 案例宣導：為增強員工風險意識，透過月會分享實際案例，由當事人講解經驗以加深印象。

志聖公司將持續以系統化管理及創新手段，深化環安衛管理成效，致力於打造安全、健康、永續的工作環境，實現零工安事故的目標。

B. 公安查核及設備安全管理

志聖落實廠區環境監測及相關定期安檢作業，由總經理擔任總召集人，定期執行相關程序：

- 1. 勞工作業環境檢測
為保障勞工免於作業場所中有害物的危害，提供勞工健康舒適的工作環境，每年定期執行作業環境監測，了解現場同仁工作環境態樣。
- 2. 工安查核
各項查核報告由行政單位依每年規劃查核作業執行，並將改善建議及具體改善情形提供予廠區各單位參考，同時每月根據查核改善事項於例行廠區會議檢討缺失。
- 3. 設備安全管理
本公司對於危險性機械及設備均有列管，並定期進行詳盡檢查，確保設備能安全操作，無安全疑慮。

項目	頻率
滅火器設備自檢	每月定期檢查
高低壓電氣設備	
客貨梯檢查	
環境品質檢測	
廠區消毒	每半年
緊急應變演練 (含消防演習)	
緊急發電機	
天車保養	每年巡檢
電力大檢	
消防設備檢查	

職安衛教育訓練

為確保全體員工瞭解職業安全衛生法規，並熟知公司安全衛生管理機制，志聖依法規及職務需求，提供員工安全衛生教育訓練，包含：一般安全衛生教育訓練、職安衛人員複訓、衛生教育宣導與訓練、防火自衛編組演練、承攬商入場暨安全衛生教育訓練、新進人員職業安全衛生教育訓練。

2025 年職安教育訓練一覽

課程類別	A 受訓時數	B 受訓人次	C 舉行場次	總訓練時數 (A*B*C)
一般安全衛生教育訓練	3	203	2	1218
甲種業務主管	6	1	1	6
職業安全衛生乙員複訓	12	12	12	12
急救人員複訓	6	3	1	18
有機溶劑作業主管複訓	6	1	1	6
防火自衛編組演練	4	245	4	3,920
承攬商入場暨安全衛生教育訓練	1.5	111	8	1,332
新進人員職業安全衛生教育訓練	3	23	2	138
總計	41.5	589	21	6,686

職業健康服務與促進活動

志聖致力於打造一個安全舒適的工作環境，全方位照護員工健康、並根據工作者的健康狀況調整工作以適應工作者的能力，志聖持續推動多項健康服務與促進方案，例如：每年至少辦理一次以上的全體員工健康檢查、加碼補助員工健康檢查項目、補助同仁參與地方辦理之運動賽事...等，讓員工身、心、靈都能獲得完善的照護，進而提升員工認同感與向心力，持續為志聖站穩業界領先之地位。

項目	內容說明	2025 年績效
員工健康檢查	志聖重視員工身心健康，安排醫療院所每年進行全體同仁健檢，並加碼補助員工健康檢查項目，以完善的檢查項目讓員工了解自身健康狀況，做好自我照護或及時就醫。	2025 年共 393 人完成健檢，占總員工人數約 100 %。
運動認證推廣活動	為維護同仁健康，志聖特舉辦運動認證推廣「健康生活動起來」活動，活動項目包含「降低體脂肪」、「健康向前走」及「健康跑起來」三階段，致力於養成同仁運動習慣。鼓勵同仁進行健步步數達平均每日 8 千步，藉活動預期達成減重目的，減低三高風險。	2025 年 237 位同仁參與運動認證推廣活動。
參與運動賽事補助	為提倡企業內良好運動風氣，志聖補助同仁參與地方辦理之運動賽事，如林口竹林山寺祈福路跑活動、台中舒跑盃。	2025 年共補 388 位同仁參與運動賽事
護理師每月入廠服務	為照護同仁的健康，志聖安排護理師每月入廠 8 小時，提供同仁護理諮詢服務。	2025 年護理師駐廠，兩廠總時數共 240 小時。
醫師每季入廠服務	志聖為照護同仁的健康，醫師每季入廠 2 小時，提供同仁醫療上的專業諮詢服務。	2025 年醫師駐廠，兩廠總時數共 20 小時。
護理健康講座	護理師每季舉辦健康講座鼓勵同仁參加吸收相關知識	2025 年共進行了 2 場護理健康講座。

職災 (職業傷害與職業病) 與火災統計及相關改善措施：

A. 職災統計及改善措施

為了確保職業安全與衛生管理措施的有效性，志聖公司採用了職業傷害和職業病的統計數據作為重要的指標，來評估管理績效和追蹤問題根源。志聖工業 2025 年度發生職業災害人數為 7 位，職業災害比例註為 6.99%，未有嚴重的職業災害事故、失能傷害事件或因職業災害死亡之事件發生。針對這些已經辨識出的問題，志聖公司迅速制定了相應的管理措施，這些措施包括加強交通安全和行進過程中的安全宣導，以確保員工在上下班途中和出差過程中的安全。展望未來，志聖公司將持續完善與職業傷病相關的配套措施，並做到定期檢討和動態優化。同時，公司也將加強與員工的溝通，聽取他們的意見和建議，確保每一個人的聲音都能被聽到和尊重。通過這些努力，志聖公司致力於維持一個零職災的安全工作環境，讓每一位員工都能安心工作，健康回家。

註：職業災害比例為可記錄職災人數除以年底總員工數。

2025 年職業傷病數據					
可記錄職業傷害數 ^{註1}	可記錄職業傷害比率 ^{註2}	嚴重的職業傷害數及比率	職業傷害所造成的死亡數及比率	職業病數	失能傷害頻率 (FR) ^{註3}
7	6.99	0	0	0	0

註 1：2025 年之職業傷害為 4 件工安、2 件交通事件。
註 2：可記錄職業傷害比率 = 可記錄職業傷害人數 ×1,000,000/ 總經歷工時。2025 年之總經歷工時為 1,000,206 小時。
註 3：FR= 失能傷害人次數 ×1,000,000/ 總經歷工時。失能傷害的總人次數計算為：包含死亡、永久全失能、永久部分失能及暫時全失能之總計人次數。2025 年之總經歷工時為 1,000,206 小時。

B. 事故統計與改善措施

- 1. 傷害事件：2025 年共發生 7 起失能傷害事件 (3 起通勤交通意外、4 起工作意外)，總傷害指數為 3.2。
- 2. 重大事故：全年未發生重大工安事故，但公司將持續透過安全教育與風險評估提升員工自我保護意識。

C. 火災統計及改善措施

當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率

火災件數	死傷人數	佔員工總人數比率
0	0	0

為達成環境與職業安全衛生 (環安衛) 績效目標，並符合法規與公司環安衛政策要求，公司建立並推行環安衛管理系統，參考 ISO 14001:2015 環境管理系統與 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統的架構與原則。

在實際運作中，將此系統與公司既有的減廢、污染預防及預防傷害與疾病風險等措施相結合，整合至整體管理流程中，確保系統的實效性。公司成立環安委員會，由總經理擔任總召集人，各部門主管分組負責，勞安室統籌廠區行政課稽核事宜，並每季於職安委員會檢討改善稽核缺失。

四、環保支出資訊

- 1. 說明最近年度及截至年報刊印日止公司因污染環境所受損失 (包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策 (包括改善措施) 及可能之支出 (包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無。
- 2. 因應對策：本公司製造過程並不會對環境造成污染，估計未來不會有環境污染情形。

五、勞資關係：

1. 公司員工福利措施、進修、訓練、退休制度與實施情形及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

(1) 員工福利措施

- 依據職工福利金條例成立職工福利委員會，提供職工福利金辦理各項福利事項，如：婚喪、年節禮品、生育、住院、重大災害等補助，並舉辦員工旅遊活動。
- 依照公司營運目標發放季績效獎金及年終獎金，本公司導入績效獎金制度，衡量每季 EPS 及各項關鍵指標，讓員工共享成果，有效激勵同仁。
- 依規定提撥勞工退休準備金，並成立勞工退休準備金監督委員會，以便管理勞工退休準備金各項事宜。
- 本公司亦按政府相關法令投保勞工及全民健康保險，更為了員工安全著想，為員工加保團體保險以保障員工，提供員工更多福利。
- 實施員工分紅入股、庫藏股、認股權證制度：
 - a. 入股：本公司辦理現金增資時，依法保留 10% ~ 15% 由員工認股。
 - b. 分紅：依公司章程第三十一條規定辦理。本公司年度如有獲利，應提撥 1%~9% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；且前述員工酬勞中以不低於 45% 提撥為分派予基層員工之酬勞。
- 本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不超過 2.25% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。
- 勞保、健保、團保、人身意外保險
- 勞工退休金提撥
- 職業災害補償及撫卹
- 退職酬勞金
- 員工在職進修補助
- 結婚、生育、喪葬、交通費、行動電話、伙食津貼
- 職災或重大災害補助及貸款
- 國內外團體旅遊

- 節慶活動及致贈慰勞禮品
- 子女獎助學金
- 遠道同仁提供宿舍
- 圖書館及好書共賞
- 咖啡免費品嚐
- 健康檢查

(2) 進修及教育訓練：

- A. 本公司 2025 年度全公司員工實際訓練工時為 32,508 小時，訓練費支出為 3,211 仟元。
- B. 針對同仁之需求及配合政府法令規定，舉辦新進人員訓練、專業技術訓練、品質管制訓練、員工成長相關訓練及勞工安全衛生等各類教育訓練，提供員工完整的專業技能養成及自我成長。
- C. 本公司為提高人力素質，增進員工工作知識、技能，得依員工本身之條件及工作之需要配合實施下列有關之訓練：
- a. 安全衛生教育及預防災害之訓練。
 - b. 職前訓練：新進人員進入本公司必須接受「一般性職前訓練」及該職務之「專業性訓練」。
 - c. 在職訓練：依據員工執行職務所須之各項專業職能，規劃一系列訓練課程。
 - d. 其他專長訓練。

本公司員工訓練之實施方式如下：

- a. 內訓部份：集中公司內或其他地點訓練，由內部講師或聘任國內外專業講師講授課程。
- b. 外訓部份：派送國內外專業訓練機構受訓。

(3) 退休制度與實施情形：

本公司依勞工退休金條例之勞退新制，本公司員工每月按薪資總額提撥 6% 退休金並存入勞保局所設立之員工退休金個人專戶內。

公司員工有下列情形之一者，得自請退休：

- 1. 在公司工作滿十五年以上 (含)，且年滿五十五歲以上者。
- 2. 在公司工作滿十年以上 (含)，且年滿六十歲者。
- 3. 在公司工作滿二十五年以上者。
- 4. 在公司工作滿十五年以上 (含)，且經勞資雙方協商同意者。
- 5. 在公司工作年資，併計關係企業『志勝儀器股份有限公司』之服務年資。

退休金制度	舊制	新制
適用法源	勞動基準法	勞工退休金條例
提撥方式	• 目前現況：本公司已提足額，目前每年固定申請暫停； • 正常提撥：按員工每月薪資總額 2% 提撥，以本公司名義存入台灣銀行 (原中央信託局) 之專戶；	依員工投保等級提撥 6% 至勞工保險局個人專戶；
提撥金額	截至累計至當年度提撥金額為 NT\$172,706 仟元	當年度提撥 NT\$ \$16,842 仟元

(4) 勞資間之協議與簽訂團體協約情形：

無；本公司雖有成立企業工會，惟因工會迄今未曾向公司提出團體協約之協商要求，爰並未簽訂團體協約。

(5) 形塑友善育兒環境措施：

項目	內容
彈性工作時間	允許員工特案申請彈性上下班工作時間，以更好地配合他們的育兒需求。
家庭支援服務	提供特約托兒所資訊，以幫助員工多方的選擇。
生育獎勵津貼	在特定的年資下，公司提供生育獎勵津貼，用於支付員工的育兒費用。(年資滿 3 年，生第二胎 15 萬、第三胎 (含) 以上 30 萬。)

育嬰假

為鼓勵並支持員工安心培育下一代，志聖讓員工享有育嬰留職停薪的權利。公司依據勞基法之規定，協助同仁依循《性別工作平等法》及《育嬰留職停薪實施辦法》辦理育嬰留職停薪。

志聖重視性別平等，除提供育嬰留停，志聖也為同仁提供產後育嬰之保障。志聖為女性員工設置哺集乳室，營造舒適的工作環境，讓志聖同仁在工作同時也能兼顧家庭。

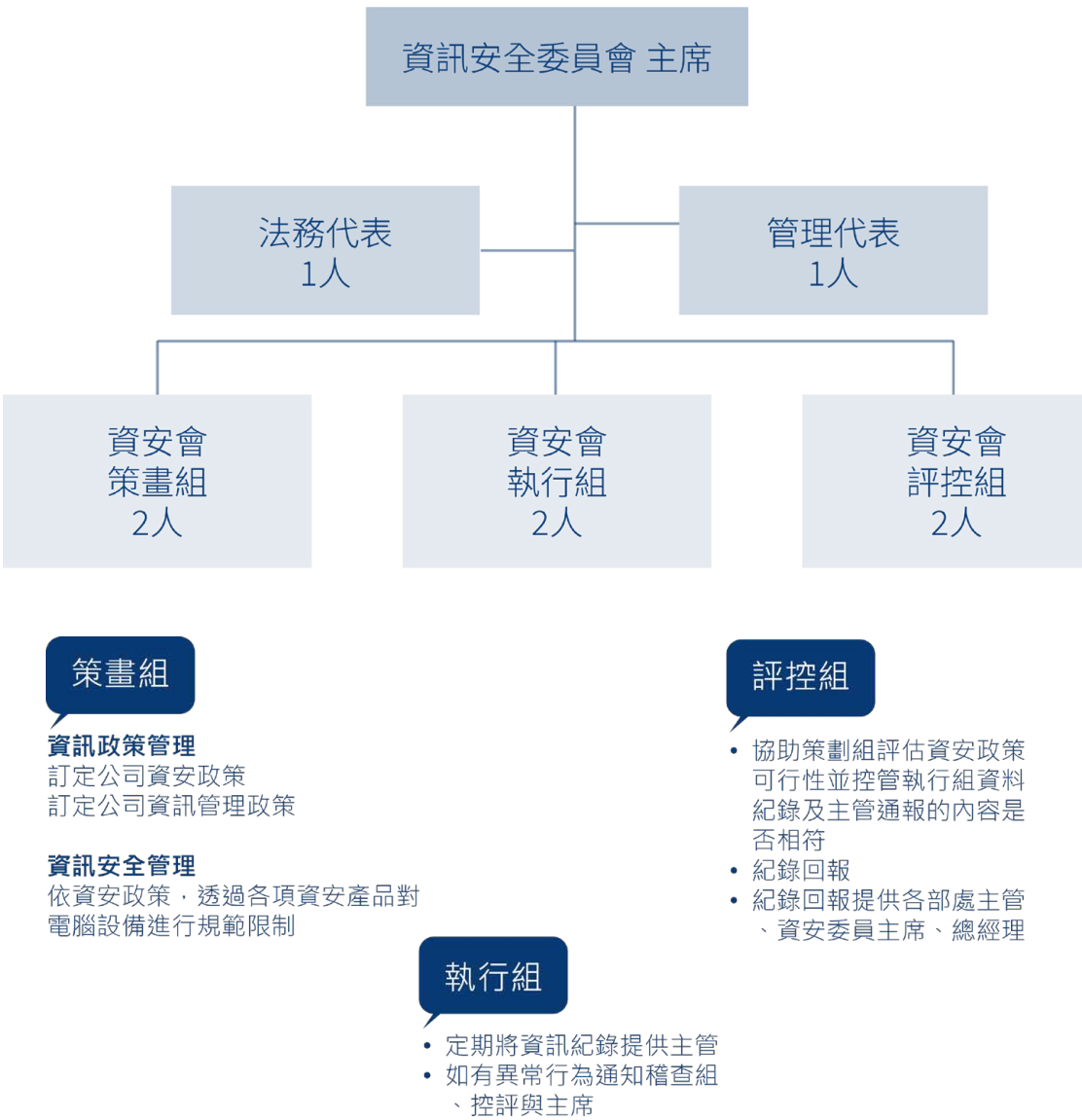
2. 最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司勞資關係和諧，並未發生勞資糾紛。本公司對員工之福利非常重視，隨時注重主、客觀環境之變動，訂定各項福利措施，以滿足員工之需求。

六、資通安全管理：

1. 資通安全風險管理架構

志聖工業以董事會為風險管理的最高決策單位，為提升公司治理與風險控管能力，於 2025 年 11 月將「永續經營委員會」與「風險管理委員會」整合為「永續發展暨風險管理委員會」，負責審視重大風險管理議題之預警與因應措施，並定期向董事會報告風險管理執行情形。在專責資訊安全組織方面，公司設立「資訊安全委員會」，如下圖：



資安治理流程由資訊單位發起，經資安會策劃組、各部處會簽、管理代表、資安會主席及總經理審核後，交由文管中心備查，以落實 PDCA 持續改善與精進管理制。

資訊安全委員會透過每年管理審查會議，審核資安風險分析結果及採取對應的防護措施與方策，確保資訊安全管理體系持續運作的適用性、適切性及有效性並每年向董事會彙報資安管理成效及資安策略方向。

2. 資通安全政策

本公司資安政策旨在保護數據、資訊、設備、人員及網路等關鍵資訊資產，確保其機密性、完整性與可用性，以減少營運風險並維護公司商譽。公司秉持「資訊安全，人人有責」的宣言，致力確保處理客戶和同仁資料的安全，並提供安全、穩定及高效的資訊服務，以維護市場競爭力及保障合作夥伴之利益。

「計劃階段」著重資安風險管理，為了強化資訊安全，志聖工業自民國一百一十四年導入 ISO 27001 資訊安全管理系統，經第三方環澳國際驗證公司驗證通過，取得 ISMS 國際驗證證書（有效期限 2025/06/30~2028/06/29），建立涵蓋風險評估、治理及持續改善的制度化流程。同時，核心產品通過 SEMI E187 國際標準查證，確保設備資料完整性與製程安全，符合高科技製造業供應鏈之資安要求。

相關認證訊息詳公司網站：<https://www.csun.com.tw/relevant-certifications/>

- 「執行階段」持續導入新資安風險控管技術，加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心分享情資，並建立資安運營中心，整合安全資訊事件管理與監控工具，即時掌握資安事件。
- 「查核階段」定期監控資安管理指標成效，及上述管理系統每年第三方複審稽核，另委由資安廠商進行滲透測試，以確保持續提升資安管理及防禦能力。
- 「行動階段」檢討與持續改善，當員工及承商違反資安相關規範及程序時，依據規定進行懲處，並持續進行全員資安教育訓練以提升資安意識。

3. 具體管理方案

為達資安政策與目標，建立全面性的資安防護，推行的管理事項及具體管理方案如下：

資訊資產與權限管理：執行各單位資訊資產清點與風險評鑑作業，並實施資安權限分級授權管理。針對內部資訊流通，透過資訊部門自建之內部伺服器搭配定期防毒軟體進行監控；外部資訊流通則透過加密軟體保障資料安全性，確保情報不落地。

多層次資安防護與維護機制：於公司電腦全面部署防毒軟體、核心系統與人員部屬端點偵測與回應機制，實施內、外部流量監控及外部郵件過濾機制，並建置應用程式防火牆與網路防火牆，以阻擋潛在威脅。IT 部門亦貫徹執行資安事件通報及協助應變處置作業。

災害復原演練與滲透測試：除日常監控外，公司定期執行資訊系統緊急應變計畫演練，並於 2025 年執行滲透測試，以驗證防護機制的有效性並即時修補潛在漏洞。

教育訓練：進行全員資安教育訓練與不定期社交工程釣魚郵件測試，以提升資安意識，使資安的運作在高階主管與各部門的支持下，落實到每一位員工身上。

4. 投入資通安全管理之資源

本公司深知資訊安全對永續營運的重要性，持續投入具體資源以強化系統防護力與員工資安意識：

- 專責人力：設有專職之「資訊安全委員會」，負責公司資訊安全規劃、技術導入與相關的稽核事項，以維護及持續強化資訊安全。
- 系統建置與經費投入：本公司投入新台幣 450 萬元經費，用於各項資安硬軟體建置與升級。具體項目包含：導入資安防護軟體、防毒軟體、內外部流量監控軟體、機房設備生命週期終止汰換升級以及新型自動化網路控管技術。
- 客戶滿意：無重大資安事件，無違反客戶資料遺失之投訴案件，完成客戶資訊安全評鑑，提升客戶信任。
- 教育訓練：所有新進員工到職前皆完成資訊安全教育訓練課程；全體員工皆完成兩次線上資訊安全教育訓練及考核。
- 月會宣導：每月於公司內部月會進行資安宣導，並透過內部入口網站與郵件公告近期資安新聞與異常事件，加深員工對資安的重視。2025 年共計舉行 12 次月會資安宣導。

5. 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司透過持續精進資訊安全管理機制與多層次防禦建置，最近年度及截至年報刊印日止，未發生因重大資通安全事件而遭受損失或對營運造成重大影響之情事。

七、智慧財產管理計畫

智慧財產權為企業重要的無形資產，因此本公司相當重視智慧財產權。藉由智慧財產管理制度，來創造公司價值的運作模式，提高企業競爭力，保護公司營運成果，強化競爭優勢，促進產業不斷精進。

本公司新制定之智慧財產手冊係根據 PDCA 循環模式，建立內部稽核與管理審查程序，以確保繼續有效與持續改善之目的。

- 針對本公司研發成果與智財目標提出六大方向進行：
- 1. 落實智財策略
 - 2. 保持競爭優勢
 - 3. 推動智財知識
 - 4. 發展產品技術
 - 5. 鼓勵創新提案
 - 6. 增進保密意識

更針對各類智慧財產權進行保護措施：

- 1. 專利保護措施

本公司在導入 ISO9001 之初，便在 2011 年制定「專利管理作業規範」，並經核准後公告實施；

該作業規範主要包括專利風險盤查、專利情報檢索、專利提案制度及專利權評估維持，本公司設立專責部門評估與執行各項專利相關事務。

本公司持續為新產品不斷開發與不斷改良，為客戶提供業界最佳設備，與成為客戶最信任的夥伴。本公司透過智財教育訓練，來增強同仁的智財意識，更鼓勵同仁創意發想、激勵員工提出專利申請，更於專利提案核准時與取得專利權時，分別提供獎勵金給申請人或申請團隊。

本公司設立一套完整且周全的專利提案與專利管理制度，保障公司及同仁研發結晶；另與第三方專利事務所及專利主管機關進行密切聯繫與技術交流，參與相關研討會及訓練課程，以保持與國家政策接軌。

2. 商標保護措施

本公司為加強企業識別度，於 2018 年時以全新的商標登場，代表公司形象的新氣象，於 2021 年制定「智慧財產手冊」與「商標管理辦法」；商標管理政策主要包括商標檢索、商標提案及商標權評估維護，本公司法務評估並執行各項商標相關事務；並申請 2022 年度台灣智慧財產管理系統 (TIPS) 再驗證，經審查後通過，其有效期間 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。不但深化本公司商標制度，更意味著本公司宣示要落實智慧財產權管理制度的決心。

3. 營業秘密保護

本公司為產業先驅領導者，深耕市場逾五十餘載，深知營業秘密保護乃產業領導者務必執行之業務，本公司設有檔案加密及資訊分權管理，避免資訊不當流通導致公司利益受損。此外，公司對於新人及同仁定期辦理資安政策及營業秘密保護授課，將保密義務與概念深植每位員工。藉由公司全體同仁的守護，防堵智財事務與機密資料洩漏風險，更凝聚企業向心力，進一步提升本公司核心競爭力。

風險與機會

應對智財機會時，專責部門會同相關部門共同召開可行性方案會議，使本公司能快速因應市場需求與變化；當遇智財風險時，由專責部門召集「爭議處理機制小組」，快速應對遭遇的智財風險，將本公司遇到的風險降到最低。

執行情形

本公司已將智慧財產相關議案提報於第 19 屆第 6 次 (114 年 11 月 7 日) 董事會。

本公司在智慧財產權的建置上非常重視，擁有專人專責處理本公司智慧財產項目，並規劃本公司的智慧財產展望，近年本公司主要落實情況說明：

年份	落實情況說明
2025	智慧財產權手冊與商標管理辦法修訂 & 增訂 TIPS(台灣智慧財產管理制度) 維持驗證，已通過開設智慧財產教育訓練課程 1. TIPS 相關管理規則 2. 專利基本觀念介紹

- 每季定期召開新人訓練，包含公司資安政策及營業秘密保護。
- 每年由法務單位邀請外部法律 / 專利事務所錄製課程，或者親臨進行智慧財產權授課。
- 2025 年錄製 2 堂智慧財產教育訓練課程。
- 每年的下半季將智慧財產權相關事項提報至董事會。
- 每年固定產出數件專利申請。近 7 年專利申請

年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
件數	16	24	28	20	17	32	20

- 截至 2025 年底，本公司以 C SUN 志聖 (如下圖) 為主要識別商標，該商標已註冊於台灣與中國大陸市場。
- 已於 2024 年度申請志聖泰國子公司商標：



取得驗證

本公司近年度通過台灣智慧財產管理系統 (TIPS) 驗證情形，如下表：

通過驗證日期	證書有效期間
2022/12/30	2023/1/1~2024/12/31
2024/12/31	2025/1/1~2026/12/31

八、社會責任：

志聖自 1966 年成立以來，致力於成為世界級的半導體、電路板、平面顯示器、觸摸屏、印刷塗裝等產業設備領導廠商，透過「永續發展暨風險管理委員會」，追求員工、股東、客戶、供應商等關係利益人最大權益，善盡企業公民責任，達到企業永續。

1. 員工人權保障

志聖為善盡企業社會責任、保障全體同仁及利害關係人基本人權、杜絕任何侵犯及違反人權的行為，也遵守國內外之勞動、性別平等工作法相關法規並制定有關人權保障、勞動政策及執行相關措施。志聖遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等國際公認之人權標準訂定志聖公司人權政策，本政策適用於本公司全體員工，以保障員工之權益，志聖以董事會為最高層級的人權治理架構，由「永續發展暨風險管理委員會」下之永續發展小組成立跨部門之人權工作小組，並依法召開勞資會議，除提供員工多元溝通管道讓員工與管理階層間能夠公開直接進行溝通討論，同時宣導公司政策、福利措施及各項活動，使員工能意見得以充分表達，並適時給予回應和協助。並於不定期新人教育訓練及每月全公司月會進行人權政策宣導。

(1) 2025 年實績

- 健康安全職場：志聖於 2025 年召開 4 次職業安全衛委員會，檢討和改善員工的健康與安全風險，目標是建設零職災工作環境。
- 員工自主性社團：尊重員工自由結社，並設立愛心社、羽球社、瑜珈社等社團，為員工提供多元學習機會。
- 勞資協商：2025 年，北中廠區共舉行 6 次勞資會議，加強員工與管理層的有效溝通，並宣導公司政策、福利及活動。
- 多元包容與平等機會：志聖致力於提供性別平等和多元化工作環境，並強調公平僱用、薪酬及升遷機制，加入友善家庭職場企業聯盟，打造友善家職場， 將家庭教育帶入職場，以多元議題講座，方便員工在職場就近學習，兼顧員工在工作與家庭的需要，協助員工平衡工作與家庭生活。
- 不雇用童工：公司 2025 年未僱用童工，並遵守當地法律，反對任何形式的童工雇用。
- 母性照護：調整工作量與工作內容，減少孕期負擔，安排特約護理師定期關懷並鼓勵員工主動諮詢。
- 符合基本薪資與合理工時：2025 年，公司全體員工的薪資均高於勞基法所訂的薪酬標準，並提供合理的工時。

(2) 2025 年員工數據

員工總數：436 人，其中正職員工占 94%。

性別比例：男性占 77%，女性占 23%。

年齡分布：31 至 50 歲的員工占比 59.2%，30 歲以下占比 21.1%，50 歲以上占比 19.7%。

多元化員工：2025 年，志聖共有 4 位身心障礙員工、1 位原住民員工、7 外籍員工，平均服務年資為 2 年以上。

2. 人才吸引與留任

志聖以維護舒適便利的工作環境及能滿足員工兼顧家庭、工作生活平衡為理念，提供各項福利活動、完善且優於法規的保險制度 (包含壽險、傷害及意外保險、醫療保險、職災給付保險等) 及育兒服務給予同仁，依據職工福利金條例成立職工福利委員會，為員工制定更周全完善的福利措施，重視每一位志聖的家庭成員。以職工福利金辦理各項福利事項，如：婚喪、年節禮品、生育、住院、重大災害等補助，並舉辦員工旅遊活動。

(1) 志聖 2025 年度員工福利項目實績

項目	福利內容	2025 年 實際使用人 次數	投入金額 (新台幣元)
員工暨子女在學獎學金補助	員工或子女成績具優良表現者，依學制給予補助 500-2500 元不等之獎學金。	326	363,500
結婚補助	員工本人結婚時可申請 (8,000 元)。	2	16,000
生育補助	員工本人或其配偶生育時可申請 (每胎 3,600 元，第三胎含以上 7,200 元)	6	21,400
喪葬補助	員工本人、父母、配偶或子女死亡時，可提出申請 (本人 3 萬，其他 15,000)	10	150,000
傷病慰問補助	員工本人住院，購 800 元之禮品。	4	3,200
傷殘慰問補助	員工本人因公務而致傷殘者，補助金額 1,000-5,000 元。	0	0
急難救助補助	員工受意外重大損失，補助金額最高 30,000 元	0	0
生日禮券	員工生日給予 1,200 元禮券。	443	531,600
生育獎勵津貼	年資滿 3 年，生第二胎 15 萬、第三胎 (含) 以上 30 萬。	4	610,000
員工旅遊	員工國外旅遊，補助 17,500~35,000 元。	108	1,522,500

(2) 志聖友善育兒措施

為鼓勵並支持員工安心培育下一代，志聖讓員工享有育嬰留職停薪的權利。

公司依據勞基法之規定，協助同仁依循《性別工作平等法》及《育嬰留職停薪實施辦法》辦理育嬰留職停薪。

- 志聖重視性別平等，除提供育嬰留停，志聖也為同仁提供產後育嬰之保障。
- 志聖為女性員工設置哺乳室，營造舒適的工作環境，讓志聖同仁在工作同時也能兼顧家庭。
- 彈性工作時間：允許員工特案申請彈性上下班工作時間，以更好地配合他們的育兒需求。
- 家庭支援服務：提供特約托兒所資訊，以幫助員工多方的選擇。

- 生育獎勵津貼：在特定的年資下，公司提供生育獎勵津貼，用於支付員工的育兒費用。(年資滿 3 年，生第二胎 15 萬、第三胎 (含) 以上 30 萬。)

人才培育與發展

我們相信人才就是公司最重要的資產，公司致力於打造每一個同仁發揮的舞台，並與同仁本人共同規畫成長的職涯路徑。

(1) 我們的政策與承諾

- 雙軌晉升制度：提供專業職與管理職雙軌晉升制度，並提供相關培訓與進修補助。
- 訓練經費支持：公司提供專業培訓及發展計畫經費，提升員工專業能力。
- 高階主管進修：公司提供 EMBA 等進修補助，幫助高階主管提升管理視野。

(2) 我們的目標與績效

- 短中期目標：每年培訓 30% 員工，提升 80% 員工滿意度，每年至少培育 10 位中層管理人才，舉辦至少 2 場大型培訓活動。
- 長期目標：每年至少 50% 員工由內部晉升。
- 2025 年績效：總訓練時數 20,769 小時，100% 職位由內部員工晉升。平均訓練時數 44.28 小時，總計 469 名員工參與。

(3) 2024 年訓練與發展統計

- 訓練時數：男性平均訓練時數 37.50 小時，女性 67.70 小時。三年來訓練時數逐年增加。
- 主要培訓項目：新人訓練、主管培訓、專案管理及壓力紓解課程等。

社會參與

志聖多年來秉持著「取之社會，用之社會」飲水思源的感恩心，定期回饋社會團體及學界，贊助的團體包括了新北市幸福天使促進協會、愛無國界關懷協會、向上基金會院等，除了弱勢捐助之外，我們進一步深化「在地服務」核心價值，將觸角延伸至地方鄰里與社區文化發展，如捐助新北市竹林山觀音寺與台北市艋舺龍山寺等在地公益法人，志聖不僅實踐了對宗教人文的關懷，更將資源投入社區公益服務與急難救助，成為守護地方成長的安定力量。

對產業人才培育我們也不遺餘力，多年來持續與台灣大學、清華大學、逢甲大學、明志科大、中興大學等大學合作，包含「建教與實習合作」、「學術研究合作」、「獎助學金」以及「校園巡迴講座」四大面向，以培育產業優秀人才為己任，同時公司高階主管擔任各大學講師，發揮業師精神，傳承產業經驗，縮小學用落差。

我們關心品格教育，贊助桃園中平國小棒球隊，把關運動少年的學習環境與資源，鼓勵台灣青年邁向國際，孕育未來國際賽場上的明日之星；此外，企業內部亦以行動支持文藝活動，推廣志工文化，提供公司全體同仁參與社會公益活動各項資訊與管道，培養同仁感恩、互助的優質企業文

化。

2025 年我們的投入實績：

(1) 在地共好，參與公協會與民間組織之社會活動

- 贊助中華本土社會科學會舉辦之「台灣應具的社會文化特質」公益座談，支持本土學術界探討台灣社會核心文化價值。
- 贊助中華民國自動化科技學會舉辦之「自動化科技國際研討會」，促進產、官、學、研各界的創新成果交流。
- 支持中華民國菩薩協會之公益活動與同仁身心關懷，於「乙巳安歲」及「盂蘭盆報恩」等重要時節，透過祈福火供儀式為全體同仁與眷屬祈求平安。
- 支持中華慧炬佛學會，推展正向思維與佛學人文素養。
- 捐助台灣自製衛星技術開發教育推廣協會，推動航太科普教育，激發在地學子對航太科學與系統工程的興趣。
- 長期支持台北西區扶輪社，鼓勵並培養擴展服務之機會，在各種事業及專業中提高道德之標準；認識一切有益於社會的職業之價值。
- 長期支持財團法人電路板環境公益基金會，以及台灣電路板協會之減碳綠活益起行贊助活動，透過產業公協會共同推動環境公益。
- 秉持鄰里共好精神，長期支持新北市幸福天使促進協會，投入在地脆弱家庭孩童的關懷與助學計畫。
- 支持社團法人大都會國際兒童協會兒少關懷計畫，協助脆弱家庭之學子獲得穩定的心理支持與學習資源。
- 持續參與 ESG 世界公民數位治理基金會，以「普世善念共傳吟 世界公民共齊行」為精神，推動世界公民理念、學童素養教育，加強台灣人對世界公民的認同感，進而達到各國共好、世界共好。
- 與愛無國界關懷協會攜手認養西非霖恩國小 6 名學童，每年捐贈援助金 36,000 元。

(2) 支持醫療關懷，打造更好的衛教環境

- 感佩天主教若瑟醫療財團法人「全犧牲、真愛人、常喜樂」精神，透過捐助行動支持其長年深耕雲林地區的醫療服務。
- 關懷高齡化社會之健康需求，支持台灣腦病防治基金會，投入腦血管疾病的預防篩檢與衛教推廣。
- 捐助財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心，支持傷友生命重建計畫，協助傷友進行生理重建與職業技能培力。
- 回饋台灣癌症臨床研究發展基金會，支持該基金會落實癌症防治生活化、在地化，以降低癌症的發生率；並提供最便捷的癌病醫療與諮詢服務。

(3) 深化產學合作，厚植在地人才

台灣大學

- 支持台灣國際化，跨界攬才：參與台大設立之「優秀僑生獎學金」，吸引並留住具國際視野之頂尖學子，厚植產業與社會的國際競爭力。
- 頂尖師資留才：透過「學術勵進獎」、「工學院研究生院長獎」及「學術勵進青年講座」，以鼓勵學院現職專任教師精進學術生涯成就、表揚致力投入研究，產出優秀研發成果之師生團隊，期能縮短學校與企業界人才需求的距離，有助學生銜接職場就業。
- 贊助財團法人台灣大學學術發展基金會，支持《台大校友雙月刊》之發行。

清華大學

- 長期技術扶植：延續「清大 DIT 團隊」四年期 (113-116 年) 捐贈計畫，邁入第二年實質資助，支持在地學子參與歐洲機器人大賽，累積國際技術實戰經驗。
- 學術卓越獎勵：贊助「清大動機系專題競賽」設立企業特別獎，縮短校園研究與產業需求之距離。
- 推廣科普，合力共創：舉辦「2025 年 G2C+ 聯盟 x 清華大學機器人夢想體驗營」使學生與企業員工子女教學相長，讓科普教育向下扎根。

逢甲大學

- 志聖與逢甲大學簽立團隊創新激勵方案：持續推動「ESG 綠能研究」五年期捐贈計畫，邁入第四年 (2025 年) 百萬元實質資助，協助校方進行碳中和調查及節能裝置開發，從校園源頭培力淨零排放之專業人才。
- 贊助「逢甲共善樓」：支持由國際建築大師隈研吾設計之校園地標。透過支持具備減碳理念的建築規劃與學術交流，提供打造給下一代學子豐沛的學習場域，善盡企業社會責任。

明志科大

- 延續 2023 年度推動企業公費生合作簽約儀式，本公司於 2025 年完成兩位學子之公費生簽約儀式，提供的全額學雜費補助及每月 10,000 元生活津貼，充分展現企業對人才培育的重視，也為雙方未來合作的深度與廣度奠定堅實基礎。

中平國小

- 自 2015 年起，本公司投入中平國小棒球隊的長期支持，於 2025 啟動下一個五年的捐贈計畫 (2025–2030) 讓「品格棒球」傳承延續。

(4) 國內文化發展

本公司積極參與文化創意產業的佈局，大力支持國內藝文組織舉辦之表演與活動，體認任何主要由人類組成的社會，都需要修養，經由品格的陶冶、心態的淨化、知見的正確，即可免於各自或群體的物化或沈淪，進而開通各自或群體的正向出路與素養提昇。

- 支持國內藝文組織活動

延續 2024 年《勸世三姊妹》捐贈案，2025 年本公司持續捐助台灣本土原創劇團躍演新台幣 3,000,000 元，以實際行動長期支持國內藝文發展，期能透過音樂劇媒介，呈現「什麼是台灣」，躍演劇團 2025 年推出之音樂劇《釧兒》更是結合傳統歌仔戲加上當代音樂劇的編制，讓台灣土地的記憶長存，充分將國內文化發揚光大。

- 重視本土藝術與心靈文化傳承

九、重要契約：無。



財務狀況及經營結果 之檢討分析與風險管理

一、財務狀況比較分析

單位：新台幣仟元				
項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	差異	
			金額	%
流動資產	6,800,510	6,251,277	549,233	9
不動產、廠房及設備	2,859,248	1,059,732	1,799,516	170
其他資產	5,653,450	3,461,485	2,191,965	63
資產總額	15,313,208	10,772,494	4,540,714	42
流動負債	5,060,637	3,145,172	1,915,465	61
長期負債	3,263,911	2,376,534	887,377	37
負債總額	8,324,548	5,521,706	2,802,842	51
股 本	1,567,553	1,567,553	-	-
資本公積	588,506	408,334	180,172	44
保留盈餘	1,643,995	1,587,739	56,256	4
其他權益	2,993,610	1,818,107	1,175,503	65
庫藏股	(253,897)	(524,329)	270,432	(52)
股東權益總額	6,988,660	5,250,788	1,737,872	33
最近二年度增減比例變動分析說明：				
1. 不動產、廠房及設備增加：係購置不動產、廠房及設備所致。				
2. 其他資產增加：係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動、採用權益法之投資增加所致。				
3. 流動負債增加：係合約負債 - 流動、應付帳款及短期借款增加所致。				
4. 長期負債增加：係長期借款增加所致。				
5. 資本公積增加：係庫藏股票交易所致。				
6. 其他權益增加：係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益增加所致。				
7. 庫藏股增加：係本期新增買回本公司股份所致。				

二、經營結果分析

(一) 經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元				
項目 \ 年度	114 年度	113 年度	增 (減) 金額	
			金額	變動比例 %
營業收入淨額	6,102,155	4,818,209	1,283,946	27
營業成本	(3,458,414)	(2,835,109)	(623,305)	22
營業費用	(1,760,497)	(1,347,104)	(413,393)	31
營業利益	883,244	635,996	247,248	39
營業外收支	243,443	343,568	(100,125)	(29)
稅前淨利	1,126,687	979,564	147,123	15
所得稅費用	(233,780)	(222,989)	(10,791)	5
本期淨利	892,907	756,575	136,332	18
最近二年度增減比例變動分析說明：				
1. 營業外收支減少：係因外幣兌換損失增加、透過損益按公允價值衡量之金融資產利益減少所致。				
2. 其餘各項增加：係因 114 年度營業收入增加致營業成本、營業費用、營業利益均增加。				

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司在我們的核心關鍵技術下，擴大產品組合，並考量各事業處規劃及過去經營績效為依據，訂定年度銷售目標。

(三) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司將視未來產業變動狀況，加強產品組合，擴大市場佔有率，提升公司獲利，未來業務應可持續成長，財務狀況亦良好。

三、現金流量

現金流量之檢討與分析表					
現金流量分析					
單位：新台幣仟元					
期初現金餘額 ①	全年來自營業活動淨 現金流量 ②	全年來自投資及籌資 活動淨現金流量 ③	現金剩餘數額 ①+②+③	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計畫	融資計畫
1,930,703	865,703	(932,466)	1,863,940	-	-

(一) 114 年度現金流量變動情形分析：

本公司 114 年度較 113 年度現金淨減少 66,763 仟元，各項營運活動現金流量變動情形如下：

(1) 營業活動淨流入減少 8,250 仟元

(2) 投資活動淨流出增加 1,366,077 仟元

(3) 籌資活動淨流入增加 957,397 仟元

(二) 最近二年度現金流量之流動性分析

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	增 (減) 比例
現金流量比率	16.44%	27.79%	(40.84)%
現金流量允當比率	73.65%	115.48%	(36.22)%
現金再投資比率	0.74%	5.36%	(86.24)%
增減比例變動分析說明：			
1. 增減比例變動情形分析說明：主係 114 年度營運活動之淨現金流入減少所致。			
2. 流動性不足之改善計畫：不適用。			

(三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元					
期初現金餘額 ①	全年來自營業活動淨 現金流量 ②	全年來自投資及籌資 活動淨現金流量 ③	預計現金剩餘數額 ①+②+③	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計畫	融資計畫
1,863,940	1,516,747	(1,466,321)	1,914,366	-	-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無此情形，不適用。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

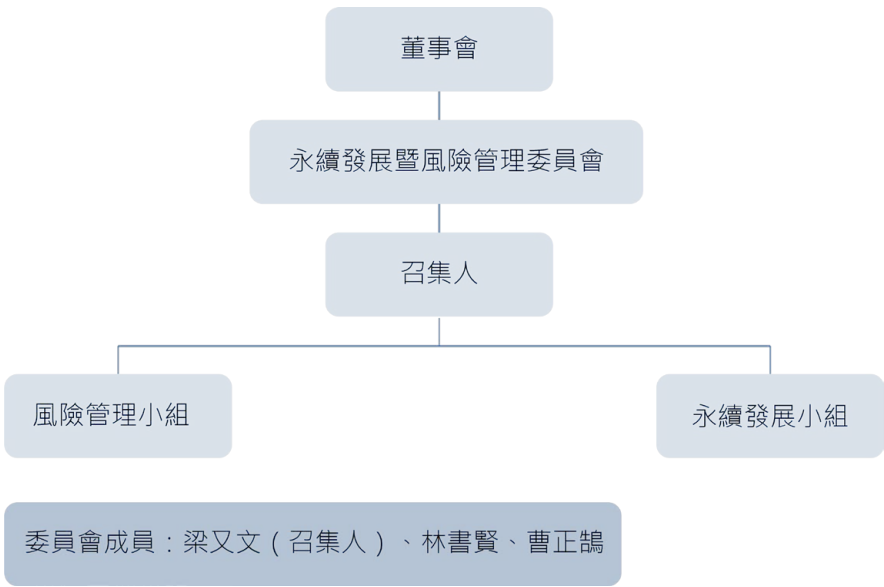
說明 \ 項目	本期損益金額 (註)	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計劃	未來其他投資計劃
C SUN(B.V.I.)	新台幣 277,226 仟元	深耕大陸市場及建立策略聯盟關係。	主要係來自於志聖子公司 - 志聖科技 (廣州) 有限公司 - 蘇州創峰光電科技有限公司	無	視投資標的公司之資金需求而定

註：以上係本年度投資金額超過實收資本額百分之五者。

六、風險管理及評估

(一) 風險管理之組織架構：

為提升企業社會責任及使公司永續經營發產，本公司於 106 年成立企業永續委員會。本公司以董事會為永續發展相關議題之最高決策單位，於 2025 年合併功能性委員會：「永續發展暨風險管理委員會」，由梁又文總經理擔任委員會召集人暨主席，負責公司永續發展暨風險管理統籌及推動等相關事務，轄下設有產品創新、客戶關懷、經營管理、社會關懷、環境永續、永續供應鏈、營運與策略風險、財務風險、法遵風險、資安風險、環境風險等 11 個小組，有效進行資源整合，將永續策略落實至各部處執行。



(二) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率變動：

本公司定期評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率。

利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

項目	114 年度金額 (仟元)	佔 114 年度營收比重 (%)
利息支出	67,236	1.10%

2. 匯率變動：

本公司的因應措施為，採用先預估未來現金流量，然後針對淨部位做出預售 / 購遠匯或直接於現貨市場出脫 / 買進外幣以避險為主。

3. 通貨膨脹：

本公司並無因受通貨膨脹而有重大影響之情形，且本公司對客戶及供應商之報價，以市場之機動調整者居多，故對本公司損益影響有限。本公司隨時注意市場價格之波動，目前尚未因通貨膨脹而產生立即重大影響。

(三) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1. 本公司各項投資皆經謹慎評估，並且依據「取得或處分資產處理程序」暨核決權限規定辦理，並無從事高風險、高槓桿投資事宜。本公司今年度並無從事高風險、高槓桿投資且各項投資案皆需經審慎評估後送至董事會表決通過。
2. 在資金貸與及背書保證方面，對象以本公司之子、孫公司為對象，並且依據本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」規定辦理。
3. 從事衍生性商品交易皆依本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之規定處理。本公司買賣遠期外匯合約係為規避外幣債權債務之匯率變動風險，並未從事投資性目的之衍生性商品。

(四) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

有關研發情形詳本年報肆、營運概況 一、業務內容 3. 技術及研發概況之內容，本公司預計 115 年度之研發費用 NT\$714,391 仟元，影響未來研發成功之主要因素為研發團隊能力與對市場資訊之掌握度，因本公司設有技術委員會，負責統籌公司未來產品的研發策略且近年來亦不斷提昇研發人力之素質，故對未來產業變化之新產品開發會持續不斷發展。

(五) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

因應主管機關針對公司治理、公司法、證交法等重要政策及相關法律之修訂，本公司均配合之;此外，本公司管理階層隨時觀察注意國內外重要政策及法律變動，並適時主動提出因應措施，故對本公司財務業務尚無重大影響。

(六) 科技改變 (包括資通安全風險) 及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

董事會高度重視科技變遷帶來的潛在營運衝擊，要求管理階層將包含「資安風險控管」在內的重要議題納入核心管理指標，並落實於各事業單位年度目標與績效考核中。針對資通安全風險，公司透過「永續發展暨風險管理委員會」建立各層級管理制度，以最小化外部環境與科技演進帶來的風險影響。為因應駭客攻擊技術日新月異及潛在的營運中斷風險，公司持續強化數位防護韌性，包含建立 SOC 資安運營中心、通過 ISO 27001 驗證，以及符合高科技供應鏈的 SEMI E187 標準。同時每

年不定期實施社交工程演練與滲透測試，確保公司在面對快速變化的資安威脅下，能有效保護關鍵資訊資產並維持出色的市場競爭力，避免因科技或資安風險對公司財務及業務產生重大不利影響。故目前對公司及業務並無重大影響。

(七) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向堅持誠實經營原則及社會責任之參與，多年來皆保持良好的企業形象和風險控管，目前並無可預見之危機可能性。

目前志聖工業在台灣證券交易所上市，同時受到主管機關監督、恪守法令，因此企業形象良好。

(八) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：截至年報刊印日止本公司並無任何併購計畫。

(九) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

A. 購入台中營運暨研發總部土地

本公司已於 114 年 9 月 9 日向台中市政府得標取得於台中市水湳經貿園區逢大段地坪面積 1,622.53 坪之土地，未來擬配合原有之台中廠基地，於該土地規劃興建台中營運暨研發總部。該案預計將以銀行借款支應，其中 114 年 10 月前預計將支付 638,361 千元；後續並將分別於 114 年 12 月及 115 年 3 月支付剩餘款項 638,361 千元及 547,167 千元。

由於本公司近年積極投入 AI、先進封裝及數位製造技術，並成功轉型切入半導體設備供應鏈，考量該產業特性需持續投入研發以滿足終端客戶之技術需求，加上本公司前瞻製程亦須持續配合客戶需求進行客製化產品調整，目前現有台中廠區內之半導體研發區塊已不敷使用，對格局完整且動線開闊之研發空間及國內一流半導體研發人才之需求實屬急迫。

本次取得之台中市水湳經貿園區逢大段地目為「第二種創新研發專用區」，開發定位以產業的招商引資為重點，考量近年來因台商回流之故，國內園區土地取得日趨困難，加上該地段三面臨路、地塊完整且鄰近逢甲大學，周邊機能完善、交通便利，非常有利於就近吸引人才，實為最符合本公司需求之地點。目前本公司已與逢甲大學於 114 年 5 月 8 日簽訂產學聯盟合作備忘錄，並透過捐贈儀器設備來展示與逢甲共建「前瞻能源與熱管理實驗室」的長期合作想法。由於本公司目前方取得該地，整體營運暨研發總部之細部規劃尚在進行中，惟新基地將朝向整合營運、研發與教育功能，形成具備完整價值鏈的區域據點為目標。

B. 台中二廠

本公司於 115 年 2 月 2 日公告以新台幣 1,480,000 千元取得台中南屯區精科一路 12 號廠房，並於 115 年間依約陸續支付尾款 437,160 千元，主係考量本公司原有之台中廠可使用面積僅 746 坪，已無法滿足本公司產品之生產及研發需求，故本公司本次取得台中南屯區精科一路 12 號廠房以作為新廠址之方案，以滿足日益成長之產能及研發需求，該案資金來源主要係以該案土地融資支應。

(十) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司銷售產業範圍擴及電子、半導體、LCD、PCB、印刷塗裝等產業，本公司除持續耕耘舊客戶外，並積極拓展新客戶。

(十一) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司無此情形。

(十二) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

截至目前為止，公司經營權並無發生重大改變。

(十三) 訴訟或非訟事件處理情形：截至年報刊印日止，本公司無此情形。

(十四) 資安風險評估分析及其因應措施等重要風險評估之事項：

請參閱本年報 肆、營運概況 六、資通安全管理之內容；

(十五) 其他重要風險及因應措施：截至年報刊印日止，本公司無此情形。

七、其他重要事項：截至年報刊印日止，本公司無此情形。



6 特別記載事項

- 一、 關係企業相關資料：請詳見公開資訊觀測站—『關係企業三書表專區』；
- 二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
- 三、 最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。
- 四、 最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響事項：無。
- 五、 其他必要補充說明事項：無。

志聖工業股份有限公司



負責人：梁茂生





經營理念 皆大歡喜 All Win 宣言

1. 志聖關鍵創新產品、服務與 Total Solution 能使顧客滿意，成為致勝關鍵。
2. 志聖的工作夥伴能彼此學習與學研機構往來，深化核心能力，形成高效能團體。
3. 志聖不斷精進經營與誠信治理，使投資大眾與集團同仁分享利益。
4. 與供應商共同提昇，與志聖形成有競爭力的夥伴關係。
5. 我們身體力行，不斷造福員工家庭、社區與整個社會。
6. 與同業形成良性競合關係，系統整合，提昇產業整體競爭力。



Facebook



www.csun.com.tw

新北市林口區工二工業區工八路 2-1 號
TEL：(02)2601-7706 FAX：(02)2601-8854

